

无锡芯朋微电子股份有限公司
公开转让说明书

Chipown 芯朋微电子
High performance Power IC Solutions

主办券商

 **上海證券** Shanghai Securities Co.,Ltd.

上海市西藏中路 336 号 邮政编码：200001

电话：021-53519888 传真：021-63609593

二〇一四年一月



声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、市场风险

集成电路行业是一个快速发展的高科技行业，各种新技术、新产品不断更新，一方面产生了巨大的市场机遇，另一方面也导致市场变化多端，难以完全把握，需要公司不断开发出适销对路的新产品以求跟上市场的需求。除此之外，目前市场上生产电源管理集成电路产品的公司也越来越多，同质化较为严重，竞争愈演愈烈。因此，只有把握住市场需求的不断变化，并在技术开发方面保持自己的先进性和独特优势，公司才能在激烈的市场竞争中赢得一席之地。

二、技术更新风险

集成电路设计在国内尚属于成长中的新兴产业，新技术可能随着行业的发展环境和国际国内消费市场的变迁而发生变革，公司若不能及时跟上新技术变革的步伐，将对公司业务的持续开展和市场的进一步开拓产生不利影响。

三、核心人才流失风险

集成电路设计行业对设计人员的专业技术能力和各技术团队的密切合作依赖程度较高。一个合格的专业设计技术人员需要长时间的技术积累，而公司的研发团队、特别是核心技术人员又是公司能够不断开发出获利产品的关键保障。因此，相对稳定的技术研发团队是公司一切比较优势的基础和来源，而核心人才的流失无疑将对公司的持续经营带来重大的风险。

四、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人张立新持有公司股份 1,252.50 万股，持股比例为 61.10%。公司实际控制人现任公司董事长兼总经理，对公司经营管理有较大影响力，若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。

五、对非经常性损益依赖的风险

2011年、2012年和2013年1~6月，公司净利润分别为1,214.44万元、1,616.31万元和1,111.52万元，扣除非经常性损益后净利润分别为504.31万元、557.23万元和864.54万元。公司非经常性损益主要为政府对公司研发项目的补贴，政府补贴使得公司净利润相比之下表现在较高的水平。如果公司业务不能实现更快的增长，在公司无法持续获得政府补贴时，将会对公司今后盈利水平的快速提升产生不利影响。

目 录

声明	3
重大事项提示	5
一、市场风险	5
二、技术更新风险	5
三、核心人才流失风险	5
四、实际控制人不当控制的风险	5
五、对非经常性损益依赖的风险	6
释义	9
第一章 基本情况	13
一、公司基本情况	13
二、股份基本情况	13
三、股权结构及股本形成情况	16
四、董事、监事、高级管理人员情况	24
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	29
六、本次公开转让有关机构情况	30
第二章 公司业务	32
一、公司主要产品情况	32
二、公司主要生产流程及方式	38
三、公司业务相关的关键资源要素	40
四、公司业务经营情况	54
五、公司商业模式	61
六、公司所处行业概况	63
七、公司面临的主要竞争状况	72
第三章 公司治理	76
一、公司治理机构的建立健全及运行情况	76
二、公司董事会对治理机制的评价	77
三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况	77
四、公司独立性情况	77
五、同业竞争情况	79
六、关联方资金占用情况	80
七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况	80
八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况	82
九、公司重要事项决策和执行情况	83
第四章 公司财务	85
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表	85
二、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	116
三、公司报告期利润形成的有关情况	118
四、公司报告期主要资产情况	127
五、公司报告期重大债务情况	140
六、公司报告期股东权益情况	148
七、关联方及关联交易	149

八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	151
九、公司报告期内资产评估情况	152
十、股利分配政策和报告期内的分配情况	152
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	153
十二、公司经营风险因素	155
十三、公司经营目标	159
第五章 附件	163
一、主办券商推荐报告；	163
二、财务报表及审计报告；	163
三、法律意见书；	163
四、公司章程；	163
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；	163

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司	指	无锡芯朋微电子股份有限公司或前身为无锡芯朋微电子有 限公司
苏州博创	指	苏州博创集成电路设计有限公司
深圳芯朋	指	深圳芯朋电子有限公司
有限公司	指	无锡芯朋微电子有 限公司
本说明书、本公开转让说明 书	指	无锡芯朋微电子股份有限公司公开转让说明书
股东会	指	无锡芯朋微电子有 限公司股东会
股东大会	指	无锡芯朋微电子有 限公司股东大会
董事会	指	无锡芯朋微电子有 限公司或无锡芯朋微电 子股份有 限公司 董事会
监事会	指	无锡芯朋微电子有 限公司或无锡芯朋微电 子股份有 限公司 监事会
公司章程	指	无锡芯朋微电子有 限公司或无锡芯朋微电 子股份有 限公 司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
上海证券、主办券商	指	上海证券有 限责任公司
内核小组	指	上海证券有 限责任公司全国中小企 业股份 转让系 统推 荐挂 牌项 目内 部审 核小 组
中国证监会	指	中国证券监督 管理委 员会
全国股份转让系统	指	全国中小企 业股份 转让系 统

全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
集成电路 (Integrated Circuit, 简称“IC”)	指	将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。集成电路制造商采用一定的工艺, 把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起, 制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构; 其中所有元件在结构上已组成一个整体, 使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
模拟	指	在时间和幅度上都是连续变化的行为 (连续的含义是在某个取值范围内可以取无穷多个数值)。通常与“数字”相对。
模拟集成电路 (Analog Integrated Circuit)	指	处理模拟电子信号的集成电路。
电源管理芯片、电源管理集成电路	指	电源管理芯片属于模拟集成电路中重要的一个门类, 在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的, 其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。
AC-DC	指	把交流电转变成直流电。即可代指这种转变的过程, 也可指能够实现这种功能的电子电路和设备。
DC-DC	指	把某种规格的直流电转变成另一种规格的直流电。即可代指转变的过程, 也可指能够实现这种功能的电路。
MOS (Metal Oxide Semiconductor)	指	中文为“金属氧化物半导体”。采用这种结构的晶体管称之为 MOS 晶体管, 按导电方式分为 PMOS 晶体管和 NMOS 晶体管两种类型。具备制造这种晶体管的工艺被称为 MOS 工艺。
DMOS (Double-diffused Metal Oxide Semiconductor)	指	中文为“双扩散 MOS 晶体管”, 是针对大电流、高电压而优化设计的晶体管, 可以承受较大的功率。
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)	指	中文为“互补金属氧化物半导体”。即由 PMOS 和 NMOS 晶体管组合而成的半导体电路, 因其低功耗和集成度高,

		成为当今主流的集成电路构成方式。其制造工艺被称为 CMOS 工艺。
晶圆、圆片	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品。
布图、版图	指	确定用以制造集成电路的电子元件在一个传导材料中的几何图形排列和连接的布局设计。
封装	指	将硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。
Foundry 代工模式	指	半导体产业存在的两种商业模式之一，亦称为垂直分工模式，是 20 世纪 90 年代初兴起的一种新 IC 产业模式，该模式由无生产线设计公司（Fabless）、代工厂商（Foundry）以及封装企业（Package）以及测试企业（Testing）等组成。
Fabless 模式	指	即无生产线设计公司模式，采用该模式的 IC 设计公司自身不具备晶圆制造和封装生产线，专注于技术和工艺研发，将生产环节全部外包。
IDM 模式	指	IDM 是英文 Integrated Device Manufacture 的缩写，即垂直集成模式。其特点是，企业经营范围覆盖芯片设计、生产制造、封装测试等各环节。
PDP	指	PDP 是 Plasma Display Panel 的缩写，即等离子显示板，是一种利用气体放电的显示技术。该技术采用等离子管作为发光元件，屏幕上每个等离子管对应一个像素，屏幕以玻璃作为基板，基板间隔一定距离，四周经气密性封闭形成以惰性气体作为工作媒质放电空间。当向电极上加入电压，放电空间内混合气体便发生等离子体放电现象并产生紫外线激发荧光屏，荧光屏发射可见光显现图像。
BOM	指	BOM 是 Bill Of Material 的缩写，中文名称为物料清单。本说明书指用于电子整机产品组装生产的全部电子元器件、结构件的清单。
PCB	指	PCB 是 Printed Circuit Board 的缩写，中文名称为印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者。

第一章 基本情况

一、公司基本情况

公司名称	无锡芯朋微电子股份有限公司
注册号	320213000063167
法定代表人	张立新
有限公司成立日期	2005年12月23日
股份公司成立日期	2011年11月30日
注册资本	2,050.00万元
实收资本	2,050.00万元
住所	无锡新区长江路21号信息产业园F座4层
邮编	214028
电话	0510-85217718
传真	0510-85217728
电子邮箱	chenj@chipown.com.cn
董事会秘书	陈健
所属行业	单片集成电路、混合式集成电路的制造业。根据上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）公司属于C3963单片集成电路、混合式集成电路的制造业。
主要业务	电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务
组织机构代码	78273649-2

二、股份基本情况

（一）股票挂牌情况

股票代码	【430512】
股票简称	【芯朋微】
股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00元
股票总量	2,050.00万股
挂牌日期	【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排

1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

《公司章程》（草案）第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。”

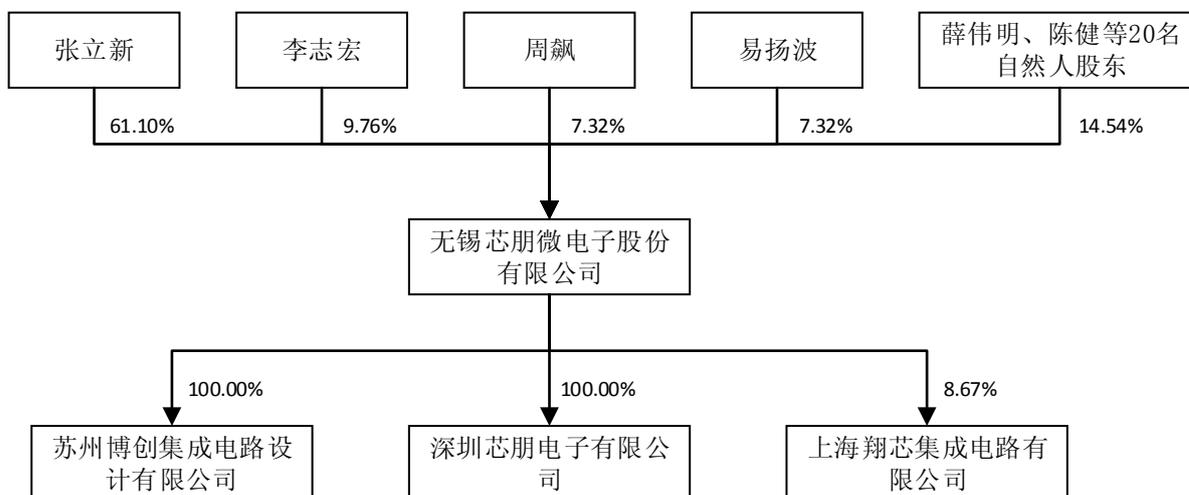
2、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计 544.75 万股，具体情况如下：

序号	股东名称	公司任职情况	持股数量（股）	是否冻结或质押	第一批可转让股份数额（股）
1	张立新	董事长、总经理、核心技术人员	12,525,000	否	3,131,250
2	李志宏	董事、副总经理	2,000,000	否	500,000
3	周飙	董事、副总经理、核心技术人员	1,500,000	否	375,000
4	易扬波	董事、副总经理、核心技术人员	1,500,000	否	375,000
5	薛伟明	董事、副总经理	1,000,000	否	250,000
6	陈健	副总经理、董事会秘书	1,000,000	否	250,000
7	张韬	监事会主席、核心技术人员	500,000	否	125,000
8	倪秋明	-	40,000	否	40,000
9	李海松	核心技术人员	40,000	否	40,000
10	陶平	监事	30,000	否	7,500
11	薛琳琪	-	30,000	否	30,000
12	童剑杰	-	30,000	否	30,000
13	邹宇彤	-	30,000	否	30,000
14	邢辛垚	-	30,000	否	30,000
15	李晓勇	-	30,000	否	30,000
16	王钦	-	30,000	否	30,000
17	丁祝琴	-	30,000	否	30,000
18	郭敏年	-	25,000	否	25,000
19	吴虹	-	25,000	否	25,000
20	阮海波	-	25,000	否	25,000
21	曾毅	-	25,000	否	25,000
22	鲁建荣	-	25,000	否	25,000
23	陶晓华	监事	15,000	否	3,750
24	唐晓琛	-	15,000	否	15,000
合计			20,500,000	-	5,447,500

三、股权结构及股本形成情况

(一) 股权结构图



(二) 股东持股情况

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	张立新	1,252.50	61.10	境内自然人	否
2	李志宏	200.00	9.76	境内自然人	否
3	周飙	150.00	7.32	境内自然人	否
4	易扬波	150.00	7.32	境内自然人	否
5	薛伟明	100.00	4.88	境内自然人	否
6	陈健	100.00	4.88	境内自然人	否
7	张韬	50.00	2.44	境内自然人	否
8	倪秋明	4.00	0.20	境内自然人	否
9	李海松	4.00	0.20	境内自然人	否
10	陶平	3.00	0.15	境内自然人	否
11	薛琳琪	3.00	0.15	境内自然人	否
12	童剑杰	3.00	0.15	境内自然人	否
13	邹宇彤	3.00	0.15	境内自然人	否
14	邢辛垚	3.00	0.15	境内自然人	否
15	李晓勇	3.00	0.15	境内自然人	否
16	王钦	3.00	0.15	境内自然人	否
17	丁祝琴	3.00	0.15	境内自然人	否

18	郭敏年	2.50	0.12	境内自然人	否
19	吴虹	2.50	0.12	境内自然人	否
20	阮海波	2.50	0.12	境内自然人	否
21	曾毅	2.50	0.12	境内自然人	否
22	鲁建荣	2.50	0.12	境内自然人	否
23	陶晓华	1.50	0.07	境内自然人	否
24	唐晓琛	1.50	0.07	境内自然人	否
合计		2,050.00	100.00		

（三）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间不存在关联关系。

（四）控股股东和实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为张立新先生。截至本公开转让说明书签署之日，张立新先生持有本公司 1,252.50 万股股份，占公司股本总额的 61.10%，是公司第一大股东，能够对公司经营决策产生实质性影响，是控股股东和实际控制人。张立新先生除持有本公司上述股份外，还持有无锡市泰思特测试有限责任公司 6.40% 的股份并任该公司监事。

张立新先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于东南大学，获学士学位，2007 年获东南大学工程硕士学位。1988 年 7 月至 1997 年 12 月，就职于中国华晶电子集团 MOS 圆片工厂，任副厂长；1998 年 1 月至 2001 年 12 月，就职于上华半导体有限公司，任总监；2002 年 1 月至 2005 年 12 月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任副总裁；2005 年 12 月创立了芯朋有限，任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、核心技术人员。董事长、总经理任职自 2011 年 11 月 25 日起，任期三年。

公司实际控制人在最近两年内未发生变化。

（五）股本形成及变化情况

芯朋股份系芯朋有限整体变更设立的股份有限公司。芯朋有限设立后，进行过 2 次股权转让及 1 次增资，芯朋有限整体变更为芯朋股份后，进行过 1 次股权

转让及 1 次增资。公司股本形成及变化的具体情况如下：

1、2005年12月芯朋有限设立

芯朋有限设立于 2005 年 12 月 23 日，设立时名称：无锡芯朋微电子有限公司；法定代表人：张立新；注册地址：无锡市新区长江路 21 号信息产业园 E 幢 101 室；经营范围：电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产及销售。（上述经营范围涉及国家专项审批的，经批准后<含证>方可经营）。

公司注册资本为人民币 200 万元。公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	张立新	100.00	50.00	货币
2	李志宏	50.00	25.00	货币
3	杨翠喜	30.00	15.00	货币
4	林维韶	20.00	10.00	货币
合计		200.00	100.00	

2005 年 12 月 22 日，无锡大明会计师事务所出具锡大明会验[2005]089 号《验资报告》验证各股东出资均已缴足。

公司就设立事项完成了工商登记并领取了营业执照。

2、2007年8月芯朋有限变更住所、经营范围

2007 年 8 月 1 日，公司召开股东会，决定将公司住所变更为无锡新区长江路 21 号信息产业园 F 座 4 层。同时将公司经营范围变更为：电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务。（上述经营范围涉及国家专项审批的，经批准后<含证>方可经营）。并同时修改了公司章程。

无锡工商行政管理局新区分局于 2007 年 8 月 31 日核准了此次变更。

3、2009年4月芯朋有限股权转让及增加注册资本

2009 年 3 月 26 日，公司股东杨翠喜与张立新签订股权转让协议，决定将其持有的公司 15% 股权暨 30 万元货币出资额以 30 万元转予张立新。

2009 年 3 月 26 日，公司股东林维韶与张立新签订股权转让协议，决定将其持有的公司 10% 股权暨 20 万元货币出资额以 20 万元转予张立新。

2009 年 3 月 26 日，公司召开股东会，决定将公司注册资本由 200 万元增加

至 2000 万元，增加 1800 万元。其中，张立新增加出资 1250 万元，李志宏增加出资 150 万元，新股东周飙出资 150 万元，新股东薛伟明出资 100 万元，新股东陈健出资 100 万元，新股东张韬出资 50 万元，均为货币出资。

2009 年 3 月 26 日，无锡大明会计师事务所出具锡大明会验[2009]054 号《验资报告》验证各股东新增出资均已缴足。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	张立新	1,400.00	70.00	货币
2	李志宏	200.00	10.00	货币
3	周飙	150.00	7.50	货币
4	薛伟明	100.00	5.00	货币
5	陈健	100.00	5.00	货币
6	张韬	50.00	2.50	货币
合计		2,000.00	100.00	

无锡工商行政管理局新区分局于 2009 年 4 月 3 日核准了此次变更。

4、2009年8月芯朋有限变更经营范围

2009 年 8 月 1 日，公司召开股东会，决定将公司经营范围变更为：电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务；自营各类商品和技术的进出口（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。同时修改了公司章程。

无锡工商行政管理局新区分局于 2009 年 8 月 19 日核准了此次变更。

5、2011年1月股权转让

2010 年 11 月 10 日，公司召开股东会，同意公司股东张立新将其持有的公司 7.5% 的股权暨 150 万元货币出资额以 150 万元转予易扬波。其他股东放弃优先受让权。同时修改了公司章程。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	张立新	1,250.00	62.50	货币
2	李志宏	200.00	10.00	货币

3	周飙	150.00	7.50	货币
4	易扬波	150.00	7.50	货币
5	薛伟明	100.00	5.00	货币
6	陈健	100.00	5.00	货币
7	张韬	50.00	2.50	货币
合计		2,000.00	100.00	

无锡工商行政管理局新区分局于 2011 年 1 月 4 日核准了此次变更。

6、2011年11月芯朋有限整体变更为芯朋股份

2011 年 11 月 18 日，公司获得江苏省无锡工商行政管理局出具的（02000047）名称变更预留[2011]第 11180001 号《企业名称变更预留通知书》。核准公司名称变更为“无锡芯朋微电子股份有限公司”。

2011 年 11 月 22 日，公司召开股东会，决定以 2011 年 9 月 30 日为基准日将公司整体变更为股份有限公司。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2011]A668 号《审计报告》，确认公司截至 2011 年 9 月 30 日所有者权益为 38,615,526.55 元。江苏中天资产评估事务所有限公司出具苏中资评报字（2011）第 1066 号评估报告，确认截至 2011 年 9 月 30 日账面价值 3,861.55 万元的所有者权益（净资产）的评估值为 5,914.94 万元。

公司以 2011 年 9 月 30 日经审计的账面净资产额 38,615,526.55 元按照 1:0.5179 的比例折股，折合为股份 2,000 万股（每股面值 1.00 元），剩余 18,615,526.55 元计入股份公司资本公积。

2011 年 11 月 22 日，各发起人签订了《发起人协议》，对设立股份公司的各项事宜作出了约定。

2011 年 11 月 25 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《筹委会关于股份公司筹建的工作报告》、《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等议案；选举了公司董事、监事人选并通过了各项制度。

2011 年 11 月 25 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 W[2011]B116 号《验资报告》，验证各股东出资已经到位。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	股权比例（%）	出资方式
1	张立新	1,250.00	62.50	净资产折股
2	李志宏	200.00	10.00	净资产折股
3	周飙	150.00	7.50	净资产折股
4	易扬波	150.00	7.50	净资产折股
5	薛伟明	100.00	5.00	净资产折股
6	陈健	100.00	5.00	净资产折股
7	张韬	50.00	2.50	净资产折股
合计		2,000.00	100.00	

江苏省无锡工商行政管理局于 2011 年 11 月 30 日核准了此次变更。

7、2012年4月芯朋股份增加注册资本

2012 年 3 月 16 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，决定将公司注册资本由 2,000 万元增加至 2,050 万元，增资价格为每股 4.00 元。同时修改了公司章程。新增股东出资情况见下表。

序号	股东姓名	出资额（万元）	认购股数（万股）	出资方式
1	倪秋明	16.00	4.00	货币
2	李海松	16.00	4.00	货币
3	陶平	12.00	3.00	货币
4	薛琳琪	12.00	3.00	货币
5	童剑杰	12.00	3.00	货币
6	邹宇彤	12.00	3.00	货币
7	邢辛垚	12.00	3.00	货币
8	李晓勇	12.00	3.00	货币
9	王钦	12.00	3.00	货币
10	丁祝琴	12.00	3.00	货币
11	郭敏年	10.00	2.50	货币
12	吴虹	10.00	2.50	货币
13	武家中	10.00	2.50	货币
14	阮海波	10.00	2.50	货币
15	曾毅	10.00	2.50	货币
16	鲁建荣	10.00	2.50	货币
17	陶晓华	6.00	1.50	货币
18	唐晓琛	6.00	1.50	货币
合计		200.00	50.00	

2012年3月31日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2012]B021号《验资报告》,验证各股东新增出资已经到位。

本次变更完成后,公司股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数(万股)	股权比例(%)	出资方式
1	张立新	1,250.00	60.98	净资产折股
2	李志宏	200.00	9.76	净资产折股
3	周飙	150.00	7.32	净资产折股
4	易扬波	150.00	7.32	净资产折股
5	薛伟明	100.00	4.88	净资产折股
6	陈健	100.00	4.88	净资产折股
7	张韬	50.00	2.44	净资产折股
8	倪秋明	4.00	0.20	货币
9	李海松	4.00	0.20	货币
10	陶平	3.00	0.15	货币
11	薛琳琪	3.00	0.15	货币
12	童剑杰	3.00	0.15	货币
13	邹宇彤	3.00	0.15	货币
14	邢辛垚	3.00	0.15	货币
15	李晓勇	3.00	0.15	货币
16	王钦	3.00	0.15	货币
17	丁祝琴	3.00	0.15	货币
18	郭敏年	2.50	0.12	货币
19	吴虹	2.50	0.12	货币
20	武家中	2.50	0.12	货币
21	阮海波	2.50	0.12	货币
22	曾毅	2.50	0.12	货币
23	鲁建荣	2.50	0.12	货币
24	陶晓华	1.50	0.07	货币
25	唐晓琛	1.50	0.07	货币
合计		2,050.00	100.00	

江苏省无锡工商行政管理局于2012年4月12日核准了此次变更。

8、2013年8月股份转让

2013年3月29日,武家中与张立新签订了股权转让协议,决定将其所持有的公

司 2.5 万股股份作价 10.8 万元转让给张立新。2013 年 8 月 2 日，公司召开股东大会就此修改了公司章程。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	股权比例（%）	出资方式
1	张立新	1,252.50	61.10	净资产折股 货币
2	李志宏	200.00	9.76	净资产折股
3	周飙	150.00	7.32	净资产折股
4	易扬波	150.00	7.32	净资产折股
5	薛伟明	100.00	4.88	净资产折股
6	陈健	100.00	4.88	净资产折股
7	张韬	50.00	2.44	净资产折股
8	倪秋明	4.00	0.20	货币
9	李海松	4.00	0.20	货币
10	陶平	3.00	0.15	货币
11	薛琳琪	3.00	0.15	货币
12	童剑杰	3.00	0.15	货币
13	邹宇彤	3.00	0.15	货币
14	邢辛垚	3.00	0.15	货币
15	李晓勇	3.00	0.15	货币
16	王钦	3.00	0.15	货币
17	丁祝琴	3.00	0.15	货币
18	郭敏年	2.50	0.12	货币
19	吴虹	2.50	0.12	货币
20	阮海波	2.50	0.12	货币
21	曾毅	2.50	0.12	货币
22	鲁建荣	2.50	0.12	货币
23	陶晓华	1.50	0.07	货币
24	唐晓琛	1.50	0.07	货币
合计		2,050.00	100.00	

经主办券商核查确认，按《锡金融办[2012]4 号》文的要求，非上市公司股份有限公司的股权变更应先到无锡市股权登记托管中心做好变更登记后送工商局办理登记备案，因此公司在无锡市股权登记托管中心办理了全部股权托管。在向无锡市工商行政管理局提交出示了相关股权托管文件后，江苏省无锡工商行政管理局于 2013 年 8 月

14日核准了章程备案。无锡市股权登记托管中心是无锡市指定的企业股权集中登记托管的专门机构，是经无锡市政府同意，依法设立的专门从事股权登记托管业务的不以盈利为根本目的的中介服务机构。该中心不属于国发[2011]38号文件中需进行清理整顿的交易场所。

（六）重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组的情况。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事情况

张立新先生，现任公司董事长、总经理。具体情况请参见本章“三、股权结构及股本形成情况”之“（四）控股股东和实际控制人情况”。

李志宏先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于东南大学，获学士学位。1988年7月至1995年3月，就职于西安微电子技术研究所，任工程师；1995年3月至2000年10月，就职于广东硅峰微电子有限公司，任设计中心经理；2000年10月至2002年10月，就职于东洋电子（东莞）有限公司，任技术副总经理；2002年10月至2004年12月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任市场和销售总监；2005年1月至2005年12月，就职于深圳宏志微电子有限公司，任总经理；2005年12月创立芯朋有限，任副总经理。现任公司董事、副总经理，任职自2011年11月25日起，任期三年。

周飙先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于东南大学，获学士学位。1992年8月至1997年9月，就职于无锡华晶集团公司中研所，任设计工程师；1997年9月至2000年3月，就职于百利通（上海）有限公司，任设计工程师；2000年3月至2003年3月，就职于摩托罗拉（苏州）有限公司，任高级设计工程师；2003年4月至2006年3月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任设计经理；2006年4月加入芯朋有限，任副总经理。现任公司董事、副总经理、核心技术人员。董事、副总经理任职自2011年11月25日起，任期三年。

薛伟明先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于东南大学，获学士学位。1988年7月至1999年3月，就职于华晶集团中研所一室，任副

主任；1999年4月至2001年5月，就职于无锡新中亚微电子有限公司，任副总；2001年6月至2002年12月，就职于中星微电子有限公司，任产品部主管；2002年12月至2007年3月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任营运总监；2007年3月加入芯朋有限，任副总经理。现任公司董事、副总经理，任职自2011年11月25日起，任期三年。

易扬波先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于东南大学，获博士学位。2004年4月至2006年1月，就职于江苏东大集成电路系统工程技术有限公司，任部门经理；2006年2月至2008年3月，就职于无锡博创微电子有限公司，任总经理；2008年3月至2010年8月，就职于苏州博创集成电路设计有限公司，任副总经理；2010年9月加入芯朋有限，任副总经理。现任公司董事、副总经理、核心技术人员。董事、副总经理任职自2011年11月25日起，任期三年。

（二）监事情况

张韬先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于东南大学，获学士学位。1992年7月至1997年11月，就职于无锡华晶集团公司中研所六室，任设计工程师；1997年11月至2000年5月，就职于百利通（上海）有限公司，任设计工程师；2000年6月至2001年5月，就职于无锡日松微电子有限公司，任设计工程师；2001年6月至2003年7月，就职于中星微电子，任设计工程师；2003年8月至2006年7月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任高级设计工程师；2006年7月加入公司，任设计总监。现任公司监事会主席、设计总监、核心技术人员。监事会主席任职自2011年11月25日起，任期三年。

陶晓华女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于东南大学。1996年7月至2006年1月，就职于无锡八佰伴商贸中心有限公司，任教育员；2006年2月加入公司。现任公司监事，任职自2011年11月25日起，任期三年。

陶平先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于东南大学，获硕士学位。2000年9月至2002年6月，就职于长沙开元仪器有限公司，任工程师；2002年8月至2003年8月，就职于上海市力通微电子有限公司，任工程师；2006年4月至2008年5月，就职于无锡博创微电子有限公司，任工程师；2008年6月加入公司。现任公司监事，任职自2011年11月25日起，任期三年。

（三）高级管理人员情况

张立新先生，现任公司董事长、总经理。具体情况请参见本章“三、股权结构及股本形成情况”之“（四）控股股东和实际控制人情况”。

李志宏先生，现任公司董事、副总经理。具体情况请参见本节之“（一）董事情况”。

周飙先生，现任公司董事、副总经理。具体情况请参见本节之“（一）董事情况”。

易扬波先生，现任公司董事、副总经理。具体情况请参见本节之“（一）董事情况”。

薛伟明先生，现任公司董事、副总经理。具体情况请参见本节之“（一）董事情况”。

陈健先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于东南大学，获硕士学位。1992 年 5 月至 1998 年 12 月，就职于熊猫电子集团，任工程师；1999 年 1 月至 1999 年 10 月，就职于泰鼎多媒体(上海)有限公司，任系统软件设计师；1999 年 11 月至 2005 年 3 月，就职于南京微盟电子有限公司，任副总/总经理；2005 年 4 月至 2006 年 10 月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任销售总监；2006 年 11 月至 2007 年 5 月，就职于研诺逻辑（上海）有限公司，任销售总监；2007 年 6 月加入芯朋有限，任副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，任职自 2011 年 11 月 25 日起，任期三年。

（四）子公司、分公司情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司有二家控股子公司、一家参股子公司，无分公司。子公司具体情况如下：

1、苏州博创集成电路设计有限公司

公司名称	苏州博创集成电路设计有限公司
法定代表人	张立新
设立日期	2008 年 3 月 14 日
注册资本	3,000 万元
住所	苏州独墅湖高等教育区林泉街 399 号 1#3 层
注册号	320594000113866

邮编	215123
经营范围	研发、销售：半导体集成电路及半导体分立器件、电子产品、计算机软硬件；销售：仪器仪表、普通机械、电器机械、五金交电；提供相关技术服务；从事上述商品和相关技术的进出口业务。

公司目前持有苏州博创 100%的股权，苏州博创设立于 2008 年 3 月 14 日，2010 年 9 月 17 日，公司与原股东徐之伟、易扬波签订股权转让协议，收购苏州博创 100%的股权，并于 2010 年 9 月 28 日完成工商变更。在本次收购之前，公司董事长张立新已兼任苏州博创董事长，且苏州博创主要产品销售给芯朋股份，双方存在关联交易。本次收购完成后，公司与苏州博创的关联交易得以消除，双方的研发、代工、销售得到优化整合，苏州博创主要定位于高压集成电路产品的开发，母公司负责产品集成、市场开拓和总体战略规划。

2、深圳芯朋电子有限公司

公司名称	深圳芯朋电子有限公司
法定代表人	李志宏
设立日期	2012 年 3 月 12 日
注册资本	100 万元
住所	深圳市福田区深南路与广深高速公路交汇处东南侧大庆大厦 28C.28D
注册号	440301106058895
邮编	518040
经营范围	机电产品的设计、开发、销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

2012 年 1 月 5 日，芯朋股份召开 2012 年第一次临时股东大会，决定设立深圳芯朋，注册资本为 100 万元。

经深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）于 2012 年 2 月 26 日出具的深中岳验字[2012]第 006 号《验资报告》验证，芯朋股份的出资已全部到位。

深圳芯朋承担公司在华南地区的产品推广和销售工作。由于公司小家电和消费类终端客户集中珠三角地区、且数量大，离散度高，设立深圳芯朋作为专业的销售子公司，有助于加强公司对销售代理和终端客户的管理，提升对重点区域市场的控制力。

3、上海翔芯集成电路有限公司

公司名称	上海翔芯集成电路有限公司
法定代表人	金明良
设立日期	2012年3月21日
注册资本	3,000.00 万元
住所	上海市嘉定区徐行镇劳动路 707 弄 218 号 7 幢
注册号	310114002374388
邮编	201808
经营范围	集成电路封装、测试，集成电路测试软件开发，从事货物与技术的进出口业务。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营]

公司目前持有上海翔芯 8.67% 的股权，上海翔芯设立于 2012 年 3 月 21 日，经第一届第八次董事会审议通过，公司决定入股上海翔芯，增资金额 260 万元。2013 年 6 月 3 日，上海佳安会计师事务所出具佳安会验（2013）第 2479 号《验资报告》，验证芯朋股份已经足额缴纳新认购的注册资本。该变更于 2013 年 6 月 7 日完成工商变更。

上海翔芯的股东情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)
1	金明良	500.00	500.00	16.67
2	陆宗耀	300.00	300.00	10.00
3	上海翔芯电子科技有限公司	300.00	300.00	10.00
4	无锡芯朋微电子股份有限公司	260.00	260.00	8.67
5	高晋	225.00	225.00	7.50
6	卞美瑛	150.00	150.00	5.00
7	高彩芳	150.00	150.00	5.00
8	宁海诚芯电子科技有限公司	150.00	150.00	5.00
9	沈明	150.00	150.00	5.00
10	汤剑刚	150.00	150.00	5.00
11	夏志强	150.00	150.00	5.00
12	张中标	150.00	150.00	5.00

13	蔡洁	100.00	100.00	3.33
14	郁庆明	75.00	75.00	2.50
15	郑世忠	75.00	75.00	2.50
16	丁善明	50.00	50.00	1.67
17	金海波	25.00	25.00	0.83
18	李华	25.00	25.00	0.83
19	杜浩华	15.00	15.00	0.50
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

公司的股东、董事、监事、高级管理人员均未通过芯朋股份外的其他公司或个人直接或间接持有上海翔芯的股份。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	11,315.26	10,222.98	8,593.50
负债总计（万元）	3,529.05	3,138.29	3,085.12
股东权益合计（万元）	7,786.21	7,084.69	5,508.38
归属于母公司所有者的股东权益合计（万元）	7,786.21	7,084.69	5,508.38
每股净资产（元）	3.80	3.48	2.75
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.80	3.48	2.75
资产负债率（母公司）	46.13%	31.83%	43.32%
流动比率（倍）	4.21	4.75	4.18
速动比率（倍）	2.97	3.65	2.92
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	7,613.03	13,061.27	12,184.72
净利润（万元）	1,111.52	1,616.31	1,214.44
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,111.52	1,616.31	1,214.44
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	864.54	557.24	504.31

归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	864.54	557.24	504.31
毛利率（%）	34.85	33.00	29.14
净资产收益率（%）	14.55	25.39	23.20
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	11.32	8.75	9.63
基本每股收益（元/股）	0.5422	0.7933	0.6072
稀释每股收益（元/股）	0.5422	0.7933	0.6072
应收账款周转率（次）	2.79	5.34	5.77
存货周转率（次）	1.87	3.65	3.68
经营活动产生的现金流量净额（万元）	403.29	1,550.55	1,475.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20	0.76	0.74

六、本次公开转让有关机构情况

（一）主办券商

名称	上海证券有限责任公司
法定代表人	龚德雄
住所	上海市黄浦区西藏中路 336 号
联系电话	021-53519888
传真	021-63609593
项目负责人	马奕彤
项目小组成员	马奕彤、徐婉琼、吴瞳琦、张涛、胡刚

（二）律师事务所

名称	北京德恒律师事务所
法定代表人	王丽
住所	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话	010-52682888
传真	010-52682999
经办人	郑碧筠、曾家煜、谭翠燕

（三）会计师事务所

名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
法定代表人	张彩斌
住所	无锡市新区开发区旺庄路生活区
联系电话	0510-85888988
传真	0510-85885275
经办人	柏凌菁、薛敏

(四) 资产评估机构

名称	江苏中天资产评估事务所有限公司
法定代表人	何宜华
住所	常州市天宁区博爱路 72 号
联系电话	0519-88157878
传真	0519-88155675
经办人	陈小明、荣季华

(五) 证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话	0755-25938000
传真	0755-25988132

第二章 公司业务

一、公司主要产品情况

（一）主营业务

无锡芯朋微电子股份有限公司（网址：www.chipown.com.cn）是一家专业从事模拟及数模混合集成电路设计的高科技创新企业，总部位于江苏省无锡市高新技术开发区内，并在苏州和深圳分别设有研发中心和客户支持服务中心。公司成立于 2005 年，专注于开发绿色电源管理芯片，为客户提供性价比高、品质稳定的集成电路产品，同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务。

公司具有国内领先的研发实力，特别在高低压集成半导体技术方面更是拥有业内一流的研发团队。公司在国内创先开发成功并量产了单芯片 700v 高低压集成开关电源芯片、200V SOI MOS/LIGBT 集成芯片、100V CMOS/LDMOS 集成芯片等产品，获得国家/省部级科技奖励和国家重点新产品认定。公司拥有国家级博士后企业工作站和由中国工程院院士领衔的江苏省功率集成电路工程技术中心，是国家工信部认定的集成电路设计企业、科技部认定的高新技术企业，江苏省民营科技企业，江苏省创新型企业，承担并完成了多项国家级的科研开发任务项目，得到各级政府的嘉奖和支持，并在各类行业评比中多次获得奖项。

公司具有完备的 ISO9001 质量体系，主要产品包括多种电源管理集成电路（AC-DC、DC-DC、LED Driver、Display Driver、Charger 等）和功率晶体管 MOSFET，广泛应用于个人电脑及周边产品、移动电话、个人数字终端、家电产品、平板显示系统等领域，终端客户包括美的、TCL、韩国三星等，目前，公司已发展成为国内家电行业、手持设备行业电源类芯片的领先供应商。

（二）主要产品及其用途

公司的产品按大类可分为两类：集成电路产品和功率晶体管产品。其中，集成电路占公司收入 90% 以上，为公司主导产品，主要应用于手持设备、家电、LED 照明、机顶盒、适配器等市场。功率晶体管产品主要作为电子系统中的电能传输开关，在未来公司产品中的比重将进一步降低。

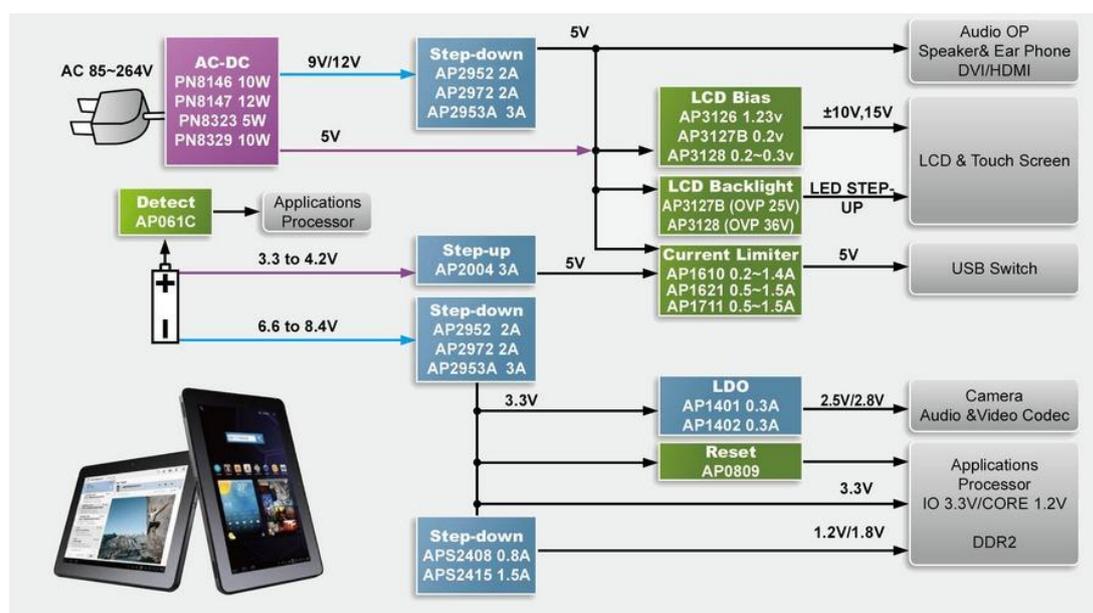
公司主导产品集成电路的类型及其功能用途归纳如下：

1、按照终端应用方式划分的产品类型及其用途

(1) 手持设备应用芯片

(1.1) 平板电脑

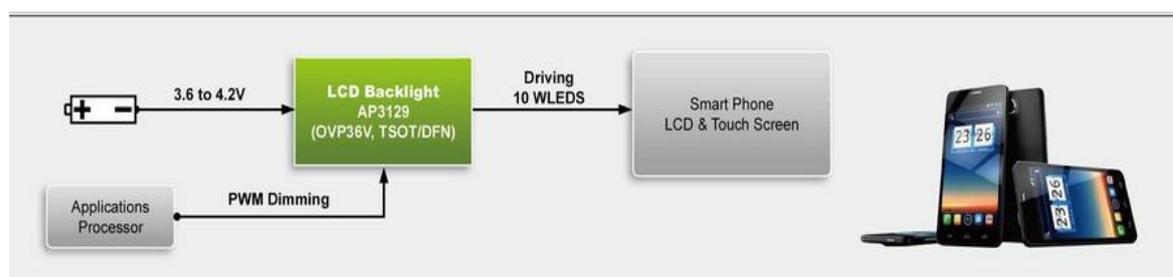
公司针对平板电脑系统提供从 AC/DC、到升降压 DC/DC、以及 LED 背光、USB 限流、复位等全系列的电源管理芯片产品及其解决方案，为客户提供各类平板电脑的电源管理系统配套方案。



图、应用于平板电脑的电源方案

(1.2) 智能手机

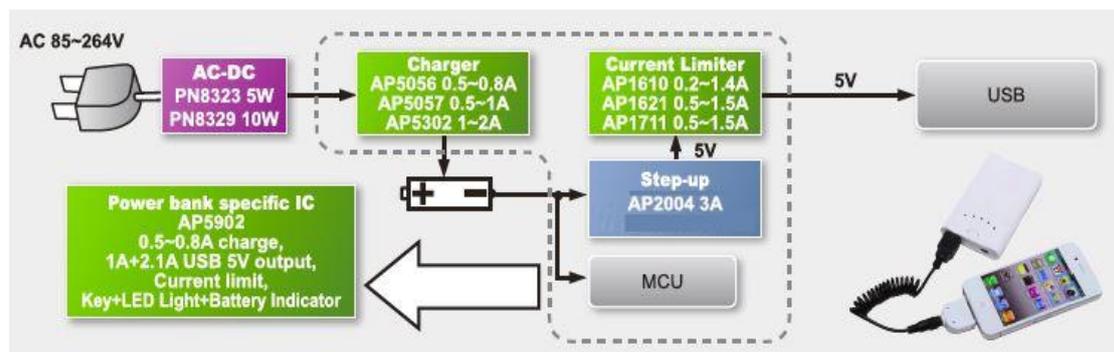
公司目前针对智能手机推出了性价比高、品质稳定、专用的 LED 背光高压驱动芯片产品。



图、应用于智能手机的电源方案

(1.3) 移动电源

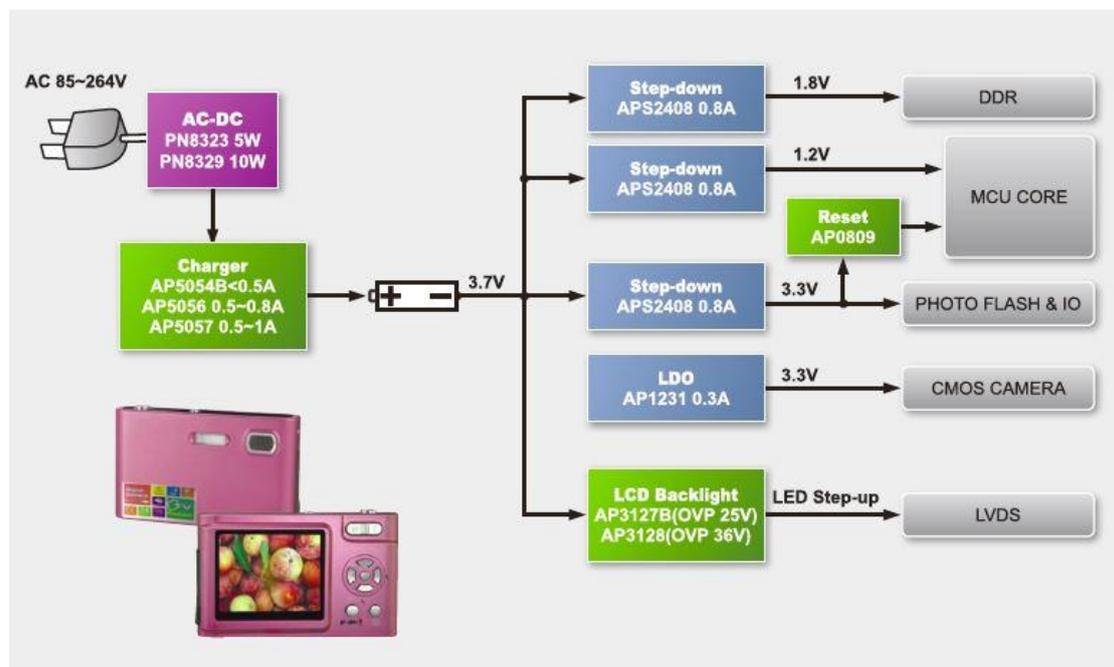
公司为移动电源系统提供各类分立式系统方案，包括 AC/DC、升压 DC/DC、USB 限流、锂电充电管理等全系列的电源管理芯片产品，近期公司为客户提供更加先进的集成了线性锂电充电，电量指示，异步升压的三合一内置 MCU 的移动电源专用芯片，大幅减少 BOM 数量，减少 PCB 面积。



图、 应用于移动电源产品的电源方案

(1.4) 其他

其他手持产品还包括：移动影碟机\掌上游戏机\电子玩具\导航仪\鼠标\数码相机等。以数码相机为例,示意图如下：

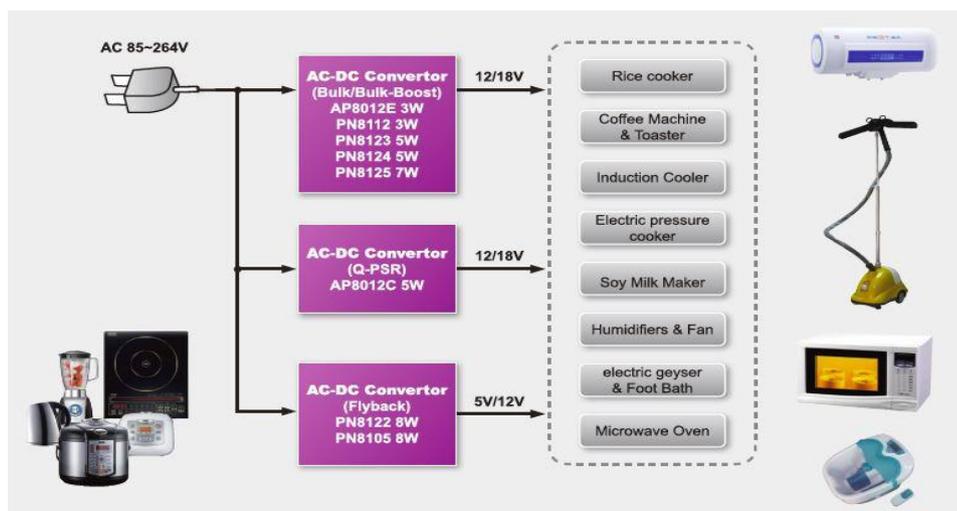


图、 应用于其它便携产品的电源方案

(2) 家用电器应用芯片

(2.1) 厨卫家电

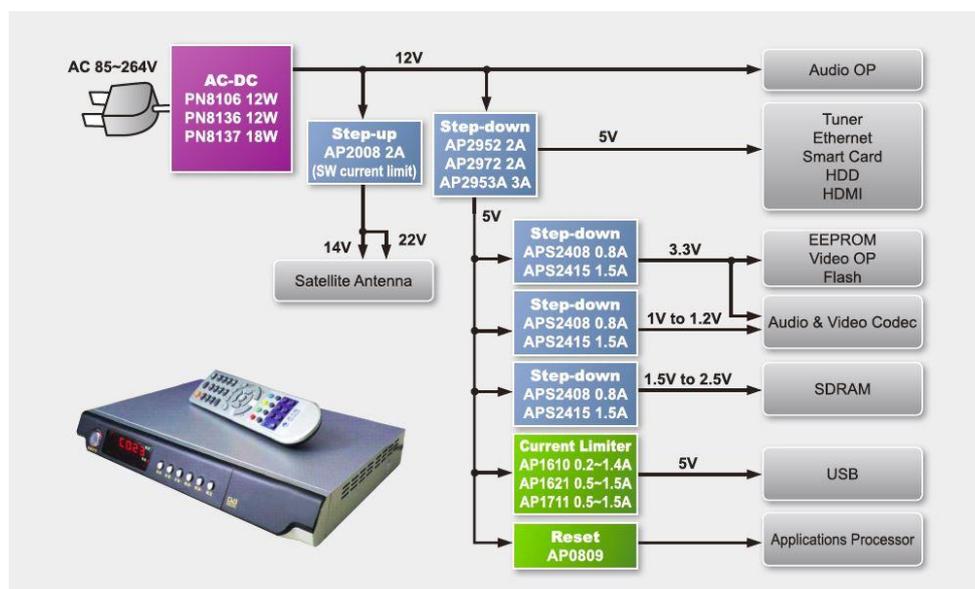
公司可为各式家用电器(包括白电和黑电)提供电源管理解决方案, 为广大生活家电制造企业提供 1~24W 非隔离 Buck/Boost、1-90w 隔离 Flyback/PSR 的一站式的完整 AC/DC 解决方案, 使客户的系统性能优秀、灵活可靠, 并具有成本竞争力。应用范围包括:生活家电、厨卫家电、健康家电等。



图、 应用于厨房家电的电源方案

(2.2) 机顶盒

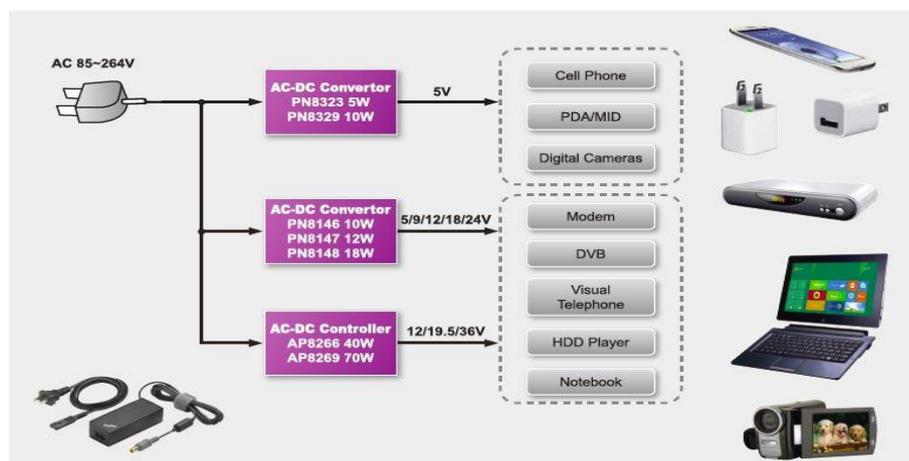
公司在机顶盒领域具备比较完备的电源管理芯片产品。公司可提供从 AC/DC、到升降压 DC/DC、以及 USB 限流、复位等全系列产品, 使客户的 DVB-T、DVB-C、DVB-S 等机顶盒的电源系统性能优秀、灵活可靠, 并具有成本竞争力。



图、 应用于机顶盒的电源方案

(2.3) 适配器

芯朋在适配器和充电器领域具备比较完整功率段的 AC/DC 电源芯片产品。公司提供 5~10W 内置高压启动及功率管的 PSR 系列、10~18W 内置高压启动及功率管的 Flyback 系列、15~90W 外置 MOS 控制器系列等多种架构的产品，并提供高性价比、性能优异、品质稳定的 Adapter/Charger 系统参考设计方案。

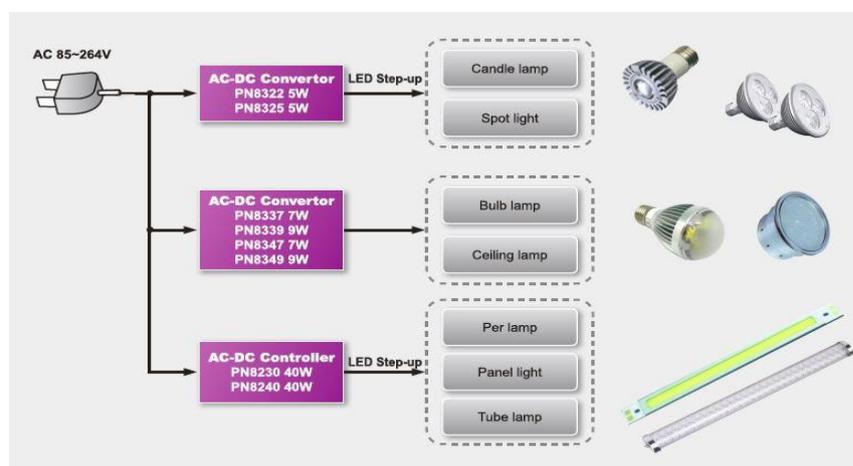


图、应用适配器的电源方案

(3) LED 照明应用芯片

公司在高温高湿的家电类苛刻应用中积累了丰富的 AC/DC 可靠性设计技术，并将这些技术陆续应用到 LED 照明驱动 IC 产品中，业已成为公司当前主力开发的新产品方向之一。

公司可为 LED 照明灯具提供 1~40W 隔离/非隔离的较完整的 AC/DC 解决方案，包括双绕组内置高压启动的 3~5W 系列、单级 PFC 内置开关 MOS 及高压启动的 7~20W 系列、单级 PFC 外置 MOS 的 40W 控制器系列，并提供品质稳定的各类 LED 驱动配套方案。



图、应用于 LED 照明的电源方案

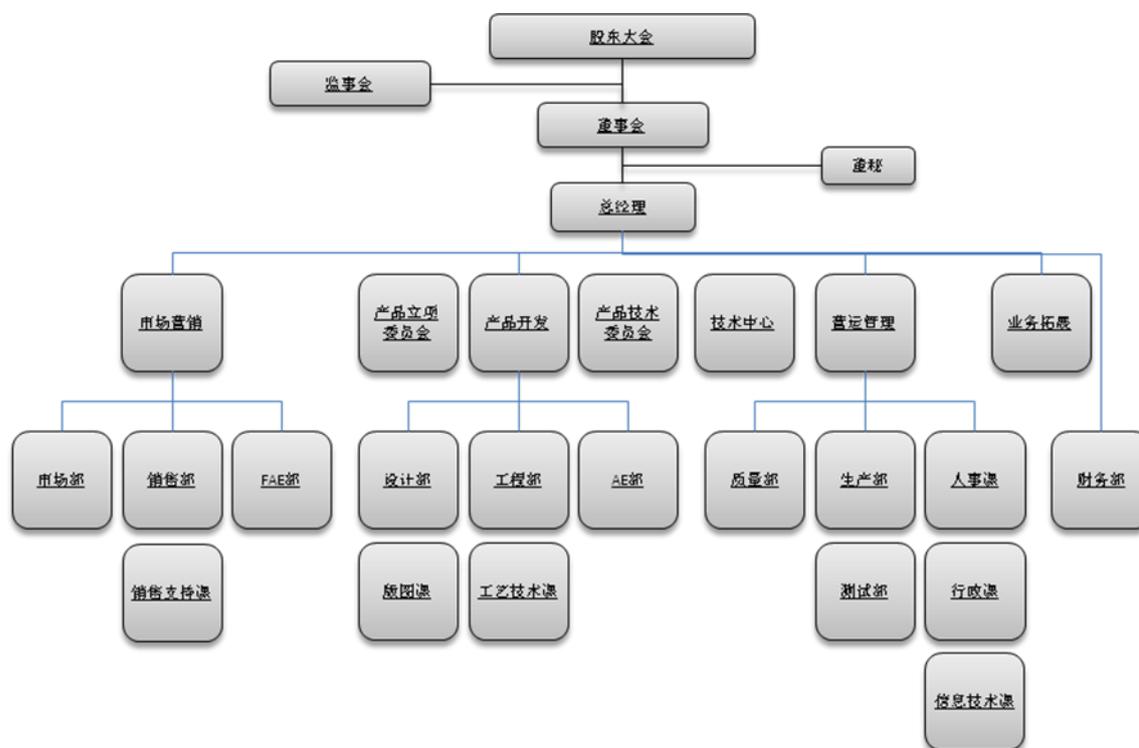
2、按照高压/低压产品线划分的产品类型及其用途

大类	产品线	代表芯片型号
LV 低压产品线	LDO-低压差线性稳压器	AP1231 AP1401 AP1402 ...
	DC/DC (Boost) 升压型直流/直流转换芯片	AP2000 AP2066 AP2004 AP2008 ...
	DC/DC (Buck) 降压型直流/直流转换芯片	AP2406L AP2406 APS2406 ...
	LED Backlight-LED 背光驱动芯片	AP3126 AP3127 AP3128...
	Battery Charger 充电管理芯片	AP5054 AP5056 AP5057...
	Current Limiter 限流器芯片	AP1610 AP1621 AP1711...
	Reset & Detect 复位/电压检测芯片	AP0809 AP061...
HV 高压产品线	AC/DC (SSR) 交直流隔离式次级反馈开关电源转换芯片	PN8105 PN8106 PN8136 PN8137 PN8122 AP8012 AP8266 AP8269...
	AC/DC (PSR) 交直流隔离式原边反馈开关电源转换芯片	PN8323 PN8329 PN8322 PN8325 PN8347 PN8349 PN8240...
	AC/DC (Non-isolated) 交直流非隔离式开关电源转换芯片	AP8012 PN8112 PN8124 PN8125 PN8337 PN8339 PN8230...
	NeoFET 超结功率晶体管	PN4HN60 PN10HN60....

除集成电路产品外，公司目前仍生产少量功率晶体管产品，功率晶体管在电子系统中作为信号放大或大功率的半导体开关，是一类通用型的半导体器件。公司销售的功率晶体管品种不多，主要包括几种 DMOS 功率开关管，用于电动自行车的电机驱动和交直流转换器中的功率开关。公司开发这类器件是出于器件工艺的基础研究的考量，并为开发特殊规格的专用功率器件作好技术储备。由于该产品竞争激烈，技术门槛相对要低，因此，公司正在逐步地收缩普通功率晶体管的业务。

二、公司主要生产流程及方式

（一）公司内部组织结构图



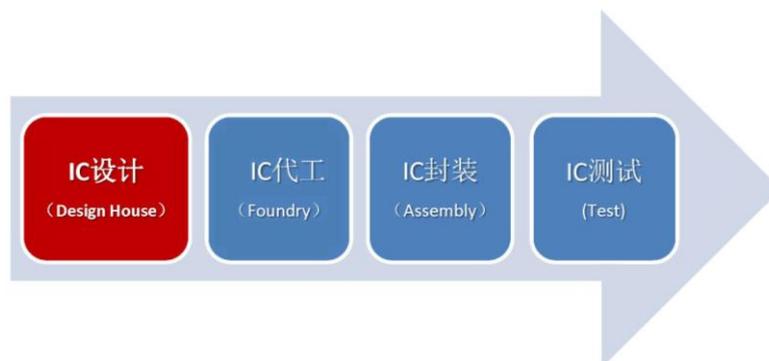
图、公司内部组织结构图

（二）公司主要生产和服务流程及方式

IC 产业链通常由 IC 设计制造、经销商分销及终端电子产品生产制造三个环节构成，IC 设计制造可以进一步分为 IC 设计、晶圆代工、封装测试三个生产环节。十一五期间，我国集成电路产业形成了芯片设计、芯片制造和封装测试三业并举、较为协调的发展格局。设计业销售收入占全行业比重逐年提高，由 2005 年的 17.7 % 提高到 2010 年的 25.3%；芯片制造业比重保持在 1/3 左右。（《集成电路产业“十二五”发展规划》）

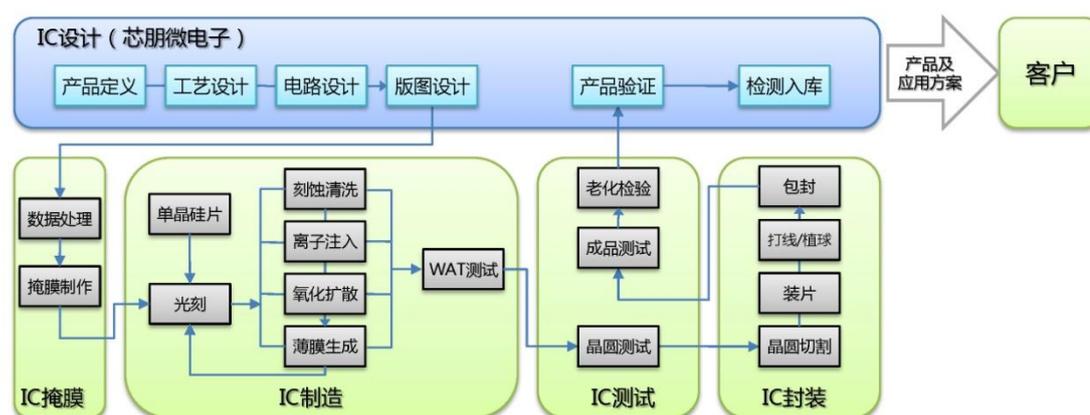
三者之间的生产环节关系表现为：晶圆代工指根据委托企业的 IC 设计，将设计数据分次刻录在晶圆上，收取代工费。封装测试企业将制作好的晶圆进行切割并封装形成最终 IC 产品，经过测试后将合格品交付设计企业，并收取相应加工费用。从生产流程上来看，IC 设计企业根据终端电子产品需求进行集成电路布图设计，并委托厂商进行晶圆代工，芯片封装测试，待芯片生产完毕后，交付经销商经销或者直接交付终端电子厂商进行应用。由于晶圆加工等产业通常需要大量的资金投入进行生产线

设备购买，且设备处于不断升级换代之中，因此属于资本密集型及技术密集型产业，目前国内大部分集成电路设计企业均采用 Fabless 模式（无工厂生产模式）进行。



图、 IC 产业流程简图

本公司也采用了 Fabless 模式进行运营，即将集成电路的晶圆生产、芯片制造、封装测试（包括中测和绝大部分终测）外包，专注于集成电路设计产业。无工厂生产模式既符合集成电路垂直分工产业链的特点，也契合了国际市场上集成电路设计占整个行业产值比重愈来愈高的发展趋势。根据终端产品市场需求变化，公司将抽象的产品设计要求转化为特定元器件组合，并通过晶圆生产商在硅片上实现芯片的物理形态。目前公司已经与华润上华、天水华天、长电科技等集成电路生产企业建立了稳定合作关系，向其进行晶圆采购以及委托其进行芯片中测、封装及成测，实现产业链的一体化构建。



图、 生产工艺流程示意

公司的生产和服务流程可简要概括如下：设计人员根据市场需求定义好产品的参数、功能及一系列指标，并据此进行元器件和布图设计，设计生成数据带。之后，将数据带发送至加工厂（foundry）进行流片制造，并经测试论证，证明性能符合规格要求后，定义为设计成功，投入规模生产。产品量产后，由公司销售部门通过代理或直

接销售的方式销售给终端用户，实现盈利和资金回笼。

公司的工艺流程可简要概述为：IC 规格定义——IC 设计——委托晶圆加工——委托晶圆测试——委托封装及成品测试——合格品验收入库。

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）产品所使用的主要技术情况

电源管理芯片作为商用化产品的核心关键在于其可靠性和一致性，此类模拟类产品主要取决于器件的可靠性和加工工艺的稳定。芯朋股份在器件结构设计、模拟电路设计以及工艺开发上投入了大量的资源，拥有国内一流的器件和工艺团队。根据产品特点，公司和圆片加工厂合作开发了多种特色工艺，保证了产品的高可靠性和低上机失效率。

公司自成立以来，即对研发取得的技术成果不断进行总结，形成自主知识产权的各项专利，至今累计取得 29 项专利授权，其中国内发明专利授权 20 项，国内实用新型专利授权 8 项，美国专利授权 1 项；另有 24 项国内发明专利和 1 项实用新型专利申请已在受理之中。这些专利覆盖了公司产品涉及的电路、器件结构、制备工艺的多个技术领域，可以从多方面保障公司产品的竞争力。

每个集成电路产品设计的最终成果就体现在用于集成电路制造加工的几何图形的组成上，这就是集成电路的版图。版图的设计集中了电路、器件、工艺、封装、测试的所有信息，是一种服从技术规格的“艺术化”的创造工作，其形貌特征也是受到专门保护的，公司共取得了 47 项集成电路版图保护授权，有效地防止了竞争对手的抄袭行为。

1、产品所使用的主要技术

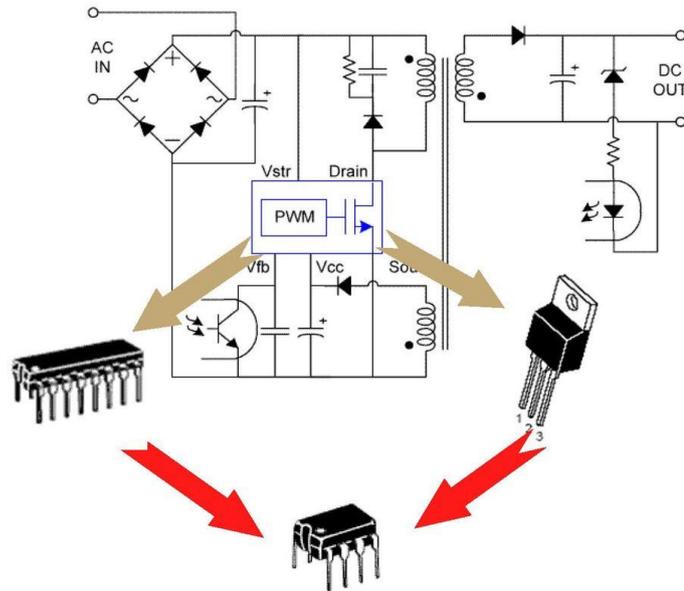
公司产品以市场需求为导向，并自主研发设计。公司在电源管理类芯片的设计开发中，取得了一系列核心专有技术及相关专利。这些专有技术的效应体现在：通过优化设计，可使电源管理产品的输出电压（或电流）稳定、可靠性高、效率更高、功耗更低，以适应集成化、智能化、节能环保的行业发展趋势。

公司的核心技术主要包括新型的开关/启动/采样单片全集成的开关电源电路及其器件工艺结构、新型集成型 700v 功率 MOS 器件结构及集成工艺、高可靠性的开关电源高压防闩锁电路及其版图技术、低功耗低开启低导阻的 7~25v 器件工艺技术等，

概要说明如下：

(1) 新型的开关/启动/采样单片全集成的开关电源电路及其器件工艺结构

本技术应用于功率开关电源芯片领域，具体涉及一种带电流采样和启动结构的半导体装置，近年来，随着开关电源集成电路的不断发展，人们开始越来越追求芯片工作的高效率和低成本。本技术通过把高压启动结构、电流采样结构与功率开关集成在一起，特殊高压晶体管和电阻作为启动结构，结构面积小，成本低，能够实现与低压控制芯片的自隔离；由掺杂的多晶硅在耐压区上绕制而成的螺旋场极板，能够降低耐压区域表面电场，提升器件的可靠性，并且大大节省了芯片面积，能够降低电路启动的损耗，降低功率管电流采样损耗。同时把开关、启动、采样集成在一个硅片上，能够实现更加智能安全的启动、更高的集成度和更低的系统方案成本，显著提高公司产品的竞争力。

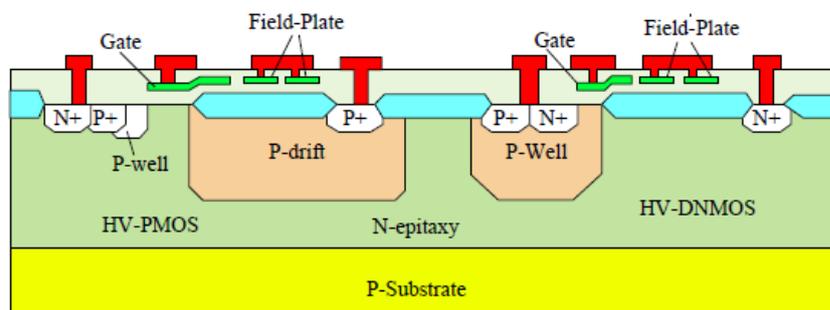


图、集成新型功率管的单芯片交直流转换技术

(2) 新型集成型 700v 功率 MOS 器件结构及集成工艺

本项目基于标准外延 CMOS 工艺，国际上首次提出了 200~800V 集成型 LDMOS、VDMOS 结构及高低压集成 BCD 工艺。该工艺很好地解决了 700V、800V 高压器件集成时所遇到的隔离难度大、工艺兼容要求高等问题。其中还特别提出了带复合场极板的功率 MOS 器件结构，相同条件下该结构可使器件表面击穿电压提高 20% 以上。场极板可以降低电场峰值的绝对值，本技术采用多晶硅和铝等多重、多块场极板的复合结构，大大提高了外延功率 MOS 器件的耐压和可靠性。该项目获得了

江苏省科技厅 2008 年重大科技成果转化项目支持，产品达到了国际领先水平，填补了国内空白。



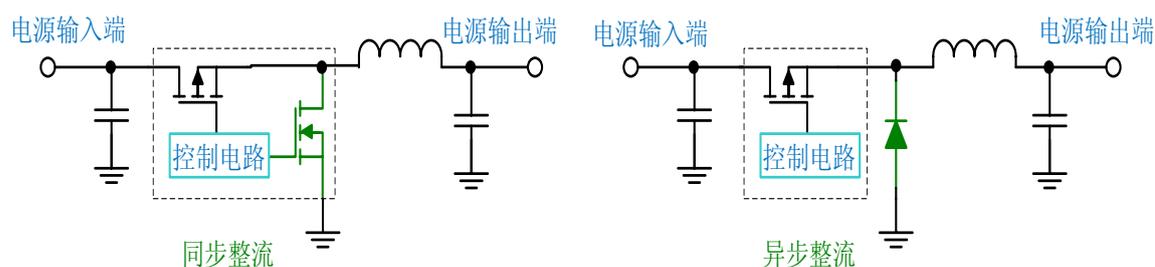
图、集成高压功率MOS器件结构示例之一

(3) 高可靠性的开关电源高压防闩锁电路及其版图技术

本公司提出了一种防止体硅高压 MOS 电路发生闩锁的新方法。功率 MOS 集成电路由于应用方式上的特殊性，不可避免地在衬底中会产生一定的位移电流，由于是共用衬底的体硅工艺，该位移电流很容易触发低压部分的寄生 PNP 结构从而形成闩锁。芯朋在低压部分设计特殊结构的多子保护环，在高低压之间设计特殊结构的少子保护环，采用现有制备层次不额外增加生产成本的同时提高电路闩锁触发电流 5 倍以上。该技术同时可以减小高低压电路之间的串扰问题，已在 AC-DC 等开关电源芯片中得到广泛应用，大幅提高了公司产品的可靠度。

(4) 低功耗低开启低导阻的 7~25v 器件工艺技术

本公司基于 0.25um 8 英寸工艺平台，开发出 7~25v 系列超低导通电阻开关器件，采用 N/P 管多边形栅极来获得最小的栅电容和导通电阻，并明显优化降低了功耗和开启电压；同时配套设计了超简洁工艺层次，相同性能下比普通工艺节省了 20~50% 的成本。基于此器件工艺设计的同步/异步整流 DC-DC 芯片广泛应用于各类数码、家电和通讯产品。客户反馈公司该种类芯片的品质稳定，调试方便、产线直通率高，目前产品已在平板电脑等便携设备市场上占据了主要份额。



图、开关电源的拓扑结构

2、产品的可替代性

作为电源管理芯片这个产品门类，是所有电子电器整机行业必不可少的基础性元器件，因此其生命周期较长，在可预见的将来这个芯片门类是具有不可替代性的。公司的具体产品存在功能可替代性，但是这种替代是公司应对市场，自主研发和不断创新的升级换代和主动替代。

公司对现有产品不断提升性价比，以满足客户的需求、扩大市场份额。同时，围绕公司目前占据优势地位的家电、手持设备等市场持续开发新的产品种类。此外，公司建立了中长期策略性产品技术的开发团队，计划在未来两年陆续推出新产品线。通过持续开发，公司不断降低产品成本，提升性能价格比，在竞争中取得优势。

（二）研发机制和研发投入

1、研发机构

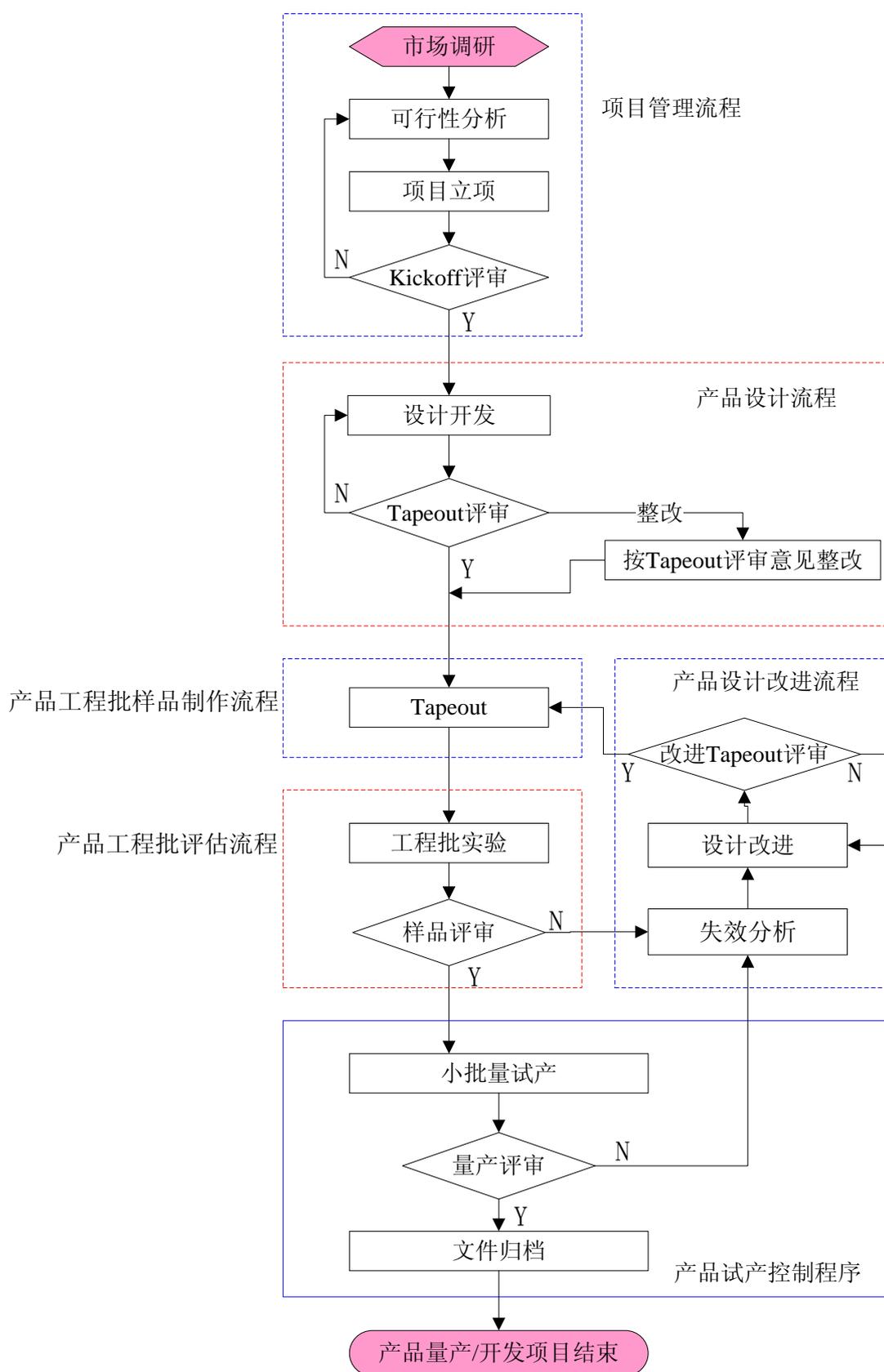
公司具有国内领先的研发实力，在高低压集成技术方面拥有业内一流的研发团队。公司拥有国家级博士后企业工作站和由中国工程院院士领衔的江苏省功率集成电路工程技术中心，并通过与高校和代工厂结成的战略研发联盟，具备了较为完整的功率器件和 IC 的直流参数和动态参数测试技术与装备。

公司设有“产品开发部”作为公司的研发机构，全面负责公司产品的开发工作。为配合其开展工作，另设有“产品立项委员会”和“产品技术委员会”，以及承担前期技术论证研究的“技术中心”。

产品立项委员会从市场、技术、加工等各方面全面评估产品是否能够立项开发；产品技术委员会从技术角度对开发过程中的技术问题作出判断，决定产品的技术方案取舍；技术中心以专家教授和博士生、硕士生为主组成，是公司与高校日常合作的重要形式，对公司拟采用的新技术开展前期研究，同时对在研产品碰到的关键技术难题开展研究并加以解决。

产品开发部下设计划部、版图课、技术课、工程部和应用部，其分工架构为：应用部制定产品规格，工艺技术课提供加工工艺规则，设计部按产品规格和工艺规则设计电路内部参数，版图课依据工艺规则设计版图，工程部负责外加工过程的监管和产品的生产测试程序设计，样品交应用部评测判定。

2、核心技术的研发流程及产品更新换代计划



公司针对手持设备等数码消费类电子整机的芯片产品换代周期通常为 1~2 年，针对家电和机顶盒等较稳定的整机市场的芯片产品换代周期通常为 2~3 年，公司核心产品的开发周期节奏即配合上述市场换代时间要求，通过持续开发，公司开发目标是每一代产品降低 30% 成本，并适当提升关键性能，尽可能减少外围系统元器件数量，在激烈的市场竞争中取得持续的优势。

3、研发投入

报告期间，公司研发费用占营业收入比例较大，且较为平稳，不存在研发费用资本化的现象。

研发费用支出表

(单位：元)

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
研发费用	11,403,971.80	26,379,875.39	18,845,323.68
营业收入	76,130,303.75	130,612,694.25	121,847,211.91
研发费用占营业收入比重	14.98%	20.20%	15.47%

4、自主技术占核心技术的比重

公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织及经验丰富的研发人员，公司产品所采用的核心技术均为自主研发。

(三) 知识产权及无形资产情况

截至本说明书签署之日，公司拥有的知识产权情况如下：

1、已授权专利

公司及子公司拥有已授权的专利共 29 项，如下表所示：

序号	公司名称	专利名称	专利申请号	类型	申请日	授权公告日
1	芯朋股份	一种用于集成电路测试的简便方法及其测试电路	ZL200810022639.4	发明	2008.7.18	2010.10.15
2	芯朋股份	一种低纹波可吸电流的开关电源的控制方法	ZL200910181799.8	发明	2009.7.24	2011.5.18

3	芯朋股份	一种数模转换控制的 DC-DC 开关电源软启动电路	ZL200910234284.X	发明	2009.11.16	2012.5.23
4	芯朋股份	一种高精度电压基准电路	ZL200910264576.8	发明	2009.12.28	2011.8.31
5	芯朋股份	一种大负载电流范围的 DC-DC 控制电路	ZL201010100512.7	发明	2010.1.25	2012.3.21
6	芯朋有限	一种同步峰值电流控制模式脉宽调制 DC/DC 转换器	ZL200820040681.4	实用新型	2008.7.18	2009.4.29
7	芯朋有限	一种采用二极管架构的低压电平转高压电平电路	ZL201020610015.7	实用新型	2010.11.17	2011.6.29
8	芯朋有限	一种采用三极管串联结构的高压转低压电源电路	ZL201020611759.0	实用新型	2010.11.18	2011.6.29
9	芯朋有限	一种用于芯片使能零关断电流的高压转低压电源电路	ZL201120407304.1	实用新型	2011.10.24	2012.7.4
10	芯朋有限	一种高压电荷泵控制电路	ZL201120426608.2	实用新型	2011.11.2	2012.7.4
11	芯朋有限	一种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路	ZL201120469692.6	实用新型	2011.11.23	2012.8.29
12	芯朋股份	一种 DIP 双岛引线框结构	ZL201220194878.X	实用新型	2012.5.3	2012.12.5
13	苏州博创	MOS 型过温保护电路	ZL200710021444.3	发明	2007.4.12	2009.6.17
14	苏州博创	绝缘体上硅的高压 p 型金属氧化物半导体管	ZL200910036003.X	发明	2009.10.15	2011.5.11
15	苏州博创	绝缘体上硅的深槽隔离结构的填充方法	ZL200910036001.0	发明	2009.10.15	2011.5.11
16	苏州博创	绝缘体上硅的深槽隔离结构刻蚀及填充方法	ZL200910036002.5	发明	2009.10.15	2011.5.11

17	苏州博创	带表面缓冲环终端结构的超结金属氧化物场效应晶体管	ZL201010146489.5	发明	2010.4.13	2011.11.23
18	苏州博创	一种超结纵向双扩散N型金属氧化物半导体管	ZL201110255268.6	发明	2011.9.1	2013.3.20
19	苏州博创	超结纵向双扩散金属氧化物场效应管的终端结构	US8,482,064B2	发明	2012.6.11	2013.7.9
20	苏州博创	频率抖动电路	ZL200820034250.7	实用新型	2008.4.18	2009.1.21
21	苏州博创	N型绝缘体上硅的横向双扩散金属氧化物半导体晶体管	ZL200910032305.X	发明	2009.6.10	2010.12.29
22	苏州博创	P型绝缘体上硅的横向双扩散金属氧化物半导体晶体管	ZL200910032304.5	发明	2009.6.10	2012.5.23
23	苏州博创	集成增强型和耗尽型垂直双扩散金属氧化物场效应管	ZL200710134474.5	发明	2007.10.30	2009.2.25
24	苏州博创	绝缘体上硅横向双扩散金属氧化物半导体管及制备方法	ZL200910212767.X	发明	2009.11.9	2011.5.11
25	苏州博创	纵向高压硼扩散深槽半导体管的制备方法	ZL200910185324.6	发明	2009.11.5	2012.6.6
26	苏州博创	绝缘体上硅的横向绝缘栅双极晶体管及工艺制造方法	ZL200910212763.1	发明	2009.11.9	2012.1.4
27	苏州博创	绝缘体上硅的正反导通横向绝缘栅双极晶体管	ZL200910212766.5	发明	2009.11.9	2012.2.22
28	苏州博创	绝缘体上硅的横向P型双扩散金属氧化物半导体管	ZL200910212768.4	发明	2009.11.9	2012.9.26
29	苏州博创	等离子显示驱动芯片用高低压器件及制备方法	ZL200910212764.6	发明	2009.11.9	2011.5.25

2、正在申请中专利

本公司及子公司正在申请的专利共 25 项，如下表所示：

序号	公司名称	专利名称	专利申请号	类型	申请日
1	芯朋股份	一种采用二极管架构的低压电平转高压电平电路	201010546926.2	发明	2010.11.17
2	芯朋有限	一种使能控制电路	201010548047.3	发明	2010.11.18
3	芯朋有限	一种使用三极管串联结构的高压转低压电源电路	201010548213.X	发明	2010.11.18
4	芯朋有限	一种开关电源高效率自适应振荡频率的调制方法	201010549935.7	发明	2010.11.19
5	芯朋有限	一种电荷泵控制电路	201010549828.4	发明	2010.11.19
6	芯朋有限	一种采用高压耗尽 NMOS 管结构的高压转低压电源电路	201010549830.1	发明	2010.11.19
7	芯朋有限	一种高电源抑制比的电压基准电路	201010549933.8	发明	2010.11.19
8	芯朋股份	一种用于芯片使能零关断电流的高压转低压电源电路	201110324839.7	发明	2011.10.24
9	芯朋股份	一种高压电荷泵控制电路	201110341277.7	发明	2011.11.2
10	苏州博创	一种高低压集成的工艺器件及其制备方法	201010265799.9	发明	2010.8.30
11	苏州博创	一种纵向超结金属氧化物场效应晶体管器件及其制备方法	201010265789.5	发明	2010.8.30
12	苏州博创	一种减小补偿电容的跨导放大器	201010549557.2	发明	2010.11.18
13	苏州博创	一种扫频点火检测与控制的方法及实现电路	201010599333.2	发明	2010.12.21
14	苏州博创	一种压控频率扫描振荡器	201010599323.9	发明	2010.12.21
15	苏州博创	一种低电磁干扰低功耗高压驱动电路	201110107249.9	发明	2011.4.28
16	苏州博创	一种非隔离的开关电源电路	201110107256.9	发明	2011.4.28
17	苏州博创	一种单向导通的高压启动电路	201110107257.3	发明	2011.4.28
18	苏州博创	超结纵向双扩散金属氧化物场效应管的终端结构	201110281585.5	发明	2011.9.21
19	苏州博创	一种高压启动电路	201210034730.4	发明	2012.2.16

20	苏州博创	一种低功耗高压驱动电路及其使用的双向 P 型开关管	201210183438.9	发明	2012.6.6
21	苏州博创	具有电流采样和启动结构的半导体装置	201310112448.8	发明	2013.4.2
22	苏州博创	短路保护结构	201310230700.5	发明	2013.6.13
23	苏州博创	一种 CMOS 型高低压集成的工艺器件结构及其制备方法	201310191040.4	发明	2013.5.23
24	苏州博创	一种高功率低功耗高压驱动电路	201310216675.5	发明	2013.6.4
25	苏州博创	一种精简的非隔离开关电源电路	201320018913.7	实用新型	2013.1.15

3、集成电路布图设计专有权

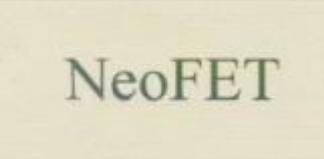
公司及子公司拥有的集成电路布图设计专有权共 47 项，如下表所示：

序号	公司名称	设计名称	登记证书号	申请日	授权日期	授权号
1	芯朋有限	B0601	第 1322 号	2006.10.18	2007.4.17	BS.06500297.0
2	芯朋有限	VC0601	第 1453 号	2007.8.30	2007.10.22	BS.07500218.3
3	芯朋有限	C0606	第 1454 号	2007.8.30	2007.10.22	BS.07500219.1
4	芯朋有限	C0701	第 1825 号	2008.2.15	2008.6.16	BS.08500041.8
5	芯朋有限	C0721	第 1862 号	2008.5.5	2008.7.2	BS.08500142.2
6	芯朋有限	C0758	第 1861 号	2008.5.5	2008.7.2	BS.08500141.4
7	芯朋有限	C0801	第 1863 号	2008.5.5	2008.7.2	BS.08500143.0
8	芯朋有限	C0808	第 1860 号	2008.5.5	2008.7.2	BS.08500140.6
9	芯朋有限	C0711	第 2268 号	2008.11.2	2008.12.22	BS.08500554.1
10	芯朋有限	C0765	第 2267 号	2008.11.2	2008.12.22	BS.08500553.3
11	芯朋有限	C0761	第 2353 号	2008.12.3	2009.2.6	BS.08500654.8
12	芯朋有限	C0803	第 2352 号	2008.12.3	2009.2.6	BS.08500655.6
13	芯朋有限	C0807	第 2909 号	2009.8.28	2009.11.19	BS.09500531.5
14	芯朋有限	C0811	第 2910 号	2009.8.28	2009.11.19	BS.09500532.3
15	芯朋有限	C0815	第 2908 号	2009.8.28	2009.11.19	BS.09500533.1
16	芯朋有限	C0816	第 2902 号	2009.8.28	2009.11.19	BS.09500534.X

17	芯朋有限	C0720	第 3288 号	2010.2.2	2010.5.18	BS.10500053.1
18	芯朋有限	C0813	第 3301 号	2010.2.2	2010.5.18	BS.10500054.X
19	芯朋有限	C0905	第 3302 号	2010.2.2	2010.5.18	BS.10500055.8
20	芯朋有限	C0906	第 3289 号	2010.2.2	2010.5.18	BS.10500056.6
21	芯朋有限	C0908	第 3290 号	2010.2.2	2010.5.18	BS.10500057.4
22	芯朋有限	C0909	第 3291 号	2010.2.2	2010.5.18	BS.10500058.2
23	芯朋有限	C0912	第 3292 号	2010.2.2	2010.5.18	BS.10500059.0
24	芯朋有限	C1001	第 4094 号	2010.10.19	2011.1.24	BS.10500792.7
25	芯朋有限	C1005	第 4095 号	2010.10.19	2011.1.24	BS.10500793.5
26	芯朋有限	C1008	第 4697 号	2011.5.17	2011.7.25	BS.11500419.X
27	芯朋有限	C1018	第 4696 号	2011.5.17	2011.7.25	BS.11500418.1
28	芯朋有限	C1103	第 5482 号	2011.12.6	2012.2.6	BS.11501256.7
29	芯朋有限	C1022	第 5483 号	2011.12.6	2012.2.6	BS.11501257.5
30	芯朋有限	C1016	第 5484 号	2011.12.6	2012.2.6	BS.11501258.3
31	芯朋股份	PW11A22	第 7002 号	2012.3.29	2013.1.28	BS.12500412.5
32	芯朋股份	PW10H03	第 7004 号	2012.3.29	2013.1.28	BS.12500414.1
33	芯朋股份	PW10A51	第 7003 号	2012.3.29	2013.1.28	BS.12500413.3
34	芯朋股份	PW10A22C	第 7001 号	2012.3.29	2013.1.28	BS.12500411.7
35	芯朋股份	PW11A31	第 7000 号	2012.3.29	2013.1.28	BS.12500410.9
36	芯朋股份	PW11A22B	第 7018 号	2012.5.10	2013.1.28	BS.12500603.9
37	芯朋股份	C1203	第 6352 号	2012.6.12	2012.8.27	BS.12500739.6
38	芯朋股份	C1118	第 6372 号	2012.6.12	2012.8.27	BS.12500740.X
39	苏州博创	PW08A	第 2358 号	2008.10.15	2009.2.6	BS.08500531.2
40	苏州博创	PW08P07	第 2359 号	2008.10.15	2009.2.6	BS.08500530.4
41	苏州博创	PN4420	第 2843 号	2009.05.26	2009.10.28	BS.09500342.8
42	苏州博创	PN256D2	第 2844 号	2009.05.26	2009.10.28	BS.09500343.6
43	苏州博创	PN256D1	第 2734 号	2009.05.26	2009.9.2	BS.09500341.X
44	苏州博创	PN096S1	第 2732 号	2009.05.26	2009.9.2	BS.09500344.4
45	苏州博创	PN211A1	第 2733 号	2009.05.26	2009.9.2	BS.09500340.1
46	苏州博创	PN3113	第 4686 号	2011.5.25	2011.7.18	BS.11500513.7
47	苏州博创	PW09A03	第 4685 号	2011.5.25	2011.7.18	BS.11500512.9

4、商标

公司及子公司拥有的商标共 4 项，如下表所示：

序号	商标	有效期截止日	注册号	商品类别
1		2021 年 2 月 27 日	7608263	9
2		2021 年 2 月 27 日	7829724	9
3		2022 年 7 月 27 日	9531611	9
4		2019 年 10 月 6 日	5792947	9

5、核心技术的保护措施

公司注重对核心技术的保护，对研发成熟的技术申请了知识产权保护，截至本说明书签署之日，公司已有商标 4 项、布图设计 47 项、专利 29 项、正在申请的专利 25 项。公司已与核心技术人员签订了相关保密协议。

（四）取得的业务许可资格和资质情况

公司具备本行业生产许可及市场准入资质。

1、生产许可

公司具备工信部颁发的集成电路设计企业认定证书资质。

2、市场准入

国际和国内市场目前均无市场准入资质要求。

（五）提供产品时使用的主要设备和固定资产

1、公司及控股子公司拥有的房屋、建筑物情况

公司及控股子公司目前均不拥有房产。

2、公司及控股子公司生产经营所使用的主要设备

(1) 公司生产经营所使用的主要设备

截至 2013 年 6 月 30 日，公司提供产品使用的主要生产、检测设备情况如下：

序号	主要设备名称	原值（元）	净值（元）	成新率
1	空压机	4,316.24	1,582.88	33.33%
2	自动分选机 (C1S150T)	115,384.62	66,671.55	55.56%

(2) 控股子公司苏州博创使用的主要设备

截至 2013 年 6 月 30 日，苏州博创提供产品时使用的主要生产、检测设备情况如下：

序号	主要设备名称	原值（元）	净值（元）	成新率
1	高低压混合测试机	527,350.40	54,199.94	5.56%
2	测试仪	418,803.40	153,561.19	30.56%
3	自动机械手	68,376.07	25,071.19	30.56%
4	自动机械手	68,376.07	25,071.19	30.56%
5	半导体参数测试仪	564,102.58	459,900.30	80.56%
6	测试机械手	111,111.12	90,586.42	80.56%

(六) 员工及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司共有员工 111 人，具体结构如下：

类别		人数	比例
年龄	20—25	16	14.41%
	26—30	36	32.43%
	31—35	41	36.94%
	36—40	7	6.31%
	41—45	5	4.50%
	46—50	6	5.41%
汇总		111	100.00%

专业	电子信息科学	45	40.54%
	电气信息类	32	28.83%
	工商管理类	16	14.41%
	语言文学类	4	3.60%
	其他	14	12.61%
汇总		111	100.00%
学历	博士	5	4.50%
	硕士	16	14.41%
	本科	44	39.64%
	大专	30	27.03%
	大专以下	16	14.41%
汇总		111	100.00%

2、核心技术人员

(1) 核心技术人员概况

张立新先生，现任公司董事长、总经理。具体情况请参见本说明书第一章“三、股权结构及股本形成情况”之“（四）控股股东和实际控制人情况。”张立新先生作为核心技术人员的任职期限自2011年11月25日起，任期三年。

周飙先生，现任公司董事、副总经理。具体情况请参见本说明书第一章“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事情况”。周飙先生作为核心技术人员的任职期限自2011年4月1日起，任期为无固定期限。

易扬波先生，现任公司董事、副总经理。具体情况请参见本说明书第一章“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事情况”。易扬波先生作为核心技术人员的任职期限自2009年12月1日起，任期五年。

张韬先生，现任设计总监、监事会主席。具体情况请参见本说明书第一章“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事情况”。张韬先生作为核心技术人员的任职期限自2011年8月1日起，任期为无固定期限。

李海松先生，出生于1981年2月，毕业于东南大学，博士。目前在公司内负责功率集成电路及功率器件的设计和管理的工作，在功率集成电路开发上具有多款产品成功量产经验，是二十余项集成电路相关中国发明专利及1项美国发明专利的发明人。先后参加国家863计划项目，江苏省科技成果转化项目，国家电子发展基金项目，国家“核高基”等项目的研发工作。于2009年作为核心成员获得江苏省科技进步一等

奖。李海松先生作为核心技术人员的任职期限自 2010 年 1 月 1 日起，任期五年。

(2) 核心技术人员持股情况

序号	股东姓名	职务	持股数额(万股)	持股比例 (%)
1	张立新	董事长、总经理	1,252.50	61.10
2	周飙	董事、副总经理	150.00	7.32
3	易扬波	董事、副总经理	150.00	7.32
4	张韬	设计总监	50.00	2.44
5	李海松	设计总监	4.00	0.2
合计			1,606.50	78.38

报告期间，公司核心技术人员保持稳定，未发生重大变动。

四、公司业务经营情况

(一) 报告期业务收入的主要构成

报告期公司的业务收入主要来自集成电路产品的销售，按金额核算其构成如下表所示：

营业收入结构表（按产品分类）

（单位：元）

项目 \ 时间	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	76,010,303.75	99.84	130,423,643.25	99.86	121,847,211.91	100.00
集成电路	74,871,613.89	98.34	125,980,122.53	96.46	110,908,375.97	91.02
功率晶体管产品	1,138,689.86	1.50	4,443,520.72	3.40	10,938,835.94	8.98
其他业务收入	120,000.00	0.16	189,051.00	0.14	--	--
合计	76,130,303.75	100.00	130,612,694.25	100.00	121,847,211.91	100.00

报告期，公司销售收入持续增长的原因和策略包括：第一、公司传统的小家电市场得到复苏；第二、公司及时调整市场策略，2011 年开始进入 MID、移动电源等增长行业，2012 年取得初步成效，今年进一步得到快速成长；第三、公司不断开发新市场，今年将进入 LED 领域，为明后年带来持续的增长动力。

(二) 主要客户情况

报告期间，公司对前五名客户的销售均通过长期合作的代理模式实施，公司对前五名客户的销售额及合计分别占当期主营业务收入的比例如下表所示：

2013年1-6月前5大销售客户

(单位：元)

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重(%)
1	东莞市中铭电子贸易有限公司	8,826,465.38	11.59
2	深圳市汤诚科技有限公司	7,023,278.96	9.23
3	深圳市泰捷通讯技术有限公司	4,409,788.80	5.79
4	深圳市海霞鑫电子有限公司	4,290,357.91	5.64
5	深圳市盛友电子有限公司	3,594,441.10	4.72
	合计	28,144,332.15	36.97

公司2012年度前5大销售客户

(单位：元)

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重(%)
1	东莞市中铭电子贸易有限公司	19,990,490.39	15.31
2	深圳市汤诚科技有限公司	12,530,266.48	9.59
3	深圳市海霞鑫电子有限公司	11,908,203.88	9.12
4	深圳市泰捷通信技术有限公司	6,988,459.83	5.35
5	深圳市盛友电子有限公司	6,521,201.83	4.99
	合计	57,938,622.41	44.36

公司2011年度前5大销售客户

(单位：元)

序号	销售客户	销售额	占主营业务收入比重(%)
1	深圳市海霞鑫电子有限公司	18,968,285.25	15.57
2	东莞市中铭电子贸易有限公司	17,684,296.19	14.51
3	无锡市金人贸易有限公司	16,734,763.74	13.73
4	西安芯派电子科技有限公司	8,774,084.66	7.20
5	三星电管(香港)有限公司	7,222,189.24	5.93
	合计	69,383,619.08	56.94

东莞市中铭电子贸易有限公司，设立于2006年8月8日，注册资本200万元，公司经营范围为：从事电子产品、热转印纸、电焊机、发光二极管灯、路灯及配件、

空压机、发电机、电动工具、家电产品及配件、电机设备等产品的佣金代理（不含拍卖）、进出口和批发业务及提供上述产品相关配套服务。（不含国营贸易管理商品，涉及配额许可管理，专项规定管理的商品按国家有关规定办理）

深圳市汤诚科技有限公司，设立于 2008 年 12 月 8 日，注册资本 300 万元，公司经营范围为：电子软硬件、电子集成系统的技术开发（不含生产加工）；电脑、电子元器件及配件的销售；国内商业、物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

深圳市泰捷通信技术有限公司，设立于 2004 年 3 月 11 日，注册资本 50 万元，公司经营范围为：电子产品、通信产品的技术开发和销售，化工原料及产品（不含危险品）、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备的销售，其他国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

深圳市海霞鑫电子有限公司，成立于 2006 年 10 月 12 日，注册资本 100 万元，公司经营范围为：电子元器件的销售；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口。

西安芯派电子科技有限公司，成立于 2008 年 7 月 18 日，注册资本 500 万元，公司经营范围为：电子元器件及相关产品、计算机软硬件及网络产品、电子生物科技产品的开发、生产、销售及技术转让、技术服务；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上经营范围涉及国家有专项经营规定的从其规定）

深圳市盛友电子有限公司，成立于 2010 年 3 月 9 日，注册资本 100 万元，公司经营范围为：电子产品、电子元器件的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

无锡市金人贸易有限公司，成立于 1998 年 3 月 13 日，注册资本 500 万元，经营范围为：针纺织品，服装，五金交电，电气机械，化工产品，电子产品，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收及发射装置），仪器仪表，工艺品的销售。经济贸易咨询。自营和代理各类商品和技术的进出口。（国家禁止的除外）

三星电管（香港）有限公司，成立于 1988 年 9 月 16 日，注册资本 HKD 274,250,000.00 元，公司经营范围为：音响器材，音响设备，电视(包括液晶显示屏/等离子显示屏/高清数字电视)，录像机，个人计算机，光碟驱动器，洗衣机，计算器，半导体，电线及电缆。

公司 2011 年、2012 年和 2013 年 1~6 月对前五大客户的销售额占主营业务收入比分别为 56.94%、44.36%以及 36.97%，不存在销售额占比过大的客户。此外，公司销售也不存在对一个或几个主要客户的依赖，符合公司产品主要面向海量的消费类电子市场的业务模式特点。

此外，公司营业收入指向的客户及地区由于终端市场的特点，大多处于华南地区，前五大客户具有稳定性，合计占比逐年降低，不存在销售额占比过大的单一客户。报告期内前五大客户均向公司采购集成电路产品。公司销售以通过代理商的方式为主，占 95%以上；仅有 5%不到的销售由公司直销。公司采用的代理商制销售模式，也是欧美公司通用的模式。通过经销商进行销售，既可充分利用经销商的销售渠道，又转移了电子制造业市场离散度较高的终端用户应收账款坏账风险。

（三）公司主要供应商情况

公司报告期内前五名供应商均为公司的外协采购供应商，公司对主要供应商的采购金额及其占采购总金额的百分比如下：

公司 2013 年 1-6 月前 5 大供应商

（单位：元）

序号	供应商	采购金额	占公司采购总额比重（%）
1	无锡华润上华半导体有限公司	15,953,248.27	26.99%
2	无锡华润上华科技有限公司	14,797,162.11	25.03%
3	无锡华润安盛科技有限公司	9,674,814.77	16.37%
4	江苏长电科技股份有限公司	8,695,518.71	14.71%
5	天水华天科技股份有限公司	5,465,449.04	9.25%
合计		54,586,192.91	92.35%

公司 2012 年度前 5 大供应商

（单位：元）

序号	供应商	采购金额	占公司采购总额比重（%）
1	无锡华润上华半导体有限公司	38,542,839.38	39.37%
2	无锡华润上华科技有限公司	17,852,663.90	18.23%
3	江苏长电科技股份有限公司	14,512,823.51	14.82%
4	无锡华润安盛科技有限公司	13,507,580.88	13.80%
5	天水华天科技股份有限公司	4,626,771.15	4.73%
合计		89,042,678.83	90.95%

公司 2011 年度前 5 大供应商

(单位：元)

序号	供应商	采购金额	占公司采购总额比重 (%)
1	无锡华润上华半导体有限公司	61,071,211.91	62.11%
2	江苏长电科技股份有限公司	11,801,955.81	12.00%
3	无锡华润安盛科技有限公司	10,237,126.65	10.41%
4	无锡华润上华科技有限公司	4,541,034.21	4.62%
5	江阴佳泰电子科技有限公司	1,930,120.53	1.97%
合计		89,581,449.10	91.11%

无锡华润上华科技有限公司，于 2002 年 7 月 16 日成立，注册资本 50000 万美元，公司经营范围为：研究开发设计制造集成电路（包括集成电路测试与封装、光罩制作）、电路模块、微处理机、微处理器、半导体记忆体记忆零组件、新型电子元器件、新型平板显示器件；半导体元器件专用材料的开发生产。

无锡华润上华半导体有限公司，于 1999 年 7 月 21 日成立，注册资本 16801.147 万美元，公司经营范围为：研究开发设计制造集成电路（包括集成电路测试与封装、光罩制作）、电路模块、微处理机、微处理器、半导体记忆体记忆零组件、新型电子元器件、新型平板显示器件。

江苏长电科技股份有限公司，于 1998 年 11 月 6 日成立，注册资本 85313.361 万元，公司经营范围为：研制、开发、生产、销售半导体、电子元件、专用电子电气装置，销售本企业自产机电产品及成套设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务。

无锡华润安盛科技有限公司，于 2003 年 12 月 23 日成立，注册资本 32000 万元，公司经营范围为：0.35 微米以下大规模集成电路、新型电子元器件（电力电子器件、混合集成电路）的研究开发生产测试与封装；销售自产产品并提供技术服务、售后服务。

天水华天科技股份有限公司，于 2003 年 12 月 25 日成立，注册资本 27320 万元，公司经营范围为：半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售；电子产业项目投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务。

江阴佳泰电子科技有限公司，于 2007 年 8 月 28 日成立，注册资本 600 万元，公司经营范围为：电子科学技术的研究、开发、技术服务；线宽 0.8 微米以下大规模集成电路制造中的晶圆测试加工；其他晶圆测试；集成电路及电子产品的设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

报告期内公司对前五大供应商的采购额合计占到当期采购额的 90% 以上，存在一定的依赖性，这主要由公司的业务模式所决定。公司采用 Fabless 模式运营，无独立生产线，晶圆生产及封装测试工作均由上游厂商进行，因此对外采购量较大且集中度较高。其中华润上华主要为公司提供圆片代工，江苏长电、无锡华润安盛、天水华天提供芯片封装、测试工作，上述企业均已与公司建立稳定合作关系。圆片生产工序之后，公司将圆片发往佳泰进行中测，之后，将合格圆片发往江苏长电、无锡华润安盛、天水华天等厂商进行封装、成测。供应商根据公司提供的技术文件进行相关封装、测试工作。公司通过质量工程师对供应商的加工质量进行及时监控，并定期对供应商的内部质量系统运作情况进行审核把关。公司会根据产能瓶颈、封装形式、价格、加工交货期等综合因素适时调整供应商选择和加工量的分配。公司极少量产成品因技术保密及节约成本的原因由公司测试部进行成品测试，除此以外均采取外协采购方式完成整个加工过程。

从国内 IC 制造业的总体产业结构来看，由于国内封装测试企业数量较多、市场充分竞争，公司产品在封装和测试企业的技术磨合期较短，公司对这类供应商不存在重大依赖关系；而电源管理集成电路设计与圆片加工企业的工艺参数关联度较高，电路设计须依据工艺参数和工艺线特征，因而达到稳定生产的周期较长，更换代工企业的成本相对较高，对已选定的圆片代工企业存在一定的依赖度。降低这一依存度的主要方式为：设计企业须不断提升技术水准，缩短与新工艺线的磨合时间；其次，增加新的备选圆片加工企业。公司在这两方面均已取得进展，已结合华润上华之外的圆片加工厂完成一些产品的设计，并开始试生产。

（四）公司与前五大供应商、前五大客户的关联情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份的股东均不在主要客户及供应商中任职或拥有权益。

(五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

公司收到的客户订单或订购合同具有履行期限短、合同金额小、订单次数频繁的特点，因此，公司销售主要通过代理商实现，与主要代理商之间实行在销售代理协议框架基础上的订单销售。

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

订单日期	客户	客户订单号	订单金额	已完成金额	已执行比例
2011 年度					
2011/5/13	三星电管（香港）有限公司	4500024645	\$ 920,000	\$ 920,000	100%
2011/6/9	深圳市海霞鑫电子有限公司	AP20110609HH0021	¥889,760	¥889,760	100%
2011/8/25	西安芯派电子科技有限公司	2011-06	¥1,890,000	¥1,890,000	100%
2011/9/30	东莞市中铭电子贸易有限公司	B100093701	¥1,885,690	¥1,885,690	100%
2011/12/1	无锡市金人贸易有限公司	20111201	¥626,445	¥626,445	100%
2012 年度					
2012/3/8	三星电管（香港）有限公司	5099505935	\$ 349,920	\$ 349,920	100%
2012/7/19	西安芯派电子科技有限公司	2012-015	¥930,000	¥930,000	100%
2012/8/29	东莞市中铭电子贸易有限公司	B01082905	¥2,348,280	¥2,348,280	100%
2012/12/7	深圳市泰捷通信技术有限公司	TC2012120701	¥210,000	¥210,000	100%
2012/12/10	深圳市盛友电子有限公司	XPW20121210001	¥156,000	¥156,000	100%
2012/12/21	深圳市汤诚科技有限公司	PO20121221302	¥1,531,320	¥1,531,320	100%
2013 年 1-6 月					
2013/3/1	东莞市中铭电子贸易有限公司	B02030102	¥1,763,200	¥1,763,200	100%
2013/4/19	香港达亚有限公司(DAYA LIMITED)	DY-SPW-U130419-001	\$ 225,377	\$ 225,377	100%
2013/7/18	泰捷国际(香港)有限公司	TC2013071801	\$ 151,875	\$ 151,875	100%

截至 2013 年 6 月 30 日公司未来待履行的重大业务合同如下：

订单日期	客户	客户订单号	订单金额	已完成金额	已执行比例
2013/3/30	深圳市海霞鑫电子有限公司	AP20130330001	¥1,146,500	¥1,086,500	95%
2013/7/18	深圳汤诚科技有限公司	PO20130718001	¥1,312,500	¥ 657,150	50%
2013/7/31	东莞中铭电子贸易有限公司	B02073103	¥1,211,160	¥1,031,280	85%
2013/1/31	利尔达科技有限公司	XL001 (委托设计合同)	¥1,440,000	¥50,000	3.5%

注：XL001 合同是一份定制电路委托合同，客户承诺在公司产品开发成功后合计采购量将达 200 万只，每只电路按 0.70 元计；公司根据开发的进程可预先收取客户的订金，截至 2013 年 6 月 30 日前已收取订金 5 万元整。

如前所述，公司产品的特点决定了公司一般不存在履行期限较长、金额重大的业务合同。在实际经营中，由于公司产品应用较广，且主要通过经销商销售，因此具有订单较为分散的特点，订单单笔金额不大但客户会根据市场需求循环签订单，因此待履行合同金额相对保持平稳。

五、公司商业模式

公司通过设计各类市场需求的电源管理集成电路，通过外包加工的方式，获得所需的成品电路；同时，以自行设计的集成电路为核心，向客户提供合适的电源解决方案，取得客户系统方案的认可，从而实现向客户销售成品集成电路，并通过销售收入与代工成本总和之差，实现公司盈利与资金回笼。

公司标志的终端客户一览表

客户名称	使用产品	应用领域
美的电器、苏泊尔、雅乐思	AC-DC	电磁炉、电饭煲等小家电
兆驰科技、迈高	DC-DC	便携式产品、机顶盒
伟易达	DC-DC	智能玩具
阿龙电子	DC-DC	P-DVD
普惠电子	DC-DC	MID
腾达电子	DC-DC	路由器
TCL	LED	智能手机

（一）采购与生产模式

公司作为典型的 IC 设计公司，处在高度分工的半导体产业链顶端，公司负责产品的定义和方案数据设计，交付各类代工厂（圆片厂、封装厂、测试厂等）完成指定工艺要求的加工制作，然后再回到公司，由公司自行销售或通过代理商销售给客户。

因此，在整个供产销的链条中，公司质量部负责对外包厂商（圆片加工、测试、封装）的综合评定和定期评估；各工程技术部门负责对新供应商能力评估；生产部负责对外包厂商的价格、服务进行评价。质量部根据公司生产的实际需要，通过对质量、价格、先进技术等进行比较来对供应商进行评定，满足要求的供应商交由营运副总最后确定，不满足要求的，但在技术上有特殊优势的外包商，必须获得总经理批准后，才能列入合格外包商。

公司根据销售年计划、生产年计划、近三个月的实际销售情况及对市场的预测来编制当月采购计划，并将采购要求发往圆片加工厂，圆片加工厂根据公司的要求采购及加工圆片后，随即运往公司指定的中测厂，中测厂完成测试后将产品运往封装厂，封装厂完成最终的封装及成测后将产品运回公司成品仓库。

中测厂、封装厂都需对前一步骤的产品进行质量验收，并出具可靠性试验报告，最终的产品由公司质量部和仓库对其在数量、包装、规格、标签等方面进行验收，由于技术保密及节约成本的考虑，部分产品由公司测试部进行成品测试。

（二）销售模式

公司销售以代理为主，占 95% 以上，公司与主要代理商之间实行在销售代理协议框架基础上的订单销售。此外，还有 5% 不到的销售通过公司直销。公司选定客户及处理客户关系基于以下原则：

（1）客户的分类：按运营性质来分共分为 5 类：代理商、经销商（准代理）、贸易商、方案公司及主芯片厂商；

（2）授权代理商的基本条件：销售品牌必须是公司的品牌；能提供对于某一专业市场的市场评估报告；

（3）授权代理商的责任和义务：签订芯朋代理协议书；需要提供 3 个月的滚动需求计划，并且保证持有 0.5 个月的销售库存；每周提供客户进展周报；每月提供报备客户进展记录；原厂需要拜访报备名录中客户时，代理商需无条件配合；代理商无

条件接受原厂客户订单抽检，以确保报备真实性；禁止恶意低价倾销抢占客户，损害原厂和其他代理的利益，一旦发现经 2 次警告无效的一律取消授权代理资质。

(4) 芯朋的责任和义务：提供正式的代理证书；对于代理报备之客户应严加保护，确保代理商利益得到合理保障；积极协助代理商开拓客户及拿下订单所需的工作。

在交货质量方面，公司根据双方签订的技术质量协议、相关工艺图纸文件及有关样板执行，测试合格率满足双方约定的良率要求。结算方式及期限方面，公司按客户等级和协商付款条件通知采购方付款，从月结 30 天到 6 个月银行承兑汇票支付不等。

六、公司所处行业概况

(一) 所处行业概况

1、所属行业

公司主要从事电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服务。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）公司属于 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）公司属于 C3963 单片集成电路、混合式集成电路的制造业。

本公司设计的集成电路产品从功能上划分，属于电源管理类集成电路。电源管理集成电路主要应用于电源的各种变换（升压/降压，交流变直流等），可将交流电或电池的直流电，转换成为系统内部各功能块所需要的不同电压，实现电能的高效利用，降低电子系统的电能消耗，实现节能减排。

2、所处行业涉及的市场主体

从集成电路产业链分工的角度而言，电源管理集成电路设计属于 IC 设计行业，位于产业链上游。IC 产业链由 IC 设计制造、经销商分销及终端电子产品生产制造三个环节构成，IC 设计制造又进一步可分为 IC 设计、晶圆代工、封装测试三个生产环节。

概述如下：

(1) IC 设计企业：IC 设计企业根据终端电子产品需求进行集成电路布图设计，并委托上游厂商进行晶圆代工，芯片测试封装，待芯片生产完毕检验入库后，交付下游经销商经销或者直接交付终端电子厂商进行应用。

(2) 晶圆代工厂：根据委托代工的 IC 设计数据文件，以精密设备、按照严格的

生产流程，刻录在晶圆上，收取代工费。

(3) 封装、测试厂：指将制作好的晶圆进行切割，并封装成为最终的 IC 产品，经测试包装后，将合格品交付设计企业。

电源管理集成电路设计行业的公司通常将设计成果外包代工，经封装、测试后形成产品，再回到公司，最后由公司将这些产品进行对外销售。

3、产业政策

集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家给予了高度重视和大力支持，出台了一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了优良的政策环境。十八大提出“四化同步”，集成电路和软件是实现新四化的核心和基础。

2000 年 6 月，国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号），该政策作为集成电路产业发展的核心政策在税收优惠、生产性原材料进口、集成电路技术和成套生产设备进口、设备折旧、知识产权保护等方面对集成电路产业进行大力扶持。

2000 年 9 月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），制定了鼓励集成电路产业发展的若干税收政策。

2002 年 10 月，财政部、国家税务总局发布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70 号），出台了针对集成电路产业更多的税收优惠政策。

2005 年 3 月，财政部、信息产业部、国家发改委发布《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》（财建[2005]132 号），由国家设立集成电路产业研究与开发专项资金，鼓励集成电路企业加强研究与开发活动。

2005 年 10 月，国家发改委、信息产业部、税务总局、海关总署发布《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法（试行）》（发改高技[2005]2136 号），规范国家鼓励的集成电路企业认定工作，进一步贯彻落实国务院有关政策及其配套优惠政策。

2006 年 2 月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》，纲要提出发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键，同时纲要将“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”（01 专项）、极大规模集成电路制造技术及成套

工艺（02 专项）作为 16 个重大专项的前两位，并在科技投入、税收优惠、金融支持、知识产权保护等方面提出了政策和措施。

2006 年 3 月，国务院制订的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，提出了集成电路、软件和新型元器件是“十一五”期间重点发展的基础性核心产业。

2006 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《2006-2020 年国家信息化发展战略》，提出了提高信息产业竞争力，加强政府引导，突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈，提高在全球产业链中的地位，逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。

2006 年 8 月，信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》，将集成电路作为未来 5~15 年的重点发展产业。

2007 年 1 月，国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》，明确将集成电路列入当前优先发展的高技术产业（第十三项）。

2008 年 1 月，原信息产业部编制并颁布了《集成电路产业“十一五”专项规划》，制定了“十一五”期间集成电路产业的发展思路与目标、重点任务以及相应的政策措施。

2008 年 2 月，财政部和国家税务总局发布了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号），进一步制定了针对集成电路企业所享受的所得税优惠政策。

2009 年 4 月，国务院通过《电子信息产业调整和振兴规划》，提出了“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”的任务目标，并在集成电路产业的产业体系完善、自主创新、产业升级等方面提出优惠措施，加大投入力度及鼓励软件和集成电路产业发展政策的实施力度。

2010 年 10 月，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号），提出了“着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业”，集成电路产业作为新一代信息技术产业的重要组成部分，是国家未来重点发展的战略新兴产业。2011 年 2 月，国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号，以下简称 4 号文件）从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政策。4 号文件明确提出，“继续实施国发 18 号文件明确的政策，相关政

策与本政策不一致的，以本政策为准”，其中对集成电路产业的支持更由设计企业与生产企业延伸至封装、测试、设备、材料等产业链上下游企业，可见 2011 年 4 号文件是 18 号文件的拓展与延伸。由此可见，国家对集成电路产业的政策扶持力度更进一步增强。

2011 年 12 月，工信部发布《集成电路产业“十二五”发展规划》，作为行业发展的指导性文件，对于促进集成电路产业全面、协调、可持续发展具有重要意义。

我国中央政府及各部委制定了一系列涉及集成电路产业的政策，内容涵盖鼓励设计业与整机业之间的合作、加快涉及量大面广 IC 产品的设计开发、开发具有自主知识产权的 IC 产品等各方面，为 IC 企业长期发展指明了方向。习近平指出：“对于集成电路产业，一定要抓住不放，实现跨越”。

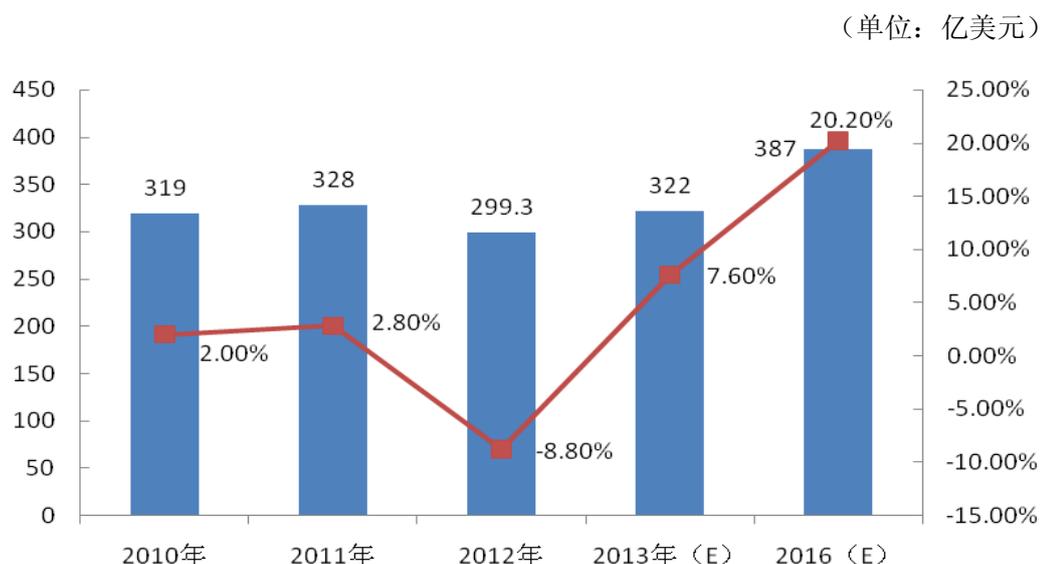
从以上国家对集成电路行业的扶持政策和财政支持来看，国家扶持政策是长期并且持续的，公司作为半导体设计行业技术领先的企业也将从中受益。

（二）市场规模

1、市场容量

（1）全球市场相关情况

2012 年世界电源管理集成电路市场规模为 299.3 亿美元。预计 2013 年市场规模为 322 亿美元，同比增长 7.6%。预计到 2016 年市场规模将达到 387 亿美元的水平。如下图所示。（数据来源：《江苏省集成电路产业发展报告（2012 年度）》江苏省半导体行业协会 编）



图、世界电源管理电路市场规模及预测

电源管理芯片市场的特点是厂商高度分散，全球主要供应商有 200 多个，前 10 名每家只占 3%~6% 的市场份额，前 31 家占比约为 80%。（该处数据摘自电子产品世界网站 <http://www.eepw.com.cn/article/159168.htm>）

（2）中国市场相关情况

首先，从集成电路大行业来讲，2012 年度，中国集成电路产业保持了平稳增长的势头，以 11.6% 的增幅在全球集成电路产业中一枝独秀，总规模达到 2,158.45 亿元，在全球集成电路产业占比首次突破 10% 的大关。集成电路产量为 823.1 亿块，同比增长 14.4%。其中，集成电路设计业继续保持了高速增长的态势，年增长率达到了 18.1%，在集成电路总收入中所占比重首次超过了晶圆制造业，达到了 28.8%，设计和制造合计占比过半，产业结构持续优化。与此同时，全球市场的格局也在持续变化，设计、代工企业的地位正不断上升。

2012 年中国集成电路产业发展规模

（单位：亿元）

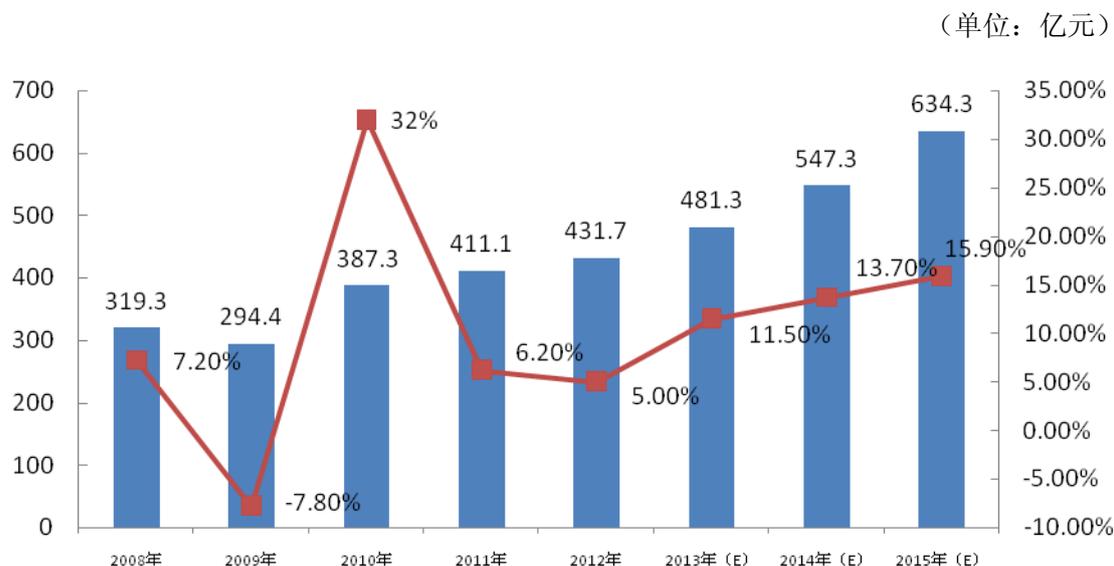
指标名称	2012 年	2011 年	同比（±%）
集成电路销售收入	2,158.5	1,933.7	+11.6
其中：IC 设计业	621.7	526.4	+18.1
IC 晶圆业	501.1	431.6	+16.1
IC 封测业	1,035.7	975.7	+6.1

（数据来源：半导体与光伏行业（总第 113 期））

其次，从产业整体结构而言，中国加入 WTO 后，集成电路产业全面对外开放，跨国企业的产品缴纳关税和增值税后即可进入国门，因此全行业目前已属于完全竞争的产业结构，且产业集中度发展趋势倾向于进一步发散，个别企业很难形成垄断。国际企业之间也形成充分竞争的关系。当然，在某些细分市场，可能由于长期以来自然形成的客户关系而造成的护城河，但并不存在行业准入的资质限制。以芯朋股份为例，虽然公司规模不大，但前期在同国际行业巨头的同台竞争中脱颖而出，成功进入了三星电子的供应链体系。这充分表明，当前电源管理集成电路设计行业的唯一门槛，是设计能力和产品可靠性所形成的技术门槛。

具体到电源管理集成电路细分市场而言，在世界经济艰难复苏的大环境下，国内市场需求稳中有增。在国内外多种因素的制约下，2012 年中国电源管理芯片市场销售

额仍达 431.7 亿元，实现同比增长 5%，如下图所示。（数据来源：《江苏省集成电路产业发展报告（2012 年度）》江苏省半导体行业协会 编）



基于后发者的赶超动力，2008 年之前，中国电源管理芯片市场的发展速度一直高于全球平均水平，但之后的差距逐渐缩小，近年来的增速已基本同步。随着中国电源芯片市场规模的不断扩大，其占全球市场的比重也不断提升，对全球市场的影响力日渐凸显，中国市场与全球市场的发展轨迹也逐步趋同。其中，新兴热点产业对电源管理集成电路市场构成支撑。2012 年，以平板、智能手机为代表的智能移动终端在中高端人群中迅速普及，手机更新换代速度加快。移动智能终端的兴起直接拉动了网络通信领域电源管理集成电路市场的增长。其次，电源驱动电路受益于中国 LED 应用产品的市场渗透率进一步提升，特别是受益于 LED 背光应用领域渗透率大幅增加，成为增长最快的电源管理集成电路产品。

未来几年，由于国家对信息消费产业和节能环保产业的大力支持，网络通信类和 LED 照明类等电源管理芯片市场将呈现快速增长的局面。

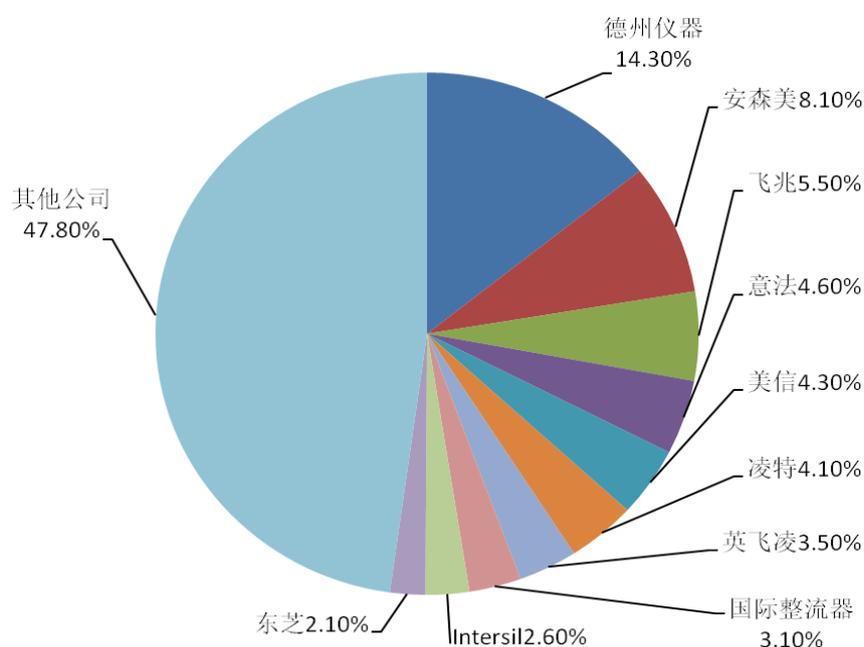
2、竞争程度

(1) 行业竞争格局

公司从事的行业属于电子信息产业中集成电路产业的一个分支，即集成电路设计（IC 设计）产业。行业竞争格局可分国际和国内两个层面。国际上来讲，整个电源管理的 IC 设计产业呈现由美国、欧洲、日本向中国产业转移的格局，中国的电源管理 IC 设计产业正处于上升期。原因是，由于终端消费品的制造中心向亚太和中国聚集，

受到成本制约，迫使欧美的大型 IC 设计公司逐步淡出民用消费类市场，转向高端的工业级、军品级乃至其他性能要求更高的产品市场（宇航级）。在产业转移的进程中，国内企业将更容易切入民用的大宗消费市场。

从电源管理芯片厂商的类型来看，美国、欧洲和日本厂商多为 IDM，中国和台湾地区的厂商多为 Fabless，且规模相对较小。在众多美国厂商中，Fairchild、Linear、On Semi、PI 等知名企业均以电源管理为核心业务领域（包括电源管理芯片和功率分立器件），而对于 Toshiba, Renesas, Ricoh 等日本厂商和 ST、NXP、Infineon 等欧洲厂商而言，电源管理芯片仅为其众多产品线中的一种。除此传统大厂之外，欧美还有一些新兴的电源管理芯片的厂商，比如 MPS、Silergy、iWatt 等。



图、2012年中国电源管理电路市场品牌结构

目前，国内电源管理芯片市场中欧美供应商占据了80%以上的份额，随着产业转移带来的契机，国内公司将面临巨大的发展空间与机遇。其中，电源管理芯片的民用消费类市场又可分为稳定消费类产品市场（机顶盒、电视机）和快速消费类市场（数码产品，便携式移动电源），后者属于易耗品，产品升级换代的更新速度也快，更容易切入。

国内层面来看，国内专业从事电源管理类芯片设计的公司约有40~50家，大陆地区主要包括杭州士兰、上海新进、上海贝岭、南京微盟、南京通华芯、北京思旺、圣邦微等；台湾地区主要包括Richtek，富鼎先进、茂达、安茂、昂宝、AIC等。该行业竞争主体比较分散，目前没有形成垄断领先的企业。

(2) 行业竞争程度

如前所述，由于集成电路设计行业没有销售半径和运输壁垒，因此，全球范围内的功率电源集成电路设计企业都处于同一起跑线上，不存在明显的区域性特征。模拟类电源管理芯片市场的结构高度离散，呈现充分竞争的市场格局。

目前国内电源管理芯片的产品结构中，大部分低端电源管理芯片产品基本由大陆厂商占据主导地位，台湾厂商以中低端产品为主，欧美和日本厂商仍然牢牢占据高端产品市场。但在激烈竞争的环境下，大陆电源管理芯片厂商随着国内整机厂的崛起，在全力扩大中端应用市场份额，比如国产知名品牌的手机、平板电脑等。尽管如此，在可预见的未来，产品结构的整体格局仍将维持。

终端市场方面，近年来，随着医疗、安防、汽车电子各领域信息产业化的深入，衍生出更多的 IC 产品需求并使得应用于这些产业的集成电路的市场占比与日俱增。尽管如此，中国电源管理芯片仍以计算机、消费电子和网络通信的所谓 3C 领域为主战场。由于 3C 领域的电子产品产量巨大，品种众多，包括手机、平板电脑、各类家电和数码产品，带来的电源管理芯片的需求将占据整体市场需求的四分之三以上。由于庞大的人口基数和电子产品消费支撑，亚洲地区已成为全球电源管理芯片最大的应用市场。

随着 IC 设计行业国内公司的日益增多，本土公司的技术水平和国外设计公司的差距不断缩小，目前在多个领域已经可以击退国外竞争对手，尤其是具备自主核心技术的 IC 设计公司相对发展较好，市场地位逐渐上升。

3、行业壁垒

电源管理芯片设计行业兼具技术密集和资本密集的双重特征，独立面对市场的分析和预判能力、自主研发能力和新产品的持续开发能力是决定电源类集成电路 IC 设计企业成败的核心竞争力，因而存在着一定的行业进入壁垒，具体包括：

(1) 技术壁垒

电源管理芯片的核心是产品的可靠性和一致性，这主要取决于器件的可靠性和加工工艺的稳定。因此，相关的 IC 设计公司必须在器件结构设计、模拟电路以及工艺开发上投入了大量资源，并产出独特的技术优势，才能在激烈竞争的市场中立足；另一方面，相关设计公司还需要具备较强的技术创新能力和设计革新水平，能够根据客户的个性化需求，改造现有产品及开发新的产品，提高产品的便捷使用性、稳定性、

安全性。因此，本行业具有一定的技术壁垒。

(2) 资本壁垒

集成电路设计行业前期投入的研发周期较长，对相关公司结合工艺的设计能力、针对市场需求变迁的预判能力提出了较高要求。同时，由于终端产品更新换代迅速，IC 设计企业需要进行持续的跟踪和研发投入，而从研发投入到产出本身具有一定周期，存在跟不上市场节奏而导致研发失效的风险，因此，相关企业必须具有充裕的资金规模才能抵御行业产品周期波动的风险。

(3) 人才和经验壁垒

电源管理芯片属于模拟类集成电路，其设计研发相对于数字电路的设计技术，需要更长的人才培养期，以及长时间实践和经验积累基础上产生的综合知识结构和领悟力。此外，由于电源管理芯片设计企业 Fabless 的特点，其研发设计必须与代工企业密切结合，在电路研发和特殊功率半导体工艺紧密结合的生产循环中才能逐步培养出合格的人才团队。因此，本行业对新进入者形成一定的经验壁垒。

(4) 客户关系壁垒

集成电路设计企业通常采用经销商模式，须不断坚持以市场需求为导向，开发能为客户带来利益的产品，并在不断的磨合实践中逐步提高产品性能和上机合格率至客户满意的水平。因此，与下游大型制造厂商的经销商建立起的合作关系和信任度，是建立在 IC 设计企业产品的可靠性、一致性、加工工艺稳定、售后服务及时有效、而且成熟产品能够在工艺优化前提下实现逐年降价等全方位综合指标满足经销商和终端用户要求的基础之上的，而牢固的合作关系一经建立，新进入者就很难在相同或相似的产品领域与之竞争。因此，本行业对新进入者还具有一定程度的客户关系壁垒。

(三) 行业基本风险特征

1、行业竞争激烈，中小企业研发投入压力较大

电源管理芯片设计在国内尚属于成长中的新兴产业，新技术可能随着行业的发展环境和国际国内消费市场的变迁而发生变革，并在行业范围内推广应用，行业内规模

较小的公司若不能及时跟上新技术变革的步伐，将对其业务的持续开展和市场的持续开拓产生不利影响。同时，随着国际龙头企业对华加大投资力度，IC设计企业需要投入大量研发费用才能持续跟随技术发展的最新动态，中小企业的资金压力愈发凸显。

2、本土企业仍处于低端竞争的红海市场

目前，在IC设计领域，业界国际知名企业具有强大的研发、创新能力，将生产基地转移到中国后，重点从事行业内高端产品的生产和销售，这类产品的需求量小、附加值高，而本土企业则主要生产、出口、销售市场需求量较大的中低端产品，附加值比较低。面对下游经销商逐年削减成熟产品售价的压力，本土企业必须不断优化工艺，开源节流，面临更大的竞争压力。

3、代工企业产能瓶颈的风险

作为Fabless的IC设计企业，在长期的设计——代工的业务循环中，可能形成对某些特定晶圆生产企业的生产依赖性。如果变更代工企业，则设计企业的产品参数和流片工艺可能发生较大改动，需要半年以上的磨合期。因此，一旦公司未来产能需求迅速扩张，代工企业可能出现产能瓶颈的风险。另一方面，生产线外包可能出现质量控制的相关风险。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争优势

1、技术优势

公司通过自主创新，创立了一整套核心技术方案。公司是“江苏省知识产权管理规范化示范单位”，核心技术全部为自主技术。目前公司已经拥有几十项国际、国内发明专利，在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势。

2、人才和管理优势

目前，公司拥有一支专业的技术团队，核心骨干均为拥有多年实践经验的专业人

员，同时，公司的管理团队也拥有丰富的生产、研发、市场及管理经验。优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。

3、销售网络优势

公司现行的销售模式经过多年的成功运作，已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的客户群体。公司通过完善客户关系管理体系，积极谋求与现有客户建立稳固的战略合作关系，还通过搭建的销售网络来拓展更多的客户来源。

4、综合比较优势

公司在长期独立面向市场的运营中，逐渐积累起自身的综合比较优势，体现在：

- (1) 产品贴近市场；
- (2) 加工供应商地理位置比较近，加工工艺上有密切合作；
- (3) 供应商地理位置近利于质量管理到位，质量处理及时；
- (4) 与高等院校合作紧密。

近几年，公司的电源管理芯片工艺已从 0.5 微米为主步入现在的 0.18 微米阶段，其主要应用方向也进入了节能低碳的电磁炉、电压力锅等领域，美的电磁炉中主要电源芯片的 80%来自本公司。

2012 年度，江苏省集成电路设计产业实现销售 92.6 亿元，同比增长 16.1%，占中国（大陆）设计业总销售额的 14.9%。其中，排名前十的集成电路设计业骨干企业如下表所示：

序号	企业名称
1	中电科技集团第 55 所
2	无锡华润矽科微电子有限公司
3	江苏东大集成电路系统工程技术有限公司
4	美新半导体（无锡）有限公司
5	中电科集团第 58 所
6	无锡中星微电子有限公司
7	无锡芯朋微电子股份有限公司
8	无锡力芯微电子股份有限公司
9	无锡友达电子有限公司
10	无锡新洁能功率半导体有限公司

（数据来源：《江苏省集成电路产业发展报告（2012 年度）》）

目前,国内从事模拟类集成电路设计和功率类集成电路设计的企业总计约 130 家,2012 年销售总额为 60 多亿元,平均销售收入接近 5,000 万元,而公司销售额为 1.3 亿元,已显著高于细分行业的中位数水平(数据来源:中国半导体行业协会集成电路设计分会);而与全国排名前十的集成电路设计企业 10 亿数量级的销售规模相比,公司仍属于规模较小的成长型企业,无论在规模、资金、工艺和装备方面均有很大的提升空间。

(二) 公司的竞争劣势

1、产品系列有待完善

受公司目前的规模限制,公司产品相对集中小家电等民用领域,产品类型相对单一,在工业级以及更高端应用的产品设计和整机产品设计方面缺乏相关经验和品牌识别度,因此,公司产品系列有待进一步完善。

2、资金实力有待加强

目前,公司主要依靠自身资金积累实现发展。然而随着公司市场份额和业务规模的进一步扩大,对资金的需求也将日益增加,因此,缺乏持续的资金支持将会制约公司的发展速度。

(三) 公司采取的未来竞争策略和应对措施

面对激烈竞争的市场环境,公司采取的主要竞争策略是:首先,从细分市场上把握节奏,集中力量,先进攻民用的大宗消费类电子市场,避开与国际巨头在高端产品市场的正面冲突;其次,利用本土优势,贴近客户,加强售前、售中与售后的服务工作,优化工艺,为客户提供性价比更高的产品。

放眼未来,公司将利用其在小家电市场已取得的品牌认知度和产品管理经验,大力进军 LED 和通用适配器行业。目前公司已开发出数十个产品,并获得了部分客户的认可,公司计划在未来 3 年时间内,进入国内该行业前 3 位的供应商。公司另一个主要市场是近年快速增长的平板电脑市场,在国内品牌产品和代工市场,公司的芯片解决方案也占据了较大的市场份额,在国内同行业内市占份额名列三甲;在相关的移动电源市场,公司也推出了集成度更高的芯片解决方案,市场正不断扩大;此外,公

司新开发的背光产品也开始进入智能手机市场，目前已开始在国内著名品牌的手机厂商产品中应用，并大批量出货。为进一步拓宽产品线，提高抗风险能力，公司已开始密切关注工业电源模块和直流马达驱动的市场需求，适时进入这一应用领域。

未来几年，公司将在电路系统设计和器件工艺研究上持续投入，保持并扩大在技术上对国内同行的领先优势，努力缩小与国外高水平公司的差距，并争取赶超，迅速开发出客户满意的产品；同时，与整机产品生产领域的标志性客户建立长期合作的关系，共同开发下一代整机所需的电源方案，引导该领域的生产企业更多地采用公司的方案，进一步提升公司的市场占有率。

第三章 公司治理

一、公司治理机构的建立健全及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会建立健全情况

有限公司阶段，芯朋有限根据《公司法》制定了《公司章程》并按其规定及时召开股东会，形成相应的股东会决议。虽然治理结构较为简单，但仍能有效地进行决策，保护了股东和公司的利益。

芯朋股份自成立以来，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事制度和董事会秘书制度。股东大会参考上市公司要求及非上市公众公司的具体情况制定通过了《累积投票制实施细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理制度》等内部控制制度；董事会制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书制度》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《提名委员会工作细则》等制度。

公司已经建立了股东大会、董事会、监事会，并在公司章程中明确了三会的权限、职责，规定了会议通知、召集、召开、表决等程序。公司章程及三会议事规则的具体条款内容符合现行法律法规的要求。

(二) 股东大会、董事会、监事会规范运作情况

芯朋股份成立后，共计召开股东大会 8 次、董事会 11 次、监事会 5 次。公司能够依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会，做到会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。董事会秘书专门负责记录、保管会议文档，会议记录、会议决议等书面文件内容完整，保存较好。

目前，公司所有股东均为公司员工，无外部投资者。现任董事、监事均为创立大会时经股东提名，由股东大会选举产生。公司董事会和监事会均为股份公司成立后第一届，均尚在任期内，未发生换届选举。待本届董事会和监事会任期届满之后，公司将根据法律法规及公司章程的规定及时进行换届。

公司董事会参与对公司的战略目标制定，今后将及时检查其执行情况，并以董事会工作报告的形式对管理层业绩进行评估。公司已经建立了相关关联董事、关联股东及其他利益相关者的表决权回避制度。

公司职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，占监事会成员的三分之一以上，职工代表监事能够依法履行监事职责，维护职工合法权益。公司监事会议事规则，对监事的职权和监督手段规定明确具体，有利于保障公司职工代表监事能够积极参与监事会会议，充分表达意见，切实维护基层职工的利益。

公司已经建立了健全的治理架构及决策机制，并得到有效的运行。

二、公司董事会对治理机制的评价

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护并能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》对投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、独立董事制度、关联股东和董事回避制度等作出了规定，公司还专门制定了《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》。公司已按财政部等颁发的《企业内部控制基本规范》等相关法规的要求设计与建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度、内部控制制度和控制体系。公司能严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况

公司在报告期内不存在违法违规及受处罚的情况。

控股股东、实际控制人张立新最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立的产供销体系，并具有面向市场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

（一）业务独立

公司具备完整的业务流程、专门的经营场所、全面的机构设置、独立的采购、销售渠道、研发体系，公司经营决策独立于股东或关联方。公司自主开展业务，以自己的名义对外签订合同，具有面向市场自主经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。除公司和无锡泰思特存在少量关联采购的情况外，公司不存在其他的关联采购和关联销售的情况，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

我们认为，公司业务独立。

（二）资产独立

公司在变更设立时，原有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。公司主要资产为电子设备，公司对该等设备均为购买获得，权利完整，不存在权属纠纷或潜在纠纷。公司不存在自有的房屋、土地使用权等，公司目前所使用的房屋均为租赁使用，公司签订的房屋租赁合同真实、有效，可以合法使用。公司名下商标、专利、实用新型、布图设计等无形资产均登记于公司名下。公司目前不存在关联公司占用公司资产等情况。

我们认为，公司资产独立。

（三）人员独立

公司建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人、其他股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

公司与员工签订劳动合同，按时缴纳社会保险。公司劳动关系、工资报酬、社会保险完全独立管理。

我们认为，公司人员独立。

（四）财务独立

公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行独立结算。公司成立后办理

了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，独立在银行开户、独立纳税。具有规范的财务会计制度。

我们认为，公司财务独立。

（五）机构独立

公司组织结构健全，已建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事、监事会、董事会秘书等完备的法人治理结构；公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司具有完备的内部管理制度，各部门依照《公司章程》等内部规章制度在各自职责范围内独立决策，行使经营管理职权。办公机构与股东单位、关联企业不存在混合经营、合署办公的情况。

我们认为，公司机构独立。

五、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人为张立新先生。截至本公开转让说明书签署之日，张立新先生除持有本公司股份外，还在无锡泰思特担任监事；本公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人张立新先生出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

“本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司的控股股东及实际控制人，目前未从事或经营与公司存在同业竞争的行为。为了避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人郑重承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或经营任何在商业对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

2、本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；

3、本人在持有公司股份期间、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

六、关联方资金占用情况

公司最近两年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易管理制度》。

七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况

（一）本人及直系亲属持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职情况	本人直接持股数量（万股）	直系亲属持股或间接持股数量（万股）	直系亲属持股或间接持股方式
1	张立新	董事长 总经理	1,252.50	--	--
2	李志宏	董事 副总经理	200.00	--	--
3	周飙	董事 副总经理	150.00	--	--
4	薛伟明	董事 副总经理	100.00	--	--
5	易扬波	董事 副总经理	150.00	--	--
6	张韬	监事会主席	50.00	--	--
7	陶晓华	职工代表监事	1.50	--	--
8	陶平	职工代表监事	3.00	--	--
9	陈健	副总经理 董事会秘书	100.00	--	--
合计			2,007.00	--	--

（二）相互之间关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

1、重要协议

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议。

2、重要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人张立新先生出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》，具体情况详见本说明书“五、同业竞争情况”之相关内容。

（2）其他承诺

公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。

（四）在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	在本公司任职情况	在其他单位兼职情况
1	张立新	董事长 总经理 核心技术人员	无锡市泰思特测试有限责任公司监事

公司董事、监事、高级管理人员均未在关联企业领取薪酬。

（五）对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在投资或控制的企业与本公司从事相同、相似业务的情况，也不与本公司存在利益冲突。

（六）最近两年受到中国证监会、全国股份转让系统公司处罚情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

（一）董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事共 5 名，为张立新、李志宏、周飙、薛伟明、易扬波，张立新任董事长。

有限公司阶段，芯朋有限设董事会。2010 年 11 月 10 日，公司召开股东会，选举张立新、李志宏、陈健、易扬波、薛伟明及周飙为公司董事。并于 2011 年 1 月 4 日完成工商备案手续。

2011 年 11 月 25 日，芯朋股份召开创立大会暨第一次股东大会，选举张立新、李志宏、周飙、薛伟明、易扬波为董事，共同组成第一届董事会，任期三年。

同日，芯朋股份董事会召开第一届董事会第一次会议，选举张立新为董事长。并就此完成了工商备案。

（二）监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事共 3 名，为张韬、陶晓华、陶平，张韬任监事会主席。

有限公司阶段，芯朋有限不设监事会，设监事一名。2009 年 3 月 26 日，公司召

开股东会，选举张韬为公司监事，历经连选连任。并分别于 2009 年 4 月 3 日及 2011 年 1 月 4 日完成工商备案手续。

2011 年 11 月 25 日，芯朋股份召开创立大会暨第一次股东大会，选举张韬为股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事陶晓华、陶平组成第一届监事会，任期三年。

同日，芯朋股份监事会召开第一届监事会第一次会议，选举张韬为监事会主席。并就此完成了工商备案。

（三）高级管理人员

截至本公开转让说明书签署之日，公司有总经理 1 名，副总经理 5 名，董事会秘书 1 名。目前公司总经理为张立新，副总经理为李志宏、周飙、易扬波、薛伟明、陈健，陈健任董事会秘书。

有限公司阶段，公司设总经理一职，为公司高级管理人员。2010 年 11 月 10 日，芯朋有限召开董事会，聘任李志宏为公司总经理，并于 2011 年 1 月 4 日完成工商备案手续。

2011 年 11 月 25 日，芯朋股份召开第一届董事会第一次会议，聘任张立新为总经理，聘任李志宏、周飙、许思澄、易扬波、薛伟明、陈健为副总经理，聘任陈健为董事会秘书。

2012 年 7 月，许思澄由于个人原因向董事会递交辞呈，辞任公司副总经理一职。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员近两年内未发生变动。

近两年，除副总经理许思澄因个人原因离职外，公司其他董事、监事、高级管理人员均保持稳定，未发生重大变化，经营持续稳定。

九、公司重要事项决策和执行情况

公司在有限公司阶段，未建立三会管理制度，也未建立关联交易、重大投资等管理制度，公司仅会就经营问题召开董事会、股东会。有限公司阶段，除涉及股权变更、经营范围变更等需要工商变更的事项外，公司不存在重大事项的决策决议。股份公司成立后，公司建立了三会议事规则及关联交易管理办法、重大投资管理办法等制度，并设立了董事会、监事会，选举了董事、监事。在股份公司成立后至今，公司的重要

事项决议主要是为股份公司制度完善的需要而做出的，这些决议都能得到很好的执行。

报告期内，公司除经第一届董事会第五次会议审议通过进行过委托理财外，没有发生其他对外担保、重大投资、委托理财事项。

无锡泰思特作为张立新任监事的公司，报告期内与公司存在一定的业务往来，该交易经公司第一届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决。该交易定价公允，不会对公司今后的持续经营造成损害。

公司管理层已经出具声明，未来将根据公司章程、关联交易管理相关制度控制并规范可能的关联交易事项。公司目前不存在与其他关联公司的关联交易事项，今后如有关联交易事项，将根据公司章程和关联交易制度规范管理。

第四章 公司财务

一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

(一) 公司财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 2006 年财政部公布的《企业会计准则—基本准则》、38 项具体会计准则、应用指南及准则解释等规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

(二) 公司报告期的审计意见

公司最近两年一期聘请的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，具有证券期货从业资格，没有更换过会计师事务所。

江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司改制设立为股份公司所出具的财务报告以及公司最近两年一期的财务报告进行了审计，出具了苏公 W[2011]A668 号及苏公 W[2013]A725 号审计报告，注册会计师认为，公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年 1~6 月、2012 年度、2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(三) 公司报告期的合并范围

公司报告期的合并范围如下：

时间 范围	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
被投资单 单位名称	苏州博创集成电路设计有限 公司	苏州博创集成电路设计 有限公司	苏州博创集成电路设计有 限公司
	深圳芯朋电子有限公司	深圳芯朋电子有限公司	-
	-	-	无锡博创微电子有限公司

公司目前持有苏州博创 100% 的股权，苏州博创设立于 2008 年 3 月 14 日，2010 年 9 月 17 日，公司与原股东徐之伟、易扬波签订股权转让协议，收购苏州博创 100% 的股权，并于 2010 年 9 月 28 日完成工商变更。

2012年1月5日，芯朋股份召开2012年第一次临时股东大会，决定设立深圳芯朋，注册资本为100万元。

苏州博创全资子公司无锡博创微电子有限公司于2010年11月30日决定停止营业，并成立清算小组。2011年8月31日完成所有清算并办理了工商注销登记手续。公司具体债权债务清理情况为：公司净资产2,961,585.42元，都为货币资金，根据股东决定，上述净资产都归属于苏州博创。

（四）公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

(单位：元)

资 产	合并数			母公司数		
	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：						
货币资金	26,211,185.36	49,595,842.13	35,586,331.29	15,223,166.12	17,896,385.50	7,960,750.81
交易性金融资产						
应收票据						
应收账款	26,586,257.50	25,139,559.45	21,342,983.71	25,828,773.97	24,352,817.19	18,667,100.38
预付款项	3,262,703.72	102,757.00	276,794.68	2,910,503.72	87,997.00	129,655.80
应收利息						
应收股利						
其他应收款	153,127.35	171,511.17	157,746.84	61,735.22	72,182.56	118,658.69
存货	27,995,442.96	22,310,279.72	24,204,514.12	20,992,041.58	13,757,854.68	8,776,068.38
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	22,144,809.21	80,464.00	9,464.00	22,010,114.00	9,464.00	9,464.00
流动资产合计	106,353,526.10	97,400,413.47	81,577,834.64	87,026,334.61	56,176,700.93	35,661,698.06
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						

长期股权投资	2,600,000.00	-	-	35,348,625.00	32,748,625.00	31,748,625.00
投资性房地产						
固定资产	2,444,436.44	2,925,429.65	2,560,441.69	466,831.98	552,326.99	437,548.08
在建工程						
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	-	6,212.57	31,062.53	-	6,212.57	31,062.53
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	-	-	54,229.90	-	-	54,229.90
递延所得税资产	1,754,644.49	1,897,704.58	1,711,464.95	432,980.40	411,125.31	459,288.07
其他非流动资产						
非流动资产合计	6,799,080.93	4,829,346.80	4,357,199.07	36,248,437.38	33,718,289.87	32,730,753.58
资产总计	113,152,607.03	102,229,760.27	85,935,033.71	123,274,771.99	89,894,990.80	68,392,451.64

资产负债表（续）

（单位：元）

负债及所有者权益	合并数			母公司数		
	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：						
短期借款						
交易性金融负债						
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	-
应付账款	16,766,799.90	11,107,990.14	8,356,866.06	19,670,339.68	23,094,446.27	25,483,840.43
预收款项	349,395.15	183,855.15	33,210.00	349,390.20	183,850.20	33,210.00
应付职工薪酬	1,000,000.00	2,527,299.00	2,451,935.03	750,000.00	1,872,170.00	1,824,251.00
应交税费	1,870,829.21	1,621,528.61	1,865,900.40	1,609,396.04	-72,176.63	448,212.30
应付利息						
应付股利						
其他应付款	235,463.91	60,471.03	769,785.25	28,080,032.01	60,471.03	50,462.29
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债	44,740.88	-	42,322.72	44,740.88	-	42,322.72
流动负债合计	25,267,229.05	20,501,143.93	19,520,019.46	55,503,898.81	27,138,760.87	27,882,298.74
非流动负债：						
长期借款						
应付债券						

长期应付款						
专项应付款						
预计负债	1,451,466.72	1,451,466.72	-			
递延所得税负债						
其他非流动负债	8,571,854.74	9,430,285.31	11,331,224.20	1,367,480.07	1,472,251.69	1,748,634.88
非流动负债合计	10,023,321.46	10,881,752.03	11,331,224.20	1,367,480.07	1,472,251.69	1,748,634.88
负债合计	35,290,550.51	31,382,895.96	30,851,243.66	56,871,378.88	28,611,012.56	29,630,933.62
股东权益：						
股本	20,500,000.00	20,500,000.00	20,000,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00	20,000,000.00
资本公积	20,115,526.55	20,115,526.55	18,615,526.55	20,115,526.55	20,115,526.55	18,615,526.55
减：库存股						
专项储备						
盈余公积	2,306,845.16	2,306,845.16	14,599.14	2,306,845.16	2,306,845.16	14,599.14
未分配利润	34,939,684.81	27,924,492.60	16,453,664.36	23,481,021.40	18,361,606.53	131,392.33
外币报表折算差额						
归属于母公司股东权益合计	77,862,056.52	70,846,864.31	55,083,790.05	66,403,393.11	61,283,978.24	38,761,518.02
少数股东权益						
股东权益合计	77,862,056.52	70,846,864.31	55,083,790.05	66,403,393.11	61,283,978.24	38,761,518.02
负债和股东权益总计	113,152,607.03	102,229,760.27	85,935,033.71	123,274,771.99	89,894,990.80	68,392,451.64

利润表

(单位：元)

项目	合并数			母公司数		
	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	76,130,303.75	130,612,694.25	121,847,211.91	73,660,718.75	124,323,938.86	111,007,780.26
减：营业成本	49,597,982.03	87,515,560.76	86,335,105.71	52,558,352.28	91,289,700.32	89,972,393.56
营业税金及附加	254,941.00	719,221.72	400,800.99	125,611.13	453,740.92	338,794.38
销售费用	1,193,604.21	1,849,853.95	1,958,903.96	954,065.01	1,831,808.83	1,931,396.54
管理费用	14,687,742.09	33,357,798.11	26,524,502.36	9,427,287.06	23,907,888.98	14,870,415.40
财务费用	-388,926.60	-458,618.39	313,564.05	-349,882.70	-235,472.76	497,389.22
资产减值损失	461,123.83	1,407,832.34	278,783.95	250,472.20	268,020.60	146,658.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
投资收益（损失以“-”号填列）				-	15,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,323,837.19	6,221,045.76	6,035,550.89	10,694,813.77	21,808,251.97	3,250,732.22
加：营业外收入	2,836,951.32	15,910,757.77	8,250,097.58	249,571.62	2,713,928.42	2,819,139.87
减：营业外支出	81,624.32	3,647,877.41	245,371.54	80,547.61	158,947.34	245,371.54

其中：非流动资产处置损失						
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,079,164.19	18,483,926.12	14,040,276.93	10,863,837.78	24,363,233.05	5,824,500.55
减：所得税费用	1,963,971.98	2,320,851.86	1,895,887.90	1,644,422.91	1,440,772.83	685,122.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,115,192.21	16,163,074.26	12,144,389.03	9,219,414.87	22,922,460.22	5,139,377.74
归属于母公司所有者的净利润	11,115,192.21	16,163,074.26	12,144,389.03	9,219,414.87	22,922,460.22	5,139,377.74
少数股东损益						
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	0.5422	0.7933	0.6072			
（二）稀释每股收益	0.5422	0.7933	0.6072			
六、其他综合收益						
七、综合收益总额	11,115,192.21	16,163,074.26	12,144,389.03	9,219,414.87	22,922,460.22	5,139,377.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,115,192.21	16,163,074.26	12,144,389.03	9,219,414.87	22,922,460.22	5,139,377.74
归属于少数股东的综合收益总额						

现金流量表

(单位：元)

项目	合并数			母公司数		
	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	85,236,427.69	146,270,066.05	136,282,601.63	82,380,475.55	137,369,809.89	126,468,633.81
收到的税费返还	720,401.12	237,306.44	673,311.25	720,401.12	237,306.44	673,311.25
收到的其他与经营活动有关的现金	3,475,721.62	14,551,336.59	11,747,866.49	1,599,454.15	2,778,128.54	4,812,895.08
经营活动现金流入小计	89,432,550.43	161,058,709.08	148,703,779.37	84,700,330.82	140,385,244.87	131,954,840.14
购买商品、接受劳务支付的现金	64,327,416.22	101,625,154.66	104,950,667.75	76,540,112.11	115,809,488.87	103,500,920.38
支付给职工以及为职工支付的现金	11,020,681.66	19,013,510.48	13,468,609.23	6,963,290.52	12,233,731.38	8,210,406.10
支付的各项税费	4,260,823.98	7,345,615.47	3,433,603.96	1,398,596.91	4,038,933.46	2,938,763.28
支付的其他与经营活动有关的现金	5,790,766.95	17,568,951.06	12,095,579.49	4,693,137.10	13,498,289.96	6,765,191.43
经营活动现金流出小计	85,399,688.81	145,553,231.67	133,948,460.43	89,595,136.64	145,580,443.67	121,415,281.19
经营活动产生的现金流量净额	4,032,861.62	15,505,477.41	14,755,318.94	-4,894,805.82	-5,195,198.80	10,539,558.95
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资所收到的现金						
取得投资收益收到的现金				-	15,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额						
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	2,936,808.56			

收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计	-	-	2,936,808.56	-	15,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	817,518.39	1,794,682.57	1,811,586.46	28,413.56	469,166.51	139,069.86
投资支付的现金	24,600,000.00	-	-	24,600,000.00	1,000,000.00	1,748,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	1,748,625.00			
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	25,417,518.39	1,794,682.57	3,560,211.46	24,628,413.56	1,469,166.51	1,887,694.86
投资活动产生的现金流量净额	-25,417,518.39	-1,794,682.57	-623,402.90	-24,628,413.56	13,530,833.49	-1,887,694.86
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金						
取得借款收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,000,000.00	27,950,000.00	-	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	1,000,000.00	27,950,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,100,000.00	2,400,000.00	5,475,492.38	4,100,000.00	2,400,000.00	5,475,492.38
其中：子公司支付给少数股东的现金股利						
支付其他与筹资活动有关的现金						
其中：子公司减资支付给少数股东的现金						
筹资活动现金流出小计	4,100,000.00	2,400,000.00	15,475,492.38	4,100,000.00	2,400,000.00	15,475,492.38

筹资活动产生的现金流量净额	-4,100,000.00	-400,000.00	-14,475,492.38	23,850,000.00	-400,000.00	-14,475,492.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响						
五、现金及现金等价物净增加额	-25,484,656.77	13,310,794.84	-343,576.34	-5,673,219.38	7,935,634.69	-5,823,628.29
加：期初现金及现金等价物余额	46,695,842.13	33,385,047.29	33,728,623.63	15,896,385.50	7,960,750.81	13,784,379.10
六、期末现金及现金等价物余额	21,211,185.36	46,695,842.13	33,385,047.29	10,223,166.12	15,896,385.50	7,960,750.81

2013年1-6月合并所有者权益变动表

单位：(元)

项目	2013年1-6月						
	归属于母公司的权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	20,500,000.00	20,115,526.55	-	2,306,845.16	27,924,492.60		70,846,864.31
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	20,500,000.00	20,115,526.55	-	2,306,845.16	27,924,492.60		70,846,864.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,015,192.21		7,015,192.21
（一）净利润					11,115,192.21		11,115,192.21
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	11,115,192.21		11,115,192.21
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	-4,100,000.00	-	-4,100,000.00
1. 提取盈余公积				-	-		-
2. 对所有者（或股东）的分配					-4,100,000.00		-4,100,000.00
3. 其他					-		-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-

2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
四、本年年末余额	20,500,000.00	20,115,526.55	-	2,306,845.16	34,939,684.81	-	77,862,056.52

2012 年合并所有者权益变动表

单位：(元)

项目	2012年度						
	归属于母公司的权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	20,000,000.00	18,615,526.55	-	14,599.14	16,453,664.36	-	55,083,790.05
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	20,000,000.00	18,615,526.55	-	14,599.14	16,453,664.36		55,083,790.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000.00	1,500,000.00	-	2,292,246.02	11,470,828.24	-	15,763,074.26
（一）净利润					16,163,074.26		16,163,074.26
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计					16,163,074.26	-	16,163,074.26
（三）所有者投入和减少资本	500,000.00	1,500,000.00					2,000,000.00
1. 所有者投入资本	500,000.00	1,500,000.00					2,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				2,292,246.02	-4,692,246.02		-2,400,000.00
1. 提取盈余公积				2,292,246.02	-2,292,246.02		-
2. 对所有者（或股东）的分配					-2,400,000.00		-2,400,000.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							-

2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
四、本年年末余额	20,500,000.00	20,115,526.55	-	2,306,845.16	27,924,492.60	-	70,846,864.31

2011年合并所有者权益变动表

单位：(元)

项目	2011年度						
	归属于母公司的权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	20,000,000.00	-		1,857,373.29	26,082,027.73	-	47,939,401.02
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	20,000,000.00	-		1,857,373.29	26,082,027.73		47,939,401.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	18,615,526.55		-1,842,774.15	-9,628,363.37		7,144,389.03
（一）净利润					12,144,389.03		12,144,389.03
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计					12,144,389.03		12,144,389.03
（三）所有者投入和减少资本							-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配				513,937.77	-5,513,937.77		-5,000,000.00
1. 提取盈余公积				513,937.77	-513,937.77		-
2. 对所有者（或股东）的分配					-5,000,000.00		-5,000,000.00
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	18,615,526.55	-	-2,356,711.92	-16,258,814.63		-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-

2. 盈余公积转增资本（或股本）		2,356,711.92		-2,356,711.92			-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他		16,258,814.63			-16,258,814.63		-
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
四、本年年末余额	20,000,000.00	18,615,526.55	-	14,599.14	16,453,664.36	-	55,083,790.05

2013年1-6月母公司所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2013年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,500,000.00	20,115,526.55		2,306,845.16	18,361,606.53	61,283,978.24
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	20,500,000.00	20,115,526.55		2,306,845.16	18,361,606.53	61,283,978.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-	5,119,414.87	5,119,414.87
（一）净利润					9,219,414.87	9,219,414.87
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计				-	9,219,414.87	9,219,414.87
（三）所有者投入和减少资本						-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入股东权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配					-4,100,000.00	-4,100,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-4,100,000.00	-4,100,000.00
3. 其他						-
（五）股东权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-

3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取						-
2. 本期使用（以负号填列）						-
四、本年年末余额	20,500,000.00	20,115,526.55	-	2,306,845.16	23,481,021.40	66,403,393.11

2012年母公司所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2012年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	18,615,526.55		14,599.14	131,392.33	38,761,518.02
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	20,000,000.00	18,615,526.55		14,599.14	131,392.33	38,761,518.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000.00	1,500,000.00		2,292,246.02	18,230,214.20	22,522,460.22
（一）净利润					22,922,460.22	22,922,460.22
（二）其他综合收益		-				-
上述（一）和（二）小计	-	-		-	22,922,460.22	22,922,460.22
（三）所有者投入和减少资本	500,000.00	1,500,000.00		-	-	2,000,000.00
1. 所有者投入资本	500,000.00	1,500,000.00				2,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配				2,292,246.02	-4,692,246.02	-2,400,000.00
1. 提取盈余公积				2,292,246.02	-2,292,246.02	-
2. 对所有者（或股东）的分配				-	-2,400,000.00	-2,400,000.00
3. 其他						-
（五）股东权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-

3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备						-
1. 本期提取						-
2. 本期使用 (以负号填列)						-
四、本年年末余额	20,500,000.00	20,115,526.55	-	2,306,845.16	18,361,606.53	61,283,978.24

2011年母公司所有者权益变动表

单位：（元）

项目	2011年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	-		1,857,373.29	16,764,766.99	38,622,140.28
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	20,000,000.00	-		1,857,373.29	16,764,766.99	38,622,140.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	18,615,526.55		-1,842,774.15	-16,633,374.66	139,377.74
（一）净利润					5,139,377.74	5,139,377.74
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计				-	5,139,377.74	5,139,377.74
（三）所有者投入和减少资本				-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入股东权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配				513,937.77	-5,513,937.77	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积				513,937.77	-513,937.77	-
2. 对所有者（或股东）的分配				-	-5,000,000.00	-5,000,000.00
3. 其他						-
（五）股东权益内部结转		18,615,526.55		-2,356,711.92	-16,258,814.63	-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		2,356,711.92		-2,356,711.92		-

3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他		16,258,814.63			-16,258,814.63	-
(六) 专项储备						-
1. 本期提取						-
2. 本期使用 (以负号填列)						-
四、本年年末余额	20,000,000.00	18,615,526.55		14,599.14	131,392.33	38,761,518.02

（五）公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计

公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计情况如下：

1、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

2、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项指期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由: 应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备计提方法: 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包含库存材料、在产品、半成品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价: 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本, 低值易耗品及包装物采用一次性摊销方法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备, 期末, 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

4、长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业的股权投资、本公司对联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值及发行股份面值总额之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期股权投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权

益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20% 至 50% 之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资减值

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值与按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

5、固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及办公设备等。

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量；投资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第21号—租赁》确定。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠地计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	5	5	19.00

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

6、资产减值准备

(1) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(A) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的应收款项指单笔金额 100 万元以上的应收款项。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

(B) 按组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%
1—2 年(含 2 年)	20.00%
2—3 年(含 3 年)	50.00%
3 年以上	100.00%

(C) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金

融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

(3) 存货跌价准备

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

资产负债表日，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额上限）调整存货跌价准备及当期收益。

(4) 长期股权投资减值

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

7、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

8、收入

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

9、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

10、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

报告期内，公司无会计政策变更。

（2）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

二、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计(万元)	11,315.26	10,222.98	8,593.50
负债总计(万元)	3,529.05	3,138.29	3,085.12
股东权益合计(万元)	7,786.21	7,084.69	5,508.38
归属于母公司所有者的股东权益合计(万元)	7,786.21	7,084.69	5,508.38
每股净资产(元)	3.80	3.48	2.75
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	3.80	3.48	2.75
资产负债率(母公司)	46.13%	31.83%	43.32%
流动比率(倍)	4.21	4.75	4.18
速动比率(倍)	2.97	3.65	2.92
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入(万元)	7,613.03	13,061.27	12,184.72
净利润(万元)	1,111.52	1,616.31	1,214.44
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	1,111.52	1,616.31	1,214.44
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	864.54	557.24	504.31
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	864.54	557.24	504.31
毛利率(%)	34.85	33.00	29.14
净资产收益率(%)	14.55	25.39	23.20
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	11.32	8.75	9.63
基本每股收益(元/股)	0.5422	0.7933	0.6072
稀释每股收益(元/股)	0.5422	0.7933	0.6072
应收账款周转率(次)	2.79	5.34	5.77
存货周转率(次)	1.87	3.65	3.68
经营活动产生的现金流量净额(万元)	403.29	1,550.55	1,475.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.76	0.74

(一) 盈利能力指标

公司2011年、2012年和2013年1~6月的毛利率分别为29.14%、33%和34.85%，

公司毛利率保持稳定，盈利亦连续保持增长，随着公司对产品种类的不断开拓以及对技术的不断更新，使得公司市场开发能力不断提高，规模优势愈显，盈利能力也将随着销售的提高而出现更高的增长。

2011年、2012年和2013年1-6月公司的全面摊薄净资产收益率分别为23.20%、25.39%和14.55%，扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率分别为9.63%、8.75%和11.32%；2011年、2012年和2013年1~6月公司的基本每股收益分别为0.61元、0.79元和0.54元，扣除非经常性损益后每股收益分别为0.25元、0.27元和0.42元。报告期内，公司经营状况平稳，公司收入呈逐渐增长状态，新产品开发、新市场开拓都为公司带来了可喜的业绩。随着公司研发力度的不断加强以及对市场的敏感把握，公司的经营状况及盈利前景将有更大的空间。

（二）偿债能力指标

2011年末、2012年末和2013年6月30日母公司的资产负债率分别43.32%、31.83%和46.13%。合并报表的资产负债率分别为35.90%、30.70%和31.19%。报告期内，公司经营稳健，资产负债率总体保持平稳，公司的主要负债为应付账款及其他非流动负债，应付账款为需支付给供应商的圆片加工、测试、封装费，都是公司为了正常经营而需支付的款项；其他非流动负债则为递延的政府补贴，根据企业会计准则其在使用时结转入营业外收入。利用财务杠杆适当负债经营能使公司更快更健康地发展，总体而言公司长期偿债风险较小。

2011年、2012年和2013年1~6月公司的流动比率分别为4.18、4.75和4.21，速动比率分别为2.92、3.65和2.97。公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货。流动、速动比率报告期内保持平稳且适中，公司偿债能力在安全边际范围之内，短期偿债风险较小。

（三）营运能力

2011年、2012年和2013年1~6月公司的应收账款周转率分别为5.77、5.34和2.79。公司的应收账款周转率较高，这是由于公司信用政策对不同种类客户区分较为细致，并针对其给予了不同的信用政策，销售部门与财务部门一同监管应收账款

的变化，使得应收账款余额保持稳定，占营业收入的比重也较低。公司的营运能力较强。

2011年、2012年和2013年1~6月公司的存货周转率分别为3.68、3.65和1.87。公司重视存货的管理，为此在三个方面对其进行管控：1、根据年销售计划、生产年计划、近三个月的实际销售情况及时调整生产计划。2、压缩生产周期，同时对在圆片厂、封装厂的在产品采取分段管控的方式，灵活安排生产，减少成品库存金额。3、定期盘点库存，对长库龄产品安排销售做重点推广，故公司存货周转率保持稳定且较快。

（四）获取现金能力

公司经营活动产生的现金流量净额在报告期内保持充裕且较高，报告期内公司销售收入稳步增长，应收账款催收力度也较大，经营活动产生的现金流量状况均较好，获取现金的能力较强，资金比较充沛。公司投资活动的现金流入是公司清算无锡博创而收回的现金，支出主要是公司购买机器设备、投资银行理财产品和上海翔芯以及收购苏州博创支付的余款所致。公司筹资活动的现金流入是增资及收回保证金所致，现金支出是由于公司偿还银行借款及相应利息、股利分配等造成，公司的现金及现金等价物的增减变化主要取决于公司的经营活动，从这个角度出发，公司经营活动的正常运作也决定了公司现金流量的正常和健康。

三、公司报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成情况

公司报告期营业收入的构成情况如下：

（单位：元）

时间 项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	76,010,303.75	99.84	130,423,643.25	99.86	121,847,211.91	100.00
其他业务收入	120,000.00	0.16	189,051.00	0.14	-	-
合计	76,130,303.75	100	130,612,694.25	100	121,847,211.91	100

公司其他业务收入是收取的技术许可费。公司设计的产品数据，经过授权后，授权方可直接向加工厂发出订单，而公司根据授权协议，从被授权方按订单量收取约定的费用。

公司报告期主营业务收入的构成情况如下：

按产品分类

(单位：元)

项目 \ 时间	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
集成电路收入	74,871,613.89	98.50	125,980,122.53	96.59	110,908,375.97	91.02
功率晶体管产品收入	1,138,689.86	1.50	4,443,520.72	3.41	10,938,835.94	8.98
合计	76,010,303.75	100	130,423,643.25	100	121,847,211.91	100

公司产品属于电源管理集成电路，主营业务收入主要由集成电路、功率晶体管产品组成。

电源管理集成电路在电子系统中承担所有功能模块和元器件的电力供应管理，保证所有电子零部件能够获得合适的供电方式，并能正常工作，在此基础上还要达到降低系统耗电的要求。公司生产的集成电路产品主要应用于厨房小家电、机顶盒、电源适配器等交流电供电的产品，可把交流电转换成这些产品内部所需的直流电压；也有大量的集成电路品种应用于平板电脑等数码便携产品中，可把这类产品的直流供电电源转换成其内部所需的多种不同的直流电压，为其中的CPU、存储器、音频功放、射频功放、LED背光模块、液晶屏、锂电池的充电和电压监控等所有零部件提供正常工作所需的不同电压。公司将这些集成电路通过不同的经销商销售给电子产品的生产企业，如美的、苏泊尔、TCL、伟易达、宝淇、兆驰等电子产品生产加工企业。

功率晶体管在电子系统中作为信号放大或大功率半导体开关之用，是一类通用型的半导体器件。公司销售的功率晶体管品种不多，主要是几种DMOS功率开关管，可用于电动自行车的电机驱动和交直流转换器中的功率开关。公司开发这类器件是为了加强器件工艺的研究，并为开发特殊规格的专用功率器件作准备，这类特殊规格功率器件将仅为公司自己的交直流转换集成电路配套。公司已在逐步地收缩普通功率管的业务，因为对设计公司而言，此类产品的赢利水平明显偏低。

按销售地区分类

(单位: 元)

时间 地区	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
国内	63,199,251.79	83.15	117,180,901.58	89.85	107,071,267.04	87.87
国外	12,811,051.96	16.85	13,242,741.67	10.15	14,775,944.87	12.13
合计	76,010,303.75	100	130,423,643.25	100	121,847,211.91	100

公司内外销比例在报告期内保持平稳, 销售额保持一定的增长, 公司主营业务收入主要来源于国内, 占比都在 80% 以上。随着公司进一步开拓海外销售渠道, 海外客户对公司产品的接受度在逐步地增加, 使得公司本期外销收入有明显的增长。

(二) 产品毛利率及其变化趋势

公司报告期产品毛利率及其变化趋势如下:

按产品分类

期间 产品类别	2013年1-6月平均毛利率(%)	2012年度平均毛利率(%)	2011年度平均毛利率(%)	2013年1-6月同比2012年波动幅度(%)	2012年同比2011年波动幅度(%)
集成电路	35.02	33.43	30.08	1.59	3.35
功率晶体管产品	16.76	17.83	19.62	-1.07	-1.79
综合毛利率	34.75	32.90	29.14	1.85	3.75

公司主要产品为集成电路产品及功率晶体管产品, 功率晶体管产品占公司总体销售额比重较低, 且产品附加值也较低, 因此公司产品整体毛利率的变化由集成电路产品引导。集成电路产品毛利率的波动主要受产品销售价格及产品成本的影响。

产品销售价格: 报告期内公司常规产品销售价格较为平稳, 公司与客户之间也已保持了长久的合作关系; 考虑到市场竞争因素, 公司产品售价稳中略降, 与电子行业的整体趋势一致, 但仍始终保持了一个合理的利润率。

产品成本: 公司产品的成本主要由圆片加工及封装测试费用构成。公司成本增长的比例低于同期收入增长的比例, 这主要得益于公司研发的持续投入。第一, 开发新产品的投入: 公司的研发团队能敏锐地观察到新技术新产品, 使得新产品在前期获得较好的利润; 第二, 原有产品的升级开发: 公司技术人员通过技术革新, 提供原有产品的优化方案并予以规模化后降低产品的成本。

综上所述，报告期内，公司各类产品毛利率变化较为稳定。

按销售地区分类

地区\时间	2013年1-6月平均毛利率(%)	2012年度平均毛利率(%)	2011年度平均毛利率(%)	2013年1-6同比2012年波动幅度%	2012年同比2011年波动幅度%
国内	36.56	33.82	31.06	2.74	2.76
国外	25.83	24.73	15.25	1.10	9.48

报告期内，公司国内国外定价机制保持统一，但归属于同一期间的两个地区毛利率存在一定差异，这是由于境外客户对换代产品的认证周期较长，使得出口产品的更新换代工作较内销产品存在滞后，老产品的毛利率较新产品的毛利率略低。2012年，公司销往国外的产品进行了一次更新换代，但其更新进度仍落后于国内产品。

(三) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期主营业务收入和利润总额及变动情况如下：

(单位：元)

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2012年比上年增长比率
营业收入	76,130,303.75	130,612,694.25	121,847,211.91	7.19%
营业成本	49,597,982.03	87,515,560.76	86,335,105.71	1.37%
毛利	26,532,321.72	43,097,133.49	35,512,106.20	21.36%
营业利润	10,323,837.19	6,221,045.76	6,035,550.89	3.07%
利润总额	13,079,164.19	18,483,926.12	14,040,276.93	31.65%
净利润	11,115,192.21	16,163,074.26	12,144,389.03	33.09%
归属于母公司的净利润	11,115,192.21	16,163,074.26	12,144,389.03	33.09%

2012年公司营业收入比2011年增长了7.19%，主要有以下两个原因：第一，公司及时调整市场策略。公司从2011年开始进入MID、移动电源等增长行业，2012年取得了初步成效，是收入的一个新增长点。第二，公司着力开拓市场。由于公司业务性质，客户基本处于华南地区，公司于2012年成立深圳子公司，就是着力于开拓市场。此外，公司与经销商维持了稳定的业务关系，通过经销商了解客户需求，在节约销售成本的同时还能了解市场需求，从而合理地调整销售、研发重点，增加销售收入。2013年1~6月，公司销售仍然旺盛，公司在MID、移动电源行业公司

的销售进一步得到快速增长；同时由于电子行业进入了增长的行业周期，公司传统小家电市场得到复苏；此外，公司在产品研发、市场开拓方面仍然下大力气，使得今年销售收入同比有明显增长。

报告期内，公司经营毛利 2012 年较上一年度有明显增长，但营业利润较为平稳，其主要原因在于管理费用中研发费用的增加，一方面公司凭借自身的技术优势及科研力量在 2012 年投入了更多的资金用于完成承接的政府项目；另一方面公司面对市场竞争的形势，为了维持公司产品的竞争优势，在 2012 年继续加大研发投入。

2012 年公司利润总额较 2011 年增长较多的原因在于公司 2012 年投入政府项目的研发资金增多，相对应地增加了研发费用的投入，按照企业会计准则对政府补贴项目的核算要求，研发费用增加的同时结转相对应的营业外收入，因此 2012 年政府项目投入增加的同时结转了较多的营业外收入，使得利润总额增长较大。

2012 年公司所得税费用由于利润总额的增加而有所增加，净利润的增长比例和利润总额的增长比例较为接近。

（四）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

（单位：元）

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度	2012 年比上年增长比率
营业收入	76,130,303.75	130,612,694.25	121,847,211.91	7.19%
销售费用	1,193,604.21	1,849,853.95	1,958,903.96	-5.57%
管理费用	14,687,742.09	33,357,798.11	26,524,502.36	25.76%
财务费用	-388,926.60	-458,618.39	313,564.05	-246.26%
期间费用合计	15,492,419.70	34,749,033.67	28,796,970.37	20.67%
销售费用/营业收入	1.57%	1.42%	1.61%	-0.19%
管理费用/主营收入	19.29%	25.53%	21.76%	3.77%
财务费用/营业收入	-0.51%	-0.35%	0.26%	-0.61%
期间费用/营业收入	20.35%	26.60%	23.63%	2.97%

公司销售费用占营业收入的比重 2012 年比 2011 年减少的主要原因有以下几点：第一，公司产品大多是通过经销商销往终端客户，通过多年的业务往来，公司已与

经销商保持了长期稳定的业务关系，销售成本有所下降。第二，公司经销商主要集中在华南地区，2012年3月深圳子公司成立，这在一定程度上缩短了与主要经销商的距离，降低了人工及差旅费支出。

公司管理费用占营业收入的比重2012年比2011年增加的主要原因是公司研发费的增加，一方面公司凭借自身的技术优势及科研力量在2012年投入了更多的资金用于完成承接的政府项目；另一方面公司面对市场竞争的形势，为了维持公司产品的竞争优势，在2012年继续加大研发投入。公司对研发的投入在一定程度上也能保证公司未来的可持续发展。

公司财务费用占营业收入的比重2012年比2011年减少的原因主要为公司2011年偿还了1,000万的借款，2012年未有利息支出。财务费用的金额较小，对营业收入的比重也较低。

总体来说，公司收入、成本和费用配比合理。

（五）非经常性损益情况

公司非经常性损益的构成如下：

（单位：元）

序号	项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
1	计入当期损益的政府补助	2,810,830.57	15,873,186.12	8,114,971.94
2	产品质量赔偿支出	-	-3,488,027.89	-
3	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,633.86	2,343.88	761.88
	小计	2,829,464.43	12,387,502.11	8,115,733.82
	减：所得税影响数	359,700.17	1,796,778.18	1,014,466.72
	合计	2,469,764.26	10,590,723.93	7,101,267.10
	扣除非经常性损益后净利润	8,645,427.95	5,572,350.33	5,043,121.93
	非经常性损益净额占净利润比重	22.22%	65.52%	58.47%

公司的主要非经常性损益项目为计入当期损益的政府补助、产品质量赔偿支出等。

1、计入当期损益的政府补助：公司收到的补贴收入详见下表。2011年共结转营业外收入8,114,971.94元、2012年15,873,186.12元、2013年1~6月2,810,830.57元。

2013年1-6月政府补助明细	金额	说明
创新先锋企业奖励	90,000.00	苏州市科技局 苏科计[2012]191号、苏州市财政局 苏财科字【2012】81号
企业博士集聚计划资助	90,000.00	江苏省企业博士集聚计划 苏组通【2011】38号
无锡市新区管委会 IC 专项补贴	125,800.00	
递延收益	2,486,030.57	其他非流动负债转入
其他	19,000.00	
合计	2,810,830.57	

2012年度政府补助明细	金额	说明
2011 重点产业升级基金项目	225,000.00	无锡新区地方经济贸易局 锡新地经发[2011]74号
		无锡新区经济发展局 锡新管经发[2011]469号
		无锡新区财政局 锡新管财发[2011]195号
2012 信息与外包专项资金	108,000.00	无锡新区信息与服务业发展局 锡新管信服发[2012]2号
		无锡新区发展局 锡新管科发[2012]19号
		无锡新区财政局 锡新管财发[2012]63号
江苏省工程技术研究中心认定奖励	400,000.00	苏州工业园区管理委员会 苏园管[2012]19号
创新先锋企业奖励	80,000.00	苏州市科学技术局 苏科计[2012]191号
		苏州市财政局 苏财科字[2012]81号
江苏省企业博士集聚计划资助资金	75,000.00	中共江苏省委组织部、江苏省科学技术厅、江苏省人力资源和社会保障厅 苏组通[2011]38号
博分后科研项目补贴	85,000.00	苏州工业园区管理委员会 苏园工[2008]141号
高新技术产品认定奖励	20,000.00	
集成电路设计企业流片及测试费用补贴	2,302.00	苏州工业园科技发展局 苏园科[2008]38号
房租补贴	574,645.23	
2011 软件及信息服务业政策扶持资金	50,000.00	
新区管委会（产业化贴息）	276,300.00	
专利资助	21,000.00	
新区管委会（2011 新区第四批政策兑现）	65,100.00	
新区专利资助	12,500.00	
递延收益	13,878,338.89	其他非流动负债转入
合计	15,873,186.12	

2011 年度政府补助明细	金额	说明
2011 年动漫服务外包集成电路专项补贴	144,000.00	锡新管信服发[2011]4 号
集成电路企业销售大户奖励	250,000.00	苏园管[2006]11 号
2010 年省工程技术研究中心项目园区配套资金	400,000.00	苏科计[2010]161 号、392 号
博士后科研项目	350,000.00	苏府规字[2011]11 号
国家重点新产品补贴收入	300,000.00	国科发计[2010]706 号
知识产权优势企业培训计划经费	20,000.00	苏知专[2010]83 号、苏财科[2010]108 号
房租补贴	806,918.35	
软件及服务奖金信息	15,000.00	
无锡市科技进步奖	6,000.00	
征地补贴	1,139.76	
省级 10 年度发明专利资助	4,000.00	
新区管委会孵化补贴	291,900.00	
其他	20,860.24	
递延收益	5,505,153.59	其他非流动负债转入
合计	8,114,971.94	

2、产品质量赔偿支出：公司的全资子公司苏州博创于 2012 年发生了产品质量赔偿事故，共计需支付给四川长虹电器股份有限公司 3,488,027.89 元，其中，2012 年公司支付现金 2,036,561.17 元，对于剩余部分 1,451,466.72 元的赔偿方式，公司已 于 2012 年 5 月 21 日与四川长虹电器股份有限公司、四川虹欧显示器件有限公司签订了《关于苏州博创扫描集成电路模组返工赔偿协议》，协议约定由于苏州博创销售给长虹电器的扫描集成电路质量问题，苏州博创赔偿四川虹欧显示器件有限公司 PDP 模组返工的所有生产费用，合计人民币 1,451,466.72 元，该部分费用赔偿由苏州博创在后期供货 160 万只扫描集成电路范围内完成。截止 2013 年 6 月 30 日，该部分扫描集成电路尚未供货。

公司 PN096S 产品在长虹电器批量生产后于 2012 年 3 月突然连续发生批次性质量事故，经过排查，发现公司上游厂家中的一家深圳的封测加工厂深圳中星华电子有限公司因自身财务问题，资金链短缺，在没有通知公司的前提下，自行将公司原用的封装辅助材料从日本产材料变更为韩国产材料，并直接用于公司正常的产品加工。事后公司对该材料进行内部老化考核时，发现每个批次都发生了可靠性失效，确认该失效将严重影响到客户的品质，为此，公司下达了召回指令。

2012 年 5 月经过与四川长虹电器股份有限公司的友好协商，双方达成具体的赔偿数额及赔偿方式，金额共计 3,488,027.89 元。同时，公司于 2012 年 5 月向中星华电子发出了索赔函，但未得到中星华电子的确认，当年中星华电子宣布破产，由于

中星华电子未确认公司的索赔要求，法院不能认可公司债权人的身份，故在该次质量事故中，公司未能从中星华电子处得到补偿。

鉴于上述事件，公司加强了外包商的管理，安排人员定期和外包商沟通，随时了解外包商的动态，掌握其主要的财务状况。此后未有类似情况产生，该事件属偶发事件，不对公司未来经营产生实质影响。

3、其他营业外收入和支出：其他营业外收入支出主要为罚款收入、无法支付的款项、捐赠支出等。2011年、2012年、2013年6月分别发生761.88元、2,343.88元和18,633.86元。

(单位：元)

序号	项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
1	罚款收入	-	5,000.00	-
2	无法支付款项	-	-	94,245.38
3	捐赠支出	-	-	-100,000.00
4	其他收支	18,633.86	-2,656.12	6,516.50
	合计	18,633.86	2,343.88	761.88

(六) 税项及享受的主要财政税收优惠政策

公司税项及享受的主要财政税收优惠政策列示如下：

1、增值税

公司增值税税率为应税收入的17%。

2、企业所得税

2007年8月，本公司被国家信息产业部认定为集成电路设计企业，从2007年度起享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策。

本公司于2008年12月经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合发文认定为高新技术企业，并于2011年9月通过复审，取得“高新技术企业证书”，证书号：GF201132000093，发证时间2011年9月9日，有效期三年。

苏州博创于2009年被国家信息产业部认定为集成电路设计企业，从2009年度起享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策。

苏州博创于 2009 年 5 月经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合发文认定为高新技术企业，并于 2012 年 8 月通过复审，取得“高新技术企业证书”，证书号：GF201232000560，发证时间 2012 年 8 月 6 日，有效期三年。

深圳芯朋企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。

3、城市维护建设税

公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

4、教育费附加

公司教育费附加按实际缴纳流转税额的 3% 缴纳；地方教育费附加按实际缴纳流转税额的 2% 缴纳。

四、公司报告期主要资产情况

（一）货币资金

公司报告期的货币资金情况如下：

（单位：元）

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
库存现金	142,957.03	151,263.64	106,567.81
银行存款	21,068,228.33	46,544,578.49	33,278,479.48
其他货币资金	5,000,000.00	2,900,000.00	2,201,284.00
合计	26,211,185.36	49,595,842.13	35,586,331.29

其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金。

报告期内，除其他货币资金中的保证金外，无其他因抵押、质押或冻结等情况受到使用限制以及有潜在回收风险的款项。

货币资金 2013 年 6 月末余额较 2012 年末减少 2,338.47 万元，主要是购买银行理财产品 2,200 万元所致；2012 年末余额较 2011 年末增加 1,400.95 万元，主要是经营活动现金净流入增加所致。

（二）应收账款

公司报告期的应收账款情况如下：

（单位：元）

账龄	2013年6月30日			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内（含1年）	27,764,498.31	99.06	1,388,224.92	26,376,273.39
1-2年（含2年）	262,480.14	0.94	52,496.03	209,984.11
合计	28,026,978.45	100.00	1,440,720.95	26,586,257.50
账龄	2012年12月31日			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内（含1年）	26,462,694.15	100.00	1,323,134.70	25,139,559.45
合计	26,462,694.15	100.00	1,323,134.70	25,139,559.45
账龄	2011年12月31日			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内（含1年）	22,466,298.62	100.00	1,123,314.91	21,342,983.71
合计	22,466,298.62	100.00	1,123,314.91	21,342,983.71

无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，报告期内又全额收回或转回情况。

报告期内无核销应收账款情况。

期末应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

公司应收账款余额账龄基本都在一年以内。公司的应收账款信用政策主要分为两类：

1、经销商

公司约95%的产品通过经销商销往终端客户，这是由于经销商回笼款项较为及时，且对终端客户的粘连度较高。公司从行业及区域方面选择经销商，每家经销商都需经过一系列的信用审批流程，最终由董事长签字确定其信用期限及额度。公司给予大部分经销商30天的账期（即每月核对当月发货金额并开票，该金额将在开票后30天内予以全额支付），该类经销商的销售额占比约70%；对于长期合作且信用较好的经销商，公司给予其月结60天的账期，该类经销商的销售额占比约10%；对于其它经销商，公司采取款到发货、货到收款或7天信用期等信用政策。

公司销售给经销商都采取买断的方式，无论经销商是否卖出、是否获利，都与本公司无关。公司在符合销售商品确认条件时，确认相关销售商品的收入。

2、直接客户

公司约 5% 的产品直接销往终端客户，这些客户都是规模较大，信誉较好的企业，公司给予该类客户月结 60 天的账期。

此外，公司销售部有专人负责催收款项，在信用超期或额度超限后，及时催收款项，必要时采取限制发货的手段。公司信用政策区分较为细致，应收账款余额保持稳定，且账龄都较短，报告期内也未发生过坏账。

截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	无锡市金人贸易有限公司	非关联方	3,816,453.04	13.62	2 年以内	销售款
2	深圳市汤诚科技有限公司	非关联方	2,408,379.98	8.59	1 年以内	销售款
3	香港达亚有限公司(DAYA LIMITED)	非关联方	2,105,923.39	7.51	1 年以内	销售款
4	深圳市泰捷通信技术有限公司	非关联方	1,909,510.41	6.81	1 年以内	销售款
5	深圳市海霞鑫电子有限公司	非关联方	1,635,087.28	5.84	1 年以内	销售款
	合计		11,875,354.10	42.37		

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	深圳市汤诚科技有限公司	非关联方	3,855,060.78	14.57	1 年以内	销售款
2	无锡市金人贸易有限公司	非关联方	3,416,299.92	12.91	1 年以内	销售款
3	深圳市盛友电子有限公司	非关联方	2,247,650.41	8.49	1 年以内	销售款
4	东莞市中铭电子贸易有限公司	非关联方	2,241,056.58	8.47	1 年以内	销售款
5	深圳市雅创威电子有限公司	非关联方	1,845,029.00	6.97	1 年以内	销售款
	合计		13,605,096.69	51.41		

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	无锡市金人贸易有限公司	非关联方	7,731,959.59	34.42	1 年以内	销售款
2	四川长虹电器股份有限公司	非关联方	2,559,519.29	11.39	1 年以内	销售款
3	三星电子(香港)有限公司	非关联方	2,097,292.37	9.34	1 年以内	销售款
4	深圳市海霞鑫电子有限公司	非关联方	1,877,970.00	8.36	1 年以内	销售款
5	西安芯派电子科技有限公司	非关联方	1,064,791.42	4.73	1 年以内	销售款
	合计		15,331,532.67	68.24		

(三) 预付款项

公司报告期的预付款项情况如下：

(单位：元)

账龄	2013 年 6 月 30 日	比例%	2012 年 12 月 31 日	比例%	2011 年 12 月 31 日	比例%
1 年以内(含 1 年)	3,262,703.72	100	97,457.00	94.84	276,794.68	100
1-2 年(含 2 年)	--	--	5,300.00	5.16	--	--
合计	3,262,703.72	100	102,757.00	100	276,794.68	100

截至 2013 年 6 月 30 日，公司预付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	无锡华润上华科技有限公司	非关联方	2,910,503.72	89.21	1 年以内	预付货款
2	无锡市金人贸易有限公司	非关联方	325,000.00	9.96	1 年以内	预付设备款
3	吴彬	非关联方	23,000.00	0.70	1 年以内	预付房租
4	苏州展文电子科技有限公司	非关联方	4,200.00	0.13	1 年以内	预付设备款
	合计		3,262,703.72	100.00		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司预付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	Dongbu Hitek	非关联方	87,997.00	85.64	1 年以内	预付研发材料款
2	天长市明辉实验设备有限公司	非关联方	5,300.00	5.16	1~2 年	预付设备款
3	苏州展文电子科技有限公司	非关联方	4,200.00	4.09	1 年以内	预付设备款
4	南京经纬专利商标代理有限公司	非关联方	4,060.00	3.95	1 年以内	预付专利费用
5	苏州青年旅行社股份有限公司竹辉路营业部	非关联方	1,200.00	1.16	1 年以内	预付代办签证费
	合计		102,757.00	100.00		

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	天水华天科技股份有限公司	非关联方	129,655.80	46.84	1 年以内	预付货款
2	上海华虹 NEC 电子有限公司	非关联方	101,960.00	36.84	1 年以内	预付货款
3	无锡华润上华半导体有限公司	非关联方	39,878.88	14.41	1 年以内	预付货款
4	天长市明辉实验设备有限公司	非关联方	5,300.00	1.91	1 年以内	预付设备款
	合计		276,794.68	100.00		

期末预付款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款

预付款项 2013 年 6 月末余额较 2012 年末增加 315.99 万元，主要是为确保市场供应预付给加工单位的加工费。

(四) 其他应收款

公司最近两年一期的其他应收款账龄情况及坏账准备计提情况如下表：

(单位: 元)

账龄	2013年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	112,728.56	54.24	5,636.43	107,092.13
1-2年(含2年)	5,000.00	2.40	1,000.00	4,000.00
2-3年(含3年)	84,070.45	40.45	42,035.23	42,035.22
3年以上	6,047.00	2.91	6,047.00	-
合计	207,846.01	100.00	54,718.66	153,127.35
账龄	2012年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	121,025.63	55.10	6,051.28	114,974.35
1-2年(含2年)	24,377.00	11.10	4,875.40	19,501.60
2-3年(含3年)	74,070.45	33.72	37,035.23	37,035.22
3年以上	170.00	0.08	170.00	-
合计	219,643.08	100.00	48,131.91	171,511.17
账龄	2011年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	102,946.05	57.83	5,147.30	97,798.75
1-2年(含2年)	74,903.85	42.07	14,980.76	59,923.09
2-3年(含3年)	50.00	0.03	25.00	25.00
3年以上	120.00	0.07	120.00	-
合计	178,019.90	100.00	20,273.06	157,746.84

截至2013年6月30日,公司其他应收款中的前五名客户名单如下:

(单位: 元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款总额比例(%)	账龄	性质
1	无锡国家集成电路设计基地有限公司	非关联方	74,070.45	35.64	2-3年	房租押金
2	易扬波	持有公司股份5%以上的其他股东/董事/副总经理	10,000.00	4.81	2-3年	备用金
3	吴国林	公司员工	10,000.00	4.81	1年以内	备用金
4	芮华政	公司员工	10,000.00	4.81	1年以内	备用金
5	张承诚	公司员工	10,000.00	4.81	1年以内	备用金
	合计		114,070.45	54.88		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占其他应 收款总额 比例 (%)	账龄	性质
1	无锡国家集成电路设计基地有限公司	非关联方	74,070.45	33.72	2-3 年	房租押金
2	戴尔(中国)有限公司	非关联方	21,942.00	9.99	1 年以内	已付服务器款, 发票未到
3	顺丰速运集团(上海)速运有限公司	非关联方	15,055.20	6.85	1 年以内	已付进口增值税, 发票未到
4	易扬波	持有公司股份 5% 以上的其他股东/ 董事/副总经理	10,000.00	4.55	1-2 年	备用金
5	张承诚	公司员工	10,000.00	4.56	1 年以内	备用金
	合计		131,067.65	59.67		

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占其他应 收款总额 比例 (%)	账龄	性质
1	无锡国家集成电路设计基地有限公司	非关联方	74,070.45	41.61	1-2 年	房租押金
2	江苏省无锡地方税务局第三税务分局	非关联方	56,977.45	32.00	1 年以内	预缴股利个税
3	易扬波	持有公司股份 5% 以上的其他股东/ 董事/副总经理	10,000.00	5.62	1 年以内	备用金
4	张承诚	公司员工	10,000.00	5.62	1 年以内	备用金
5	中国国际贸易促进委员会江苏省分会	非关联方	5,877.00	3.30	1 年以内	ATA 单证册担保金
	合计		156,924.90	88.15		

无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，报告期内又全额收回或转回情况。报告期无通过重组等其他方式收回应收款项情况。

报告期内无核销其他应收款情况。

期末其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方欠款：

(单位：元)

股东	2013年6月30日		2012年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
易扬波	10,000.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00
陈健	5,000.00	250.00	-	-
合计	15,000.00	5,250.00	10,000.00	2,000.00

公司其他应收款科目主要归集公司员工出差或办理公司事务时所需的备用金、代扣职工的公积金，养老保险以及公司对外的一些押金。

截至2013年6月30日，其他应收款余额中账龄在3年以上余额为6,047.00元，其中170.00元为净水桶押金，5,877.00元为ATA单证册担保金；2-3年的余额84,070.45元中74,070.45元为芯朋股份房租押金，其余为备用金；1-2年的余额5,000.00元为备用金；1年以内的余额112,728.56元主要是代为支付的职工公积金、养老保险金及备用金。

公司对于备用金采取限额管理，且只有部分经董事长批准的员工有权限借支款项，由于公司备用金余额较小，公司该内部控制能够规避风险。

(五) 存货

公司报告期的存货情况如下：

(单位：元)

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存材料	6,656,213.31	--	8,185,615.52	--	8,957,122.84	--
在产品	5,654,182.46	--	2,768,766.72	--	7,357,522.81	--
半成品	875,979.55	--	2,665,405.63	--	311,594.76	--
产成品	16,326,172.17	1,517,104.53	9,870,645.55	1,180,153.70	7,890,996.15	312,722.44
合计	29,512,547.49	1,517,104.53	23,490,433.42	1,180,153.70	24,517,236.56	312,722.44

存货取得时按照实际发生成本入账，发出计价采用的是加权平均法；低值易耗品领用后采用一次摊销法进入当期损益。

公司的主营业务是研发、设计、生产、销售电子元器件及集成电路等。除了承担少量的产品成测外，其他生产过程都通过委外加工实现。公司主要致力于电子元

器件及集成电路等的设计、开发，并将其转化为产品实现其价值。公司的库存材料为加工后的圆片；在产品为委外封装、测试过程中尚未完成入库的产品；半成品为完工入库但仍需公司进行成品测试的产品；库存商品即为公司生产出的各类产品。

公司报告期内存货余额绝对金额虽然较大，但占公司资产总额的比重仅为 25%。公司作为研发、设计、生产、销售电子元器件及集成电路的企业，须根据市场需求提前备货，圆片价值及其对应的产品价值较高，随着报告期内公司营业收入的稳步增长及市场开发力度的不断拓展，公司的存货量有所增加。报告期内，公司存货保持稳定。

报告期内公司主营业务保持良性发展，存货的管理及对委外加工环节的控制都较好，加之公司产品销售情况良好，公司整体存货周转率平稳且较快。2011 年、2012 年和 2013 年 1~6 月公司的存货周转率分别为 3.68 次/年、3.65 次/年和 1.87 次/年。截至 2013 年 6 月 30 日，公司存货跌价准备为因四川长虹电器股份有限公司赔偿事件（相关情况详见本说明书第四章之“二、公司报告期利润形成的有关情况——（五）非经常性损益情况”）导致的当批滞销存货金额 1,180,153.70 元及公司根据盘点结果对滞销积压的产品全额计提的跌价准备 336,950.83 元。

（六）其他流动资产

（单位：元）

	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行理财产品[注]	22,000,000.00	-	-
租金	81,114.00	80,464.00	9,464.00
预交企业所得税	63,695.21	-	-
合计	22,144,809.21	80,464.00	-

注：银行理财产品

（单位：元）

产品名称	金额	产品存续期
工银理财共赢 3 号 2013 第 20 期 B 款[注 1]	10,000,000.00	2013 年 5 月 21 日至 2013 年 7 月 1 日
工银理财共赢 3 号 2013 第 22 期 B 款[注 2]	12,000,000.00	2013 年 6 月 4 日至 2013 年 7 月 15 日

注1：2013年7月3日收到本息合计10,041,561.64元。

注2：2013年7月17日收到本息合计12,052,569.86元。

（七）长期股权投资

(单位：万元)

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海翔芯集成电路有限公司	成本法	260.00	-	260.00	260.00	8.67	8.67

上海翔芯集成电路有限公司成立于2012年3月21日，原注册资本为人民币2,000万元。2013年5月，上海翔芯集成电路有限公司一致同意增加注册资本1000万并吸收本公司为其新股东。同年6月，本公司认缴出资额260万元，占上海翔芯集成电路有限公司注册资本比例的8.67%。

（八）固定资产

1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.5
电子设备	3	5.00	31.67
运输设备	4	5.00	23.75
融资租入固定资产	10	5.00	19.00

公司固定资产折旧均采用年限平均法。

2、固定资产原值、累计折旧和净值

(单位：元)

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
一、原价合计	7,507,919.10	7,208,100.71	5,413,418.14
电子设备	5,905,851.72	5,606,033.33	4,062,716.14
运输设备	1,562,467.38	1,562,467.38	1,311,102.00
其他设备	39,600.00	39,600.00	39,600.00
二、累计折旧合计	5,063,482.66	4,282,671.06	2,852,976.45
电子设备	3,768,935.72	3,051,003.73	1,869,766.24
运输设备	1,258,180.94	1,199,063.33	958,130.21
其他设备	36,366.00	32,604.00	25,080.00
三、减值准备合计	--	--	--
电子设备	--	--	--
运输设备	--	--	--
其他设备	--	--	--

四、固定资产账面价值合计	2,444,436.44	2,925,429.65	2,560,441.69
电子设备	2,136,916.00	2,555,029.60	2,192,949.90
运输设备	304,286.44	363,404.05	352,971.79
其他设备	3,234.00	6,996.00	14,520.00

公司的主营业务是研发、设计、生产和销售电子元器件及集成电路等。除了承担少量的产品成测外，其他生产过程都通过委外加工实现，因此公司的固定资产较少。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 7,507,919.10 元，累计折旧为 5,063,482.66 元，固定资产净值为 2,444,436.44 元，累计折旧占原值比例为 67.44%。公司主要的固定资产为电子设备、运输设备。电子设备中主要为用于办公的电脑及用于测试的设备，其中电脑大部分已提足折旧，但仍可用于办公，而用于测试的设备，大都为 2010 年及之后购买，公司每年都会按照实际情况进行调整；运输设备为公司拥有的车辆，目前正常运行。公司固定资产不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

（九）无形资产

公司入账的无形资产为用友软件，公司于 2011 年以 49,700.00 元购买。公司无形资产摊销均采用直线法，年限为 2 年，截至 2013 年 6 月 30 日，该项无形资产已摊销完毕。

2011 年度无形资产及累计摊销情况：

（单位：元）

项 目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
原值：				
软件	--	49,700.00	--	49,700.00
累计摊销：				
软件	--	18,637.47	--	18,637.47
无形资产减值准备：				
软件	--	--	--	--
无形资产账面价值：				
软件	--			31,062.53

2012 年度无形资产及累计摊销情况:

(单位: 元)

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
原值:				
软件	49,700.00	--	--	49,700.00
累计摊销:				
软件	18,637.47	24,849.96	--	43,487.43
无形资产减值准备:				
软件	--	--	--	--
无形资产账面价值:				
软件	31,062.53			6,212.57

2013 年 1-6 月无形资产及累计摊销情况:

(单位: 元)

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 6 月 30 日
原值:				
软件	49,700.00	--	--	49,700.00
累计摊销:				
软件	43,487.43	6,212.57	--	49,700.00
无形资产减值准备:				
软件	--	--	--	--
无形资产账面价值:				
软件	6,212.57			--

(十) 长期待摊费用

报告期内, 公司办公楼装修费 263,908.61 元, 按 3 年摊销, 截至 2012 年末已摊销完毕。

2011 年度长期待摊费用情况:

(单位: 元)

项目	原始发生额	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2011 年 12 月 31 日	剩余摊销期限(月)
装修费	263,908.61	142,199.38	--	87,969.48	209,678.71	54,229.90	7
合计	263,908.61	142,199.38	--	87,969.48	209,678.71	54,229.90	

2012 年度长期待摊费用情况：

(单位：元)

项目	原始发生额	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2012 年 12 月 31 日	剩余摊销期限 (月)
装修费	263,908.61	54,229.90	--	54,229.90	263,908.61	--	--
合计	263,908.61	54,229.90	--	54,229.90	263,908.61	--	

(十一) 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

(单位：元)

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	220,555.85	201,609.87	164,976.34
其他应收款坏账准备	7,808.71	6,992.86	2,986.24
存货跌价准备	192,985.38	147,519.21	46,908.37
合并抵销未实现利润	17,424.62	43,255.92	36,475.11
递延收益	1,105,668.84	1,215,591.96	1,460,118.89
可弥补亏损	28,767.75	101,301.42	--
预计负债	181,433.34	181,433.34	--
合计	1,754,644.49	1,897,704.58	1,711,464.95

(2) 可抵扣暂时性差异

(单位：元)

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	1,440,720.95	1,323,134.70	1,123,314.91
其他应收款坏账准备	54,718.66	48,131.91	20,273.06
存货跌价准备	1,517,104.53	1,180,153.70	312,722.44
合并抵销未实现利润	116,164.15	288,372.81	291,800.88
递延收益	8,571,854.74	9,430,285.31	11,331,224.20
可弥补亏损	115,070.98	405,205.67	--
预计负债	1,451,466.72	1,451,466.72	--
合计	13,267,100.73	14,126,750.82	13,079,335.49

（十二）主要资产减值准备

公司报告期的资产减值准备情况如下：

（单位：元）

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
应收账款坏账准备	1,440,720.95	1,323,134.70	1,123,314.91
其他应收款坏账准备	54,718.66	48,131.91	20,273.06
存货跌价准备	1,517,104.53	1,180,153.70	312,722.44
合计	3,012,544.14	2,551,420.31	1,456,310.41

五、公司报告期重大债务情况

（一）短期借款

公司报告期的短期借款余额情况如下：

（单位：元）

科目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
短期借款	--	--	--

公司报告期的短期借款发生额情况如下：

（单位：元）

性质	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
还款	--	--	10,000,000.00

2010 年，公司需支付收购苏州博创对价款 31,748,625 元，为了不影响日常生产经营，公司向中国工商银行股份有限公司无锡城中支行申请了短期借款，借款金额共计 1,000 万元，同时，专业担保公司无锡市新区创友融资担保有限公司为公司的借款提供了担保及质押。由于公司自有资金充裕，该贷款于 2011 年偿还。

（二）应付票据

（单位：元）

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	5,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00

期末应付票据为 100% 保证金开具。

(三) 应付账款

公司报告期的应付账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	16,604,794.21	99.03	10,478,457.45	94.33	8,169,743.04	97.76
1-2年(含2年)	6,370.00	0.04	442,409.67	3.98	187,123.02	2.24
2-3年(含3年)	155,635.69	0.93	187,123.02	1.69	--	--
3年以上	--	--	--	--	--	--
合计	16,766,799.90	100.00	11,107,990.14	100.00	8,356,866.06	100.00

截至2013年6月30日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例(%)	账龄	性质
1	无锡华润上华半导体有限公司	非关联方	6,818,463.58	40.67	1年以内	采购应付款
2	江苏长电科技股份有限公司	非关联方	3,156,757.28	18.83	1年以内	采购应付款
3	无锡华润安盛科技有限公司	非关联方	2,524,696.83	15.06	1年以内	采购应付款
4	天水华天科技股份有限公司	非关联方	2,241,148.89	13.37	1年以内	采购应付款
5	无锡红光微电子有限公司	非关联方	239,613.21	1.42	1年以内	采购应付款
	合计		14,980,679.79	89.35		

截至2012年12月31日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例(%)	账龄	性质
1	无锡华润上华半导体有限公司	非关联方	4,379,064.00	39.42	1年以内	采购应付款
2	无锡华润安盛科技有限公司	非关联方	1,448,855.91	13.04	1年以内	采购应付款
3	江苏长电科技股份有限公司	非关联方	1,028,119.27	9.26	1年以内	采购应付款
4	无锡华润上华科技有限公司	非关联方	834,629.00	7.51	1年以内	采购应付款
5	天水华天科技股份有限公司	非关联方	620,375.70	5.59	1年以内	采购应付款
	合计		8,311,043.88	74.82		

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应付账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	无锡华润上华半导体有限公司	非关联方	2,477,549.00	29.65	1 年以内	采购应付款
2	无锡华润上华科技有限公司	非关联方	1,165,370.00	13.95	1 年以内	采购应付款
3	江苏长电科技股份有限公司	非关联方	979,918.93	11.72	1 年以内	采购应付款
4	无锡华润安盛科技有限公司	非关联方	978,374.44	11.71	1 年以内	采购应付款
5	深圳中星华电子有限公司	非关联方	467,527.00	5.59	1 年以内	采购应付款
	合计		6,068,739.37	72.62		

期末余额均是正常采购所产生的应付款项，无大额、异常应付账款情况。

截至 2013 年 6 月 30 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(四) 预收账款

公司报告期的预收账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含 1 年)	349,395.15	100.00	183,855.15	100.00	33,210.00	100.00
合计	349,395.15	100.00	183,855.15	100.00	33,210.00	100.00

截至 2013 年 6 月 30 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	深圳市金宇威电子有限公司	非关联方	78,130.00	22.36	1 年以内	预收货款
2	常州中智微元电子科技有限公司	非关联方	72,500.00	20.75	1 年以内	预收货款
3	利尔达科技有限公司	非关联方	50,000.00	14.31	1 年以内	预收货款
4	无锡市科纳电子有限公司	非关联方	34,000.00	9.73	1 年以内	预收货款
5	广东乐心医疗电子股份有限公司	非关联方	28,125.20	8.05	1 年以内	预收货款
	合计		262,755.20	75.20		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	四川维肯电子有限公司	非关联方	68,600.00	37.31	1 年以内	预收货款
2	东莞市统润电子有限公司	非关联方	42,875.00	23.32	1 年以内	预收货款
3	中山市创源电子有限公司	非关联方	28,775.20	15.65	1 年以内	预收货款
4	上海哲平电子科技有限公司	非关联方	26,030.00	14.16	1 年以内	预收货款
5	上海慧梓电子科技有限公司	非关联方	8,000.00	4.35	1 年以内	预收货款
	合计		174,280.20	94.79		

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预收账款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	客户名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款总额比例 (%)	账龄	性质
1	深圳市艾森风驰科技有限公司	非关联方	9,450.00	28.46	1 年以内	预收货款
2	深圳市中广芯源科技有限公司	非关联方	5,250.00	15.81	1 年以内	预收货款
3	深圳市高碛普科技有限公司	非关联方	4,100.00	12.35	1 年以内	预收货款
4	上海哲平电子科技有限公司	非关联方	3,500.00	10.54	1 年以内	预收货款
5	上海百力微电子有限公司	非关联方	3,310.00	9.96	1 年以内	预收货款
	合计		25,610.00	77.12		

期末余额均是向采购方收取的预收货款产生的余额，无大额、异常预收账款情况。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(五) 应付职工薪酬

2012 年度应付职工薪酬变动情况

(单位：元)

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
工资奖金津贴及补贴	2,451,935.03	14,195,226.33	14,119,862.36	2,527,299.00
职工福利费	--	631,786.41	631,786.41	--
社会保险费	--	2,895,851.15	2,895,851.15	--
住房公积金	--	986,552.56	986,552.56	--
教育及工会经费	--	32,334.00	32,334.00	--
因解除劳动关系给予的补偿	--	347,124.00	347,124.00	--
合计	2,451,935.03	19,088,874.45	19,013,510.48	2,527,299.00

2013 年 1-6 月应付职工薪酬变动情况

(单位：元)

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
工资奖金津贴及补贴	2,527,299.00	7,343,037.00	8,870,336.00	1,000,000.00
职工福利费	-	368,544.48	368,544.48	-
社会保险费	-	1,370,056.54	1,370,056.54	-
住房公积金	-	379,640.64	379,640.64	-
教育及工会经费	-	24,304.00	24,304.00	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	7,800.00	7,800.00	-
合计	2,527,299.00	9,493,382.66	11,020,681.66	1,000,000.00

(六) 应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

(单位：元)

税项	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	-65,383.26	256,501.12	370,114.09
企业所得税	1,020,227.25	1,205,067.28	1,361,975.75
城市维护建设税	18,196.15	52,130.85	39,331.86
教育费附加	12,997.25	37,236.33	28,094.19
个人所得税	842,504.65	29,726.65	32,761.05
地方综合基金	39,213.87	36,815.58	30,845.16
印花税	3,073.30	4,050.80	2,778.30
合计	1,870,829.21	1,621,528.61	1,865,900.40

(七) 其他应付款

公司报告期的其他应付款情况如下：

(单位：元)

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	235,463.91	100.00	60,471.03	100.00	769,785.25	100.00
合计	235,463.91	100.00	60,471.03	100.00	769,785.25	100.00

截至2013年6月30日，公司其他应付款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额比例(%)	账龄	性质
1	江苏公证天业会计师事务所有限公司	非关联方	100,000.00	31.57	1年以内	审计费
2	查明等员工	公司员工	74,319.53	22.32	1年以内	未结算费用报销款
3	无锡市社会保险基金管理中心	非关联方	52,560.42	42.47	1年以内	社保暂扣款
4	江苏省无锡地方税务局第三税务分局	非关联方	8,152.06	3.46	1年以内	待扣个人所得税
5	苏州荣盈科技有限公司	非关联方	431.90	0.18	1年以内	办公费
	合计		235,463.91	100.00		

截至2012年12月31日，公司其他应付款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额比例(%)	账龄	性质
1	无锡市社会保险基金管理中心	非关联方	52,318.97	86.52	1年以内	社保暂扣款
2	江苏省无锡地方税务局第三税务分局	非关联方	8,152.06	13.48	1年以内	待扣个人所得税
	合计		60,471.03	100.00		

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应付款中的前五名名单如下：

(单位：元)

序号	性质	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额比例(%)	账龄	性质
1	苏州工业园区教育发展投资有限公司	非关联方	692,558.96	89.97	1 年以内	应付房租款
2	无锡市社会保险基金管理中心	非关联方	42,310.23	5.50	1 年以内	社保暂扣款
3	李海松	公司员工	13,764.00	1.79	1 年以内	应付员工报销款
4	中国石油化工股份有限公司江苏苏州石油分公司	非关联方	13,000.00	1.69	1 年以内	应付油费
5	江苏省无锡地方税务局第三税务分局	非关联方	8,152.06	1.05	1 年以内	待扣个人所得税
	合计		769,785.25	100.00		

截至 2013 年 6 月 30 日，其他应付款中无应付其他关联方款项。

(八) 其他流动负债

(单位：元)

科目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其他流动负债	44,740.88	--	42,322.72

公司的其他流动负债余额为电费。

(九) 预计负债

(单位：元)

科目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
预计负债	1,451,466.72	1,451,466.72	--

公司子公司苏州博创因长虹电器股份有限公司赔偿事件（相关情况详见本说明书第四章之“二、公司报告期利润形成的有关情况——（五）非经常性损益情况”），于 2012 年 5 月 21 日与四川长虹电器股份有限公司、四川虹欧显示器件有限公司签订了《关于苏州博创扫描集成电路模组返工赔偿协议》，协议约定由于苏州博创销售给长虹电器的扫描集成电路质量问题，苏州博创赔偿四川虹欧显示器件有限公司

PDP 模组返工的所有生产费用，合计人民币 1,451,466.72 元，该部分费用赔偿由苏州博创在后期供货 160 万只扫描集成电路范围内完成。截止 2013 年 6 月 30 日，该部分扫描集成电路尚未供货。

（十）其他非流动负债

公司报告期的其他非流动负债情况如下：

（单位：元）

政府补助	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
芯朋股份	1,367,480.07	15.95	1,472,251.69	15.61	1,748,634.88	15.43
苏州博创	7,204,374.67	84.05	7,958,033.62	84.39	9,582,589.32	84.57
合计	8,571,854.74	100.00	9,430,285.31	100.00	11,331,224.20	100.00

公司有一批稳定的研发团队，每年能从政府申请到一定的研发资金，公司取得的政府项目资金均用于公司以后期间的相关费用或损失，因此在尚未使用上述资金时，暂归结于此。报告期内具体项目资金留存情况如下：

（单位：元）

项目	批准文件	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
CMOS 单片高耐压高效率开关稳压器	苏财建[2009]332 号	4,803.19	26,364.18	111,460.74
超低待机功耗交直流转换器研发及产业化	锡财工贸[2010]135 号	40,824.60	76,235.94	1,137,174.14
自适应宽电压(60V)高效率智能化电源芯片	锡科计[2011]143 号	452,795.59	483,823.08	500,000.00
	锡财工贸[2011]78 号			
适用于 SoC 动态电压调节的多路输出电源转换器研发	锡科计[2012]153 号	800,000.00	800,000.00	--
	锡财工贸[2012]120 号			
无锡市功率集成电路工程技术研究中心	锡科计[2011]227 号	69,056.69	85,828.49	--
	锡财工贸[2011]152 号			
0.13 微米 SOI 通用 CMOS 与高压工艺开发与产业化	ZX02[2010]007 号	87,044.29	118,778.61	2,606,644.23

700V 单片集成 AC-DC 绿色电源芯片研发及产业化	江苏省科技成果转化专项资金项目	134,073.74	247,936.21	1,126,512.34
PDP 用列驱动芯片电路开发及产业化	工信部财[2008]355 号	63,413.89	147,093.45	147,093.45
自主知识产权的 PDP 显示控制和驱动芯片开发与产业化	工信专项一简 [2010]65 号	567,369.83	844,225.35	5,702,339.30
国产高清 PDP 的专用行扫描和列寻址驱动芯片产业化项目拨款	发改投资[2012]516 号	5,000,000.00	5,000,000.00	--
	苏发改投资发 [2012]539 号			
	苏发改高技[2012]33 号			
超结 VDMOS 三维结构下的可靠性研究项目拨款	苏财教[2012]126 号	216,030.53	300,000.00	--
	苏科计[2012]220 号			
	苏财教字[2012]90 号			
待机节能电源转换芯片的研发及产业化项目拨款	苏科计[2012]174 号	161,383.28	300,000.00	--
	苏财教字[2012]74 号			
基于高低压混合特色工艺模块的功率集成电路研发与产业化项目拨款	苏财工贸[2012]119 号	975,059.11	1,000,000.00	--
	苏经信综合[2012]769 号			
	苏财企字[2012]62 号			
合计		8,571,854.74	9,430,285.31	11,331,224.20

六、公司报告期股东权益情况

(单位：元)

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收资本 (或股本)	20,500,000.00	20,500,000.00	20,000,000.00
资本公积	20,115,526.55	20,115,526.55	18,615,526.55
盈余公积	2,306,845.16	2,306,845.16	14,599.14
未分配利润	34,939,684.81	27,924,492.60	16,453,664.36
归属于母公司股东权益合计	77,862,056.52	70,846,864.31	55,083,790.05
少数股东权益	--	--	--
股东权益合计	77,862,056.52	70,846,864.31	55,083,790.05

2011 年 11 月 8 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司《审计报告》（苏公

W[2011]A668号),截至2011年9月30日,公司经审计的资产为74,988,668.10元,负债为36,373,141.55元,净资产为38,615,526.55元。

2011年11月18日,江苏中天资产评估事务所有限公司出具《评估报告》(苏中资评报字[2011]第1066号),截至2011年9月30日,公司经评估的资产为9,552.26万元,负债为3,637.31万元,净资产为5,914.94.11万元。

2011年11月22日,公司召开股东会作出决议:同意以经审计的净资产折合股份公司股本2,000万股,每股面值1元,余额18,615,526.55元计入资本公积,整体变更设立股份公司。

2011年11月25日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏公W[2011]B116号)对股份公司出资情况进行验证,公司注册资本2,000万元已经全部到位。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方

关联方:指公司控股股东;持有公司股份5%以上的其他股东;控股股东及其股东控制或参股的企业;对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人;公司参与的合营企业、联营企业;公司的参股企业;主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业;其他对公司有实质影响的法人或自然人。

关联关系是指在财务和经营决策中,有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径,主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

1、存在控制关系的关联方

公司的实际控制人是张立新先生,张立新先生直接持股比例为61.10%。

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
张立新		实际控制人
苏州博创集成电路设计有限公司	67301496-8	公司全资控股的企业
深圳芯朋电子有限公司	59188636-7	公司全资控股的企业

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
上海翔芯集成电路有限公司	59169003-0	公司参股的企业
长沙环旅文化传播有限公司	78536988-6	持有公司股份 5% 以上股东控制的企业
无锡市泰思特测试有限责任公司	71689199-6	实际控制人参股的企业
李志宏		持有公司股份 5% 以上的其他股东/董事/ 副总经理
易扬波		持有公司股份 5% 以上的其他股东/董事/ 副总经理
周飙		持有公司股份 5% 以上的其他股东/董事/ 副总经理
薛伟明		董事/副总经理
陈健		副总经理/董秘
张韬		监事会主席
陶平		监事
陶晓华		监事

3、受实际控制人控制的其他企业

无。

(二) 关联方交易及关联方余额

1、关联方交易

关联方名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额（元）	占年度同类交易比例%	金额（元）	占年度同类交易比例%	金额（元）	占年度同类交易比例%
无锡市泰思特测试有限责任公司	136,978.46	0.23	13,538.46	0.01	7,008.55	0.01

公司控股股东张立新先生持有无锡市泰思特测试有限责任公司 6.40% 的股份，泰思特主营业务是为集成电路产品提供测试服务，公司有少量产品可通过泰思特进行测试，价格均按单位测试时间和设备类型确定，公司和泰思特的关联方定价比照同类测试公司市场价格。

2、关联方余额

关联方名称	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	百分比%	金额(元)	百分比%	金额(元)	百分比%
其他应收款:						
易扬波	10,000.00	4.81	10,000.00	4.55	10,000.00	5.62
陈健	5,000.00	2.41	--	--	--	--
应付账款:						
无锡市泰思特测试有限责任公司	71,884.80	0.43	--	--	--	--

公司其他应收款关联方余额都为备用金，应付账款泰思特余额为应付的测试费。

(三) 关联交易决策程序执行情况

公司在整体变更前，没有专门制订关联交易决策制度。公司在整体变更过程中，在公司章程中对关联交易的审批权限作了规定，制订并通过了《关联交易管理制度》。公司已按照制度规定的要求履行相应的审批程序。

八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

(二) 或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

(三) 其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、公司报告期内资产评估情况

公司自成立之日起进行了两次资产评估，详细情况如下：

1、芯朋有限收购苏州博创，芯朋有限委托评估机构对此经济行为所涉及的苏州博创的股东权益进行评估，以对苏州博创的股东权益在 2010 年 6 月 30 日这一评估基准日所表现的市场价值作出评定估算，为该经济行为提供价值参考依据。

2、芯朋有限拟进行整体变更为股份有限公司，由有限责任公司改制成股份有限公司，芯朋有限委托评估机构对此经济行为所涉及的芯朋有限的股东权益进行评估，以对芯朋有限的股东权益在 2011 年 9 月 30 日这一评估基准日所表现的市场价值作出评定估算，为该经济行为提供价值参考依据。

评估相关情况详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、股权结构及股本形成情况”之“（五）股本形成及变化情况”。

十、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及本公司章程的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

由于公司规模尚小，报告期内尚未制定相关的股利分配政策。公司已于 2013 年第 1 次临时股东大会通过修改章程议案，加入相关股利分配政策，相关规定如下：

公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。

公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的

资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司利润分配形式：公司分红可以采取现金或股票形式，可以进行中期分红，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。

公司利润分配政策调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。

（二）股票公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配政策不变。

（三）报告期内的分配情况

公司于 2013 年 6 月 13 日召开 2012 年年度股东大会，会议通过利润分配方案，向全体股东每 1 股派发 0.20 元现金红利（含税），共计分配利润 410 万元，并于 2013 年 6 月实施完成。

公司于 2012 年 7 月 18 日召开 2012 年第三次临时股东大会，会议通过利润分配方案，共分配利润 240 万元（含税），并于 2012 年 7 月实施完成。

公司于 2011 年 8 月 20 日召开股东会，会议通过利润分配方案，共分配利润 500 万元（含税），并于 2011 年 8 月实施完成。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司有两家全资子公司——苏州博创集成电路设计有限公司及深圳芯朋电子有限公司，公司已将其纳入合并报表。

子公司基本情况如下：

被投资单位名称	成立时间	注册地	主要经营业务	投资比例	注册资本（万元）
苏州博创集成电路设计有限公司	2008 年 3 月	苏州独墅湖高等教育区林泉街 399 号 1 号楼 3 层	集成电路的研发、销售	100%	3000.00

深圳芯朋电子有限公司	2012年3月	深圳市福田区深南路与广深高速公路交汇处东南侧大庆大厦 28C.28D	机电产品的设计、开发与销售	100%	100.00
------------	---------	------------------------------------	---------------	------	--------

报告期内，苏州博创集成电路设计有限公司的主要财务指标如下：

(单位：元)

	2013年1-6月	2012年度	2011年度
资产负债表项目			
资产总额	61,181,568.69	60,567,000.70	68,484,132.55
负债总额	17,711,996.41	18,652,894.10	19,980,423.33
所有者权益	43,469,572.28	41,914,106.60	48,503,709.22
损益项目			
营业收入	19,794,193.20	47,268,574.57	68,988,527.84
利润总额	1,779,301.21	9,587,004.69	8,507,577.26
净利润	1,555,465.68	8,587,883.80	7,437,823.48

苏州博创集成电路设计有限公司是 2008 年 3 月 14 日由徐之伟等自然人共同出资组建的有限责任公司。注册资本 3,000 万元人民币，并于 2008 年 3 月 14 日取得苏州工业园区工商行政管理局核发的注册号为 320594000113866 号企业法人营业执照。经常熟天瑞会计师事务所审验，并出具常天内验字[2008]第 133 号验资报告。

2010 年 8 月 9 日根据苏州博创股东会决定及股权转让协议，徐晓峰、徐晓平、赵建华、沈雪良、时惠军、陆春喜、徐之伦、钱军彪、张立新九人将其在本公司的股权（798 万元，占注册资本 26.6%）转让给徐之伟，转让后徐之伟持有本公司 77% 的股权。

2010 年 9 月 17 日根据苏州博创股东会决定及股权转让协议，徐之伟、易扬波将其持有的公司股权转让给芯朋有限，并于 2010 年 9 月 28 日办妥工商变更手续，转让后苏州博创成为芯朋有限的全资子公司。

截至 2013 年 6 月 30 日，苏州博创资产总额 6,118.17 万元，负债总额 1,771.40 万元，净资产 4,346.96 万元，2013 年 1~6 月营业收入 1,979.42 万元，净利润 155.55 万元。自芯朋有限 2011 年改制为股份公司后，对于子公司的定位更加清晰，苏州博创更侧重于研发，目前公司研发的产品主要都销往母公司。

报告期内，深圳芯朋电子有限公司的主要财务指标如下：

(单位：元)

	2013年1-6月	2012年度
资产负债表项目		
资产总额	1,949,788.41	1,837,667.30

负债总额	1,113,332.75	1,195,145.94
所有者权益	836,455.66	642,521.36
损益项目		
营业收入	4,767,181.68	2,978,249.50
利润总额	263,816.54	-469,739.69
净利润	193,934.30	-357,478.64

深圳芯朋电子有限公司成立于 2012 年 3 月 12 日，注册资本人民币 100 万元，系芯朋股份的全资子公司。该出资经深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）深中岳验字[2012]第 006 号验资报告验证确认，公司办妥工商登记手续。

截至 2013 年 6 月 30 日，深圳芯朋资产总额 194.98 万元，负债总额 111.33 万元，净资产 83.65 万元，2013 年 1~6 月营业收入 476.72 万元，净利润 19.39 万元。公司本期销售有较大的突破，随着公司对市场开发的不断深入，不断有新地区新客户产生，报告期内公司营业收入增长较大，势头良好。

十二、公司经营风险因素

（一）市场风险

集成电路行业是一个快速发展的高科技行业，各种新技术、新产品不断更新，一方面产生了巨大的市场机遇，另一方面也导致市场变化多端，难以完全把握，需要公司不断开发出适销对路的新产品以求跟上市场的需求。除此之外，目前市场上生产电源管理集成电路产品的公司也越来越多，同质化较为严重，竞争愈演愈烈。因此，只有把握住市场需求的不断变化，并在技术开发方面保持自己的先进性和独特优势，公司才能在激烈的市场竞争中赢得一席之地。

针对上述风险，公司采取如下措施：

（1）针对市场风险，公司一方面继续加大研发和技术创新力度，发展核心技术，提高器件的可靠性和工艺的稳定性，建立起新的技术高点；另一方面，公司积极进行市场开发，打造强有力的渠道营销网络，将公司的产品推广渗透到电子产品聚集区，以求扩大公司的市场份额，优化市场资源配置，做好行业龙头企业的服务，掌握行业发展方向，并建立自己的品牌。

（2）针对高度分散的完全竞争市场，以及国际巨头高出几个数量级的规模压力，公司采取的主要竞争策略是：首先，从细分市场上把握节奏，先进攻民用的大宗消费类电子市场，避开与国际巨头在高端产品市场的正面冲突；其次，利用本土优势，

贴近客户，加强售前、售中与售后的服务工作，优化工艺，为客户提供性价比更高的产品。

(3) 在报告期内，市场特征主要表现为稳步增长的小家电市场。公司产品已稳占细分市场第一份额，新产品需求主要是和行业龙头如美的、九阳一起合作开发。早期布局的平板电脑市场，根据主控 CPU 的需求，目前已为平板电脑各家方案提供了全套的电源管理芯片，如外挂充电器、主板 DC-DC 升降压电路、液晶屏背光、偏置电路等，这些占据了平板电脑近 40% 的市场份额。近期重点布局智能手机和 LED 照明。目前背光驱动已在智能手机市场占有一定份额，正在开发的 LED 闪光灯驱动电路也会很快面市。LED 照明驱动电路覆盖了从 1W 到 60W 的全系列产品，预计在今年下半年和明年可取得巨大的收获。

近年来公司产品价格仍保持稳中略有下降，由于公司在市场具有较高的知名度和品牌美誉度，公司的价格策略可依据双方协商，以期以每年不超过 10% 的成熟产品的价格下降幅度来应对市场竞争。

(4) 按电子行业分布的特点，华南市场占据了国内大部分的市场比重，为了加强对这个市场控制，公司在深圳设立了分公司。目前对于大的代理公司，由总公司直接管理，小型、分散的客户则由深圳公司直接管理，这样的安排除了可以为客户提供更好的服务，也降低了客户的维护成本。设计公司为客户提供的主要价值是集成电路产品，而产品的设计、制造由总公司负责，所以不存在总部对销售总部控制的风险。

目前，公司除了华南市场，在华东市场和海外市场的也有相当的比例，随着公司业务的不拓展，未来这部分比重还将继续增加。

(二) 技术更新风险

集成电路设计在国内尚属于成长中的新兴产业，新技术可能随着行业的发展环境和国际国内消费市场的变迁而发生变革，公司若不能及时跟上新技术变革的步伐，将对公司业务的持续开展和市场的进一步开拓产生不利影响。

针对上述风险，公司采取如下措施：

(1) 针对技术更新风险，公司一方面每年持续地投入一定金额的研发费用；另一方面，公司相关人员定期参加集成电路相关的研讨会和技术培训，市场营销部也

会收集最新的技术信息，从而促进公司自主研发。

(2) 公司在器件结构设计、模拟以及工艺开发上投入了大量的资源，建有院士领衔的江苏省功率集成电路研究中心，拥有国内一流的器件和工艺专家，根据产品的特点，该研究中心和圆片加工厂合作开发了多种合适的特色工艺，保证了产品的高可靠性和低失效率。同时，公司在该领域拥有多项国内、外专利，并承担了数项国家级科研项目，在项目推进的同时，紧跟政策导向和市场需求的变化，确保技术研发的不断升级换代。

(3) 公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系，在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，拥有并持续开发出大量独占性的技术专利和布图设计登记证书。2012 年公司取得“江苏省知识产权管理规范化示范单位”荣誉称号。作为轻资产的 IC 设计公司，强大的知识产权成为公司技术不断更新的持续保障和护城河。

(三) 核心人才流失风险

集成电路设计行业对设计人员的专业技术能力和各技术团队的密切合作依赖程度较高。一个合格的专业设计技术人员需要长时间的技术积累，而公司的研发团队、特别是核心技术人员是公司能够不断开发出获利产品的关键保障。因此，相对稳定的技术研发团队是公司一切比较优势的基础和来源，而核心人才的流失无疑将对公司的持续经营带来重大的风险。

针对上述风险，公司采取如下措施：

(1) 针对核心人才流失风险，公司与所有的核心及主要技术人员签订了保密协议，协议规定其离职两年内不能到与公司有竞争关系的单位就职。同时公司所有核心及主要技术人员持有公司股份。

(2) 其次，从人才储备上，公司成立了国家级企业博士后科研工作站和东南大学研究生联合培养基地，且同东南大学工程技术研究中心有紧密合作。公司本科以上比例占 80%左右。

(3) 此外，公司结合加工技术（特别是圆片加工技术）与工艺加工企业方、学校共三方一起研发工艺技术，以提高产品性能和降低生产成本。另外，深圳公司技术团队（FAE）贴近市场，产品定义和定位准确，善于在研发和工艺紧密结合的生

产循环中培养人才团队。在工艺与研发密切融合的环境下培养出的独有技术人才，既有充分市场竞争力，也会对自身的研发生产环境产生一定程度的依赖，如此可以减少人才流失的风险。

（四）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人张立新持有公司股份 1,252.50 万股，持股比例为 61.10%。公司实际控制人现任公司董事长兼总经理，对公司经营管理有较大影响力，若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

（五）对非经常性损益依赖的风险

2011 年、2012 年和 2013 年 1~6 月，公司净利润分别为 1,214.44 万元、1,616.31 万元和 1,111.52 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为 504.31 万元、557.23 万元和 864.54 万元。公司非经常性损益主要为政府对公司研发项目的补贴，政府补贴使得公司净利润相比之下表现在较高的水平。如果公司业务不能实现更快的增长，在公司无法持续获得政府补贴时，将会对公司今后盈利水平的快速提升产生不利影响。

针对上述风险，公司采取如下措施：

（1）提升公司的业务规模，取得更高的经营利润水平。

首先，公司将在保持小家电应用领域领先地位的基础上，逐步进入黑色家电和白色家电应用领域；其次，逐步扩大手持设备的市场份额，快速切入适配器领域，推广 LED 照明领域新产品，多点开花，扩大公司业务规模；同时，为进一步保障未来产能持续增长，公司将通过新增的加工单位来分散产能瓶颈风险；此外，公司将

采取收购和兼并的方式，择机延伸产业链，提升总体业务规模和经营利润水平。

(2) 推动政府补贴研发项目的产业化进程，使得项目产品尽快产生经营性收益。

公司在经营进程中，针对既有产品不断升级开发，保持其持续竞争力，同时，不断推动政府补贴研发项目的产业化进程，并持续转化为生产经营性收益。针对 700V 单片集成 AC-DC 绿色电源芯片研发及产业化项目、CMOS 单片高耐压高效率开关稳压器项目、超低待机功耗交直流转换器研发及产业化项目、基于高低压混合特色工艺模块的功率集成电路研发与产业化项目等，公司持续开发了各类电子设备中的各类低压电源转换、驱动和保护电路，包括宽输入、输出电压范围的 DC-DC 高效同步转换电路、各类 LED 驱动电路、智能充电管理电路以及各类限流保护、电压侦测保护电路等，为公司经营性收益的稳步增长奠定了基础。

十三、公司经营目标

(一) 发展战略及经营目标

1、发展战略

公司致力于发展绿色电源管理集成电路新兴战略产业，将领先的功率半导体工艺器件及其电路技术创造性地应用于国家和社会建设，促进节能减排，创造良好的经济效益和社会效益。

公司将专注于绿色电源管理集成电路产业的应用领域，走自主创新之路，不断开发新型应用产品，提高整体解决方案的综合服务能力，将公司发展成为一家拥有完整自主知识产权体系、综合实力领先、最具竞争力的全球绿色电源管理集成电路应用整体解决方案供应商。同时，公司将顺应产业发展趋势，逐步向产业链中上游延伸，为公司在绿色电源管理集成电路应用领域的发展提供重要支持和保障。

未来三年，公司将以本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让为契机，巩固和加强公司在国内绿色电源管理集成电路应用领域的领先地位，不断开发集成度更高、智能化更佳、功耗更低、输出功率更齐全的绿色电源管理集成电路产品，大力推进营销网络的建设和布局，增进研发及自主创新能力，提升公司的品牌影响力和核心竞争力，尽力争取实现公司营业收入每年 30% 以上的增长速度。

2、整体经营目标

2014 年至 2016 年期间，公司将通过技术进步、市场开拓、高效管理，实现比同行业其他公司更高的增长率，成为国内排名前列的专业化电源管理集成电路供应商，和有影响力的模拟集成电路设计公司。

（二）发展计划及实现措施

1、产品开发计划

2014 年至 2016 年期间，公司将对既有产品更新升级开发，保持现有系列产品的持续竞争力。在此基础上主要的新开发计划为：

（1）开发 LED 照明驱动 AC-DC 系列集成电路产品，包括双绕组内置高压启动及 MOS 的 3~5W 恒流驱动器系列、单级 PFC 内置高压启动及 MOS 的 7~25W 恒流驱动器系列、单级 PFC 外置 MOS 的 12~40W 恒流控制器系列。公司逐步完善的 LED 照明集成电路系列产品将为客户提供极高性价比、品质稳定、多样架构的 LED 照明驱动完整解决方案。

（2）开发适配器和充电器 AC-DC 系列集成电路产品，包括 5~18W 内置高压启动及功率管的 PSR 转换器系列、10~24W 内置高压启动及功率管的 Flyback 转换器系列、15~90W 外置 MOS 的 Flyback 控制器系列等多种架构的产品；同时，针对全功率系列产品向客户提供性能优异、品质可靠的 Adapter/Charger 系统参考设计方案。

（3）开发各类电子设备中的各类低压电源转换、驱动和保护电路，包括宽输入、输出电压范围的 DC-DC 高效同步转换电路、各类 LED 驱动电路、智能充电管理电路以及各类限流保护、电压侦测保护电路等，为客户提供灵活、可靠的各类电源方案。

2、人力资源发展计划

人力资源是公司最宝贵的财富，公司发展源于全体员工的努力工作。随着业务规模的扩大，公司各类人员均会有所增长，特别是面向市场的技术支持人员（FAE）和销售将成为公司人员扩张的重点。按业务经营发展规划的要求，三年内，公司总人数将达到近 200 人的规模。

人力资源发展计划包括：

(1) 人才引进计划

不断吸引优秀的技术人才和营销管理人才加盟公司，保持公司人力资源的旺盛活力。

(2) 培训计划

不断完善公司的培训体系，内部培训和外部培训相结合，形成人才的自我成长机制，满足公司发展对人才能力的需求。

(3) 考核体系和激励计划

不断改进和完善公司的绩效考核体系，激发技术、市场、管理人员的工作积极性和创造力，强化公司的核心竞争力。

3、收购兼并及对外扩张计划

收购和兼并是公司发展成长的一种有效方式，在适当的时机出现合适的对象时，公司可以采取收购和兼并的方式，取得壮大发展的机会。

随着业务的发展需要，当目前的代加工合作伙伴无法满足公司的产能需求时，公司寻求增加新的合作伙伴以增加产能将成为必然；同时，考虑到产能的持续稳定性，也会通过增加新的加工单位来分散来自加工方的可能风险。在三年之内，公司计划新增 2—3 家代工单位。

4、技术发展计划

公司目前的设计技术仍以模拟技术和芯片级技术为主，在不断继续既有技术深入开发的同时，公司已经在着手规划拓展新的技术领域。

(1) 数字电源技术：将数字信号处理技术用于电源管理电路之中，去实现仅用模拟技术难以实现的更多的复杂控制功能，以满足复杂电子系统对电源管理产品自适应调整控制的更多要求，是公司未来的重要技术发展方向。

(2) 模块类电源产品：公司目前的产品全部是芯片级的，对于部分客户而言，可能需要可直接用于生产整机的完整电源系统方案。公司可根据此类客户的需求，采用本公司的电源集成电路开发出符合客户要求的电源模块，直接向该类型客户提供，从而将公司的产品从芯片级扩展至模块级。

5、市场开发与网络建设计划

- (1) 保持在小家电应用领域的领先地位，逐步进入黑色家电和白色家电应用领域；
- (2) 保持在平板电脑应用领域的市场份额，扩大在智能手机领域的市场占有率；
- (3) 从充电器应用领域，逐步进入更多应用范围的适配器领域；
- (4) 顺应 LED 照明市场的发展，加大新产品在照明领域的推广力度；
- (5) 关注工业电源和驱动的市场需求，适时进入这一应用领域。

6、市场竞争策略

公司在功率电子集成电路领域面临着国内外不同的竞争对手，不管是来自哪方面的竞争对手，核心的竞争力来自于对客户需求的真实理解和掌握，来自于产品开发的技术实力。公司将在电路系统设计和器件工艺研究上持续投入，保持并扩大在技术上对国内同行的领先优势，努力缩小和赶上与国外高水平公司的差距，快速地开发出客户满意的产品；同时，与整机产品生产领域的标志性客户建立长期合作的关系，共同开发下一代整机所需的电源方案，从而带动该领域的生产企业更多地采用公司的方案，提升市场占有率。

第五章 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；

（正文完）

(本页无正文,为无锡芯朋微电子股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

公司董事:

张立新 张立新

李志宏 李志宏

薛伟明 薛伟明

易扬波 易扬波

周 飙 周飙

公司监事:

张 韬 张韬

陶 平 陶平

陶晓华 陶晓华

公司高级管理人员:

陈 健 陈健

无锡芯朋微电子股份有限公司
2014年1月15日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

李德雄

项目负责人：

马翔

项目小组成员：

马翔 徐晓宇 吴耀奇 陈保 胡刚

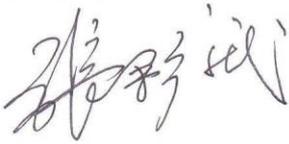


2014年 1月15日

会计师事务所声明

本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



经办注册会计师：



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

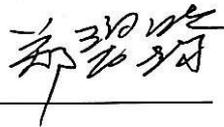


（特殊普通合伙）
二〇一四年一月十五日

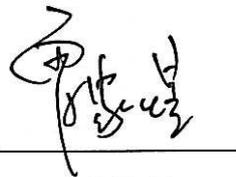
律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读无锡芯朋微电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容的引用而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

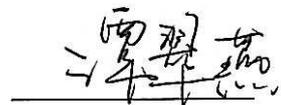
经办律师：



郑碧筠



曾家煜



谭翠燕

律师事务所负责人：



王 丽

北京德恒律师事务所



2014年 1 月 15 日

资产评估机构声明

本机构及经办注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



经办注册资产评估师：

陈小明



俞建华



江苏中天资产评估事务所有限公司



2014年1月15日